

목 차

정 정 신 고 (보 고)	1
【 대표이사 등의 확인 】	2
분 기 보 고 서	3
【 대표이사 등의 확인 】	4
I. 회사의 개요	5
1. 회사의 개요	5
2. 회사의 연혁	7
3. 자본금 변동사항	12
4. 주식의 총수 등	12
5. 정관에 관한 사항	13
II. 사업의 내용	15
1. 사업의 개요	15
2. 주요 제품 및 서비스	16
3. 원재료 및 생산설비	16
4. 매출 및 수주상황	20
5. 위험관리 및 파생거래	22
6. 주요계약 및 연구개발활동	23
7. 기타 참고사항	27
III. 재무에 관한 사항	35
1. 요약재무정보	35
2. 연결재무제표	37
2-1. 연결 재무상태표	37
2-2. 연결 포괄손익계산서	38
2-3. 연결 자본변동표	39
2-4. 연결 현금흐름표	40
3. 연결재무제표 주석	41
4. 재무제표	77
4-1. 재무상태표	77
4-2. 포괄손익계산서	78
4-3. 자본변동표	79
4-4. 현금흐름표	80
5. 재무제표 주석	81
6. 배당에 관한 사항	114
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항	116
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적	116
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적	120
8. 기타 재무에 관한 사항	120
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	126
V. 회계감사인의 감사의견 등	127
1. 외부감사에 관한 사항	127
2. 내부통제에 관한 사항	128
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	129
1. 이사회에 관한 사항	129
2. 감사제도에 관한 사항	130
3. 주주총회 등에 관한 사항	132

VII. 주주에 관한 사항.....	135
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	137
1. 임원 및 직원 등의 현황	137
2. 임원의 보수 등	139
IX. 계열회사 등에 관한 사항.....	142
X. 대주주 등과의 거래내용	144
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	146
1. 공시내용 진행 및 변경사항	146
2. 우발부채 등에 관한 사항	146
3. 제재 등과 관련된 사항	148
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항	148
XII. 상세표	152
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)	152
2. 계열회사 현황(상세)	153
3. 타법인출자 현황(상세).....	153
4. 지적재산권 보유현황(상세).....	154
【 전문가의 확인 】	159
1. 전문가의 확인.....	159
2. 전문가와의 이해관계	159

정정신고(보고)

2024년 05월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 5월 14일
3. 정정사항

항 목	정정요구·명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 다. 임원 겸직 현황(등기임원) -. 대표이사 이동철	해당사항 없음	단순 기재오류	하나더블유엘에스(주) 사내이사	하나더블유엘에스(주) 기타비상무이사

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인·서명

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재 내용에 대한 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」 제8조의 규정에 따라 내부회계 관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2024년 05월 31일

하나마이크론 주식회사

대 표 이 사 이 동 철

(서명)

(서명)


신고업무담당이사 박 상 목

분기보고서

(제 24 기 1분기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2024년 05월 14일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

하나마이크론 주식회사

대 표 이 사 :

이 동 철

본 점 소 재 지 :

충남 아산시 음봉면 연암울금로 77

(전 화) 041-423-7015

(홈페이지) <http://www.hanamicron.co.kr>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 전무이사

(성 명) 박상묵

(전 화) 041-423-7015

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인·서명

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 분기보고서의 기재 내용에 대한 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」 제8조의 규정에 따라 내부회계 관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

(「주식회사의외부감사에관한법률」 제4조에 의한 외감대상법인에 한함)

2024년 05월 14일

하나마이크론 주식회사

대 표 이 사 이 동 철

(서명)

신고업무담당이사 박 상 목

(서명)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기·반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
	기초	증가	감소	기말	
상장	1	-	-	1	1
비상장	12	-	-	12	2
합계	13	-	-	13	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

☞ 주요 종속회사 여부 판단기준

- 직전연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상인 종속회사
- 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

나. 연결대상회사의 변동내용

구분	자회사	사유
신규 연결	-	-
	-	-
연결 제외	-	-
	-	-

다. 회사의 명칭·상업적 명칭

회사의 명칭은 하나마이크론 주식회사이며, 영문명은 HANA MICRON INC. 입니다.

라. 설립일자

2001년 8월 23일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일에 기업공개를 실시하였습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

- 주소 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77
- 전화번호 : 041-423-7015
- 홈페이지 주소 : <http://www.hanamicron.co.kr>

바. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않으며 「중견기업 성

장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조 제1호」에 의한 중견기업에 해당됩니다.

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당
벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부	해당

사. 주요 사업의 내용

회사명	주요사업
하나마이크론(주), HT MICRON SEMICONDUCTORES S.A. Hana Micron Vina Co.,Ltd	· 반도체 패키징, 테스트, 모듈
하나머티리얼즈(주)	· 실리콘 parts의 제조 및 판매

※기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'II 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 등	평가대상의 신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)	평가구분
2024.02.22	회사채	BBB	한국기업평가 (AAA ~ D)	정기

※ 신용등급체계 설명

기업신용등급	정의
AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.
AA	원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.
BBB	원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.
BB	최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.
B	원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.
CCC	채무불이행이 발생할 가능성이 높다.
CC	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.
C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.
주1) 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있습니다.	

자. 회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록·지정)현황	주권상장 (또는 등록·지정)일자	특례상장 유형
코스닥시장 상장	2005년 10월 11일	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

회사는 현재 충남 아산시 음봉면 연암울금로 77에 본점을 두고 있으며 2006년 4월 10일에 주사업장 이전에 따라 충남 아산시 음봉면 소동리 10-9에서 상기 주소로 본점소재지를 변경한 바가 있습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

보고서 제출일 현재 이동철 대표이사 체제로 이사회가 운영되고 있으며, 공시대상기간동안의 주된 경영진의 변동내역은 아래 표와 같습니다.

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
		신규	재선임	
2020년 03월 27일	정기주총	-	사내이사 김길백 사외이사 장호정	-
2021년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 박상묵 감사 안재근	-
2022년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 이동철	-
2023년 03월 30일	정기주총	사외이사 정승부	사내이사 김길백	사외이사 장호정
2024년 03월 28일	정기주총	사내이사 김동현	사내이사 박상묵 감사 안재근	사내이사 김길백

다. 최대주주의 변동

최대주주는 최창호이며 회사 설립일 이후 변동사항이 없습니다.

라. 상호의 변경

당사는 설립이후로 상호의 변경이 없으며, 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)의 상호변경에 관한 사항은 아래와 같습니다.

일 자	내 용
2008.08.12	하나실리콘텍 주식회사 → 하나실리콘 주식회사

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재진행중인 경우 그 내용과 결과

※ 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

(1) 분할

당사는 2021년 1월 1일 BUMP 사업부문을 분할하여 종속회사 하나더블유엘에스(주)를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 BUMP 사업부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 BUMP사업부문의 전문성을 특화하고 경영효율성 및 책임경영 체제의 토대를 확립하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순·물적분할의 방법에 해당합니다.

- 분할 사업부문

구분	회사명	사업부문
분할되는 회사 (존속회사)	하나마이크론(주)	신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문
분할신설회사	하나더블유엘에스(주)	BUMP 사업부문

- 분할 회사의 개요

분할되는 회사 (존속회사)	상호	하나마이크론 주식회사
	소재지	충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77
	대표이사	이동철
	법인구분	코스닥시장 상장법인

분할신설회사	상호	하나더블유엘에스 주식회사
	소재지	충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77, 생산4동
	대표이사	신태희
	법인구분	비상장법인

- 분할 주요일정

구분	일자
이사회결의일	2020년 11월 11일
주주명부 폐쇄 및 기준일 공고	2020년 11월 11일
분할 주주총회를 위한 주주확정일	2020년 11월 26일
주주총회 소집 통지일	2020년 12월 08일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2020년 12월 23일

분할기일	2021년 01월 01일
분할보고총회일 또는 창립총회일	2021년 01월 04일
분할등기일	2021년 01월 06일

주1) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.

- 분할 전 · 후의 재무상태표

(단위:천원)

구 분	분할 전	분할 후	
		분할존속회사	분할신설회사
		하나마이크론(주)	하나더블유엘에스(주)
자산			
Ⅰ. 유동자산	137,093,768	134,658,486	2,435,282
(1) 현금및현금성자산	7,157,289	6,157,287	1,000,000
(2) 단기금융상품	7,486,117	7,486,117	-
(3) 매출채권및기타채권	79,438,962	78,339,608	1,099,355
(4) 기타유동자산	6,763,666	6,763,666	-
(5) 재고자산	28,242,778	27,906,852	335,927
(6) 계약원가	3,920,275	3,920,275	-
(7) 매각예정자산	4,071,479	4,071,479	-
(8) 당기법인세자산	13,202	13,202	-
Ⅱ. 비유동자산	359,176,449	361,185,068	26,800,441
(1) 당기손익-공정가치측정금융자산	838,736	836,719	2,017
(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	649,827	649,827	-
(3) 유형자산	227,154,271	200,843,112	26,311,159
(4) 투자부동산	5,606,111	5,606,111	-
(5) 무형자산	1,212,454	725,189	487,265
(6) 사용권 자산	3,362,934	3,362,934	-
(7) 종속기업및공동기업 투자주식	56,352,545	85,161,605	-
(8) 장기매출채권및기타채권	63,606,013	63,606,013	-
(9) 이연법인세자산	393,558	393,558	-
자산총계	496,270,217	495,843,554	29,235,723
부채			
Ⅰ. 유동부채	212,549,203	212,303,961	245,241
(1) 매입채무및기타채무	56,400,894	56,155,652	245,241
(2) 단기차입금	111,000,000	111,000,000	-
(3) 유동성장기차입금	31,318,777	31,318,777	-
(4) 기타유동부채	5,700,198	5,700,198	-
(5) 금융보증부채	180,244	180,244	-
(6) 전환사채	3,373,419	3,373,419	-

(7)리스부채	1,990,539	1,990,539	-
(8)당기손익-공정가치측정금융부채	2,585,132	2,585,132	-
II.비유동부채	129,341,128	129,159,707	181,422
(1)장기매입채무및기타채무	1,922,744	1,911,473	11,271
(2)장기차입금	120,529,131	120,529,131	-
(3)리스부채	561,212	561,212	-
(4)순확정급여부채	6,328,041	6,157,891	170,151
부채총계	341,890,331	341,463,668	426,663
자본			
I.자본금	15,184,756	15,184,756	1,000,000
II.기타불입자본	120,014,671	120,014,671	27,809,060
III.기타자본구성요소	19,070,021	19,070,021	-
IV.이익잉여금(결손금)	110,438	110,438	-
자본총계	154,379,886	154,379,886	28,809,060
자본과부채총계	496,270,217	495,843,554	29,235,723

주1) 상기 분할 재무상태표는 2020년 06월 30일 현재 재무상태표를 바탕으로 한 자료이며, 분할기일의 재무제표와는 차이가 있을 수 있습니다.

주2) 합병등 전후의 재무사항 비교표를 위 재무상태표로 같음하며, 그 외 본 분할에 관한 상세한 내용은 2020년 11월 11일 제출한 주요사항보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

※ 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용

공시대상 기간 동안 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와 같습니다.

구분	일자	주요연혁
하나마이크론	2019.03	제7회 전환사채(CB) 27억 행사에 따른 증자
	2019.03	제8회 전환사채(CB) 발행 150억 조달
	2019.03	대표이사변경(한호창 → 이동철)
	2019.04	제7회 전환사채(CB) 33억 행사에 따른 증자
	2019.05	제7회 전환사채(CB) 41억 행사에 따른 증자
	2019.06	제7회 전환사채(CB) 5억 행사에 따른 증자
	2019.07	베트남 현지법인 설립(Hana Micron Vina)
	2019.10	제7회 전환사채(CB) 15.9억 행사에 따른 증자
	2019.11	제7회 전환사채(CB) 76.4억 행사에 따른 증자
	2019.12	제7회 전환사채(CB) 0.8억 행사에 따른 증자
	2020.01	제7회 전환사채(CB) 1.1억 행사에 따른 증자
	2020.01	지문 센서 패키지 및 이를 포함하는 지문 센서 모듈
	2020.02	베트남 현지법인(Hana Micron Vina) 공장 준공
	2020.02	재배선 구조를 갖는 반도체 소자와 웨이퍼 레벨 패키지 및 그 제조방법
	2020.03	제8회 전환사채(CB) 61.4억 행사에 따른 증자
2020.03	주식매수선택권 행사에 따른 증자	

	2020.04	제8회 전환사채(CB) 41.1억 행사에 따른 증자
	2020.09	제8회 전환사채(CB) 2.5억 및 주식매수선택권 행사에 따른 증자
	2020.09	가스센서 패키지, 가스센서 웨이퍼 레벨 패키지 및 그 제조방법
	2020.10	주식매수선택권 행사에 따른 증자
	2020.11	주식매수선택권 행사에 따른 증자
	2020.11	BUMP 사업부문 물적분할 결정
	2020.12	주식매수선택권 행사에 따른 증자
	2021.01	BUMP 사업부문 물적분할 완료, 분할신설법인(하나더블유엘에스 주식회사) 설립
	2021.01	주식매수선택권 행사에 따른 증자
	2021.02	제8회 전환사채(CB) 45억 및 주식매수선택권 행사에 따른 증자
	2021.03	주식매수선택권 행사에 따른 증자
	2021.04	주식매수선택권 행사에 따른 증자
	2021.06	브라질 현지법인 설립(Hana Electronics Industria E Comercio Ltda)
	2021.11	에스케이하이닉스(주)와 중장기 반도체 후공정 사업협력 및 외주임가공계약 체결
	2021.12	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 및 무상증자 실행
	2022.03	시스템 반도체 테스트 지원센터 설립
	2022.11	코스닥 글로벌 세그먼트 선정(한국거래소)
	2022.12	수출의 탑 수상 (4억불)
	2023.03	제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행
	2023.09	대한민국 일자리 으뜸기업 선정 (고용노동부)
	2024.01	주식매수선택권 행사에 따른 증자
	2024.02	주식매수선택권 행사에 따른 증자
	2024.03	제12회 영구 전환사채(CB) 행사 및 주식매수선택권 행사에 따른 증자
하나머티리얼즈	2019.01	아산사업장 공장 준공
	2019.06	제11회 대한민국코스닥대상 '최우수차세대기업상' 수상
	2019.06	수출입은행 한국형 히든챔피언 육성사업 대상기업 선정
	2019.07	노사문화 우수기업 선정 (고용노동부)
	2020.01	청년친화강소기업 선정 (고용노동부)
	2020.02	가스사업부 매각
	2020.07	대한민국 일자리 으뜸기업 선정 (고용노동부)
	2021.11	국가생산성대회 종합대상 중견기업 대통령표창
	2021.12	수출의 탑 수상 (5천만불)
	2022.04	2022 장애인고용촉진대회 장애인 고용촉진 유공 고용노동부 장관표창
	2022.10	장애인고용 우수사업주 선정
	2022.12	무역의 날 수출의 탑 수상 (7천만불)
	2023.01	자회사 하나에스앤비인베스트먼트(주) 설립
	2023.09	대한민국 일자리 으뜸기업 선정 (고용노동부)
	2024.03	제58회 모범납세자 대통령 표창 수상
HT MICRON SEMICONDUCTO RES LTDA	2020.05	SigFox 기반IoT용iMCP chip HT32SX 출시
	2023.01	퀄컴과 NB-IoT 제품 공동개발 추진
Hana Micron Vina Co.,Ltd	2020.02	공장 준공(베트남 박장성)
	2020.07	반도체 패키징(FPS) 초도 출하
	2020.12	반도체 패키징(FPS) 양산 개시

	2021.09	High-Tech 기업인증
	2022.03	생산(1-2동) 공장 증축 완료
	2022.06	생산(2동) 공장 건물 착공
	2022.07	사업 확대에 따른 유상증자(USD 37,000,000) 실시
	2023.09	생산(2동) 공장 건물 준공
	2023.12	사업 확대에 따른 유상증자(USD 52,000,000) 실시

3. 자본금 변동사항

당사는 2020년도 중 보통주 2,990천주를 발행하여 1,495백만원, 2021년도 중 보통주 17,256천주를 발행하여 8,628백만원, 2023년도 중 보통주 58천주를 발행하여 29백만원, 2024년도 당분기 중 4,157천주를 발행하여 2,078백만원의 자본금이 각각 증가하였습니다. 한편, 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 보통주 이외의 주식(우선주식,상환주식,전환주식 등)을 발행한 사실이 없습니다.

공시대상 기간 동안의 자본금 변동추이는 아래 표와 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	24기 1분기 (2024년 3월말)	23기 (2023년말)	22기 (2022년말)	21기 (2021년말)	20기 (2020년말)
보통주	발행주식총수	52,136,475	47,979,854	47,921,854	47,921,854	30,665,423
	액면금액	500	500	500	500	500
	자본금	26,068,237,500	23,989,927,000	23,960,927,000	23,960,927,000	15,332,711,500
우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
합계	자본금	26,068,237,500	23,989,927,000	23,960,927,000	23,960,927,000	15,332,711,500

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류			비고
	보통주	우선주	합계	
1. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	우선주포함

II. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,136,475	-	52,136,475	-
III. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-
1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)	52,136,475	-	52,136,475	-
V. 자기주식수	-	-	-	-
VI. 유통주식수 (IV-V)	52,136,475	-	52,136,475	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

※해당사항이 없습니다.

다. 보통주 외의 주식 발행현황

당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 보통주 이외의 주식(우선주식,상환주식,전환주식 등)을 발행한 사실이 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일

당사 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일이며, 제21기 정기주주총회(2022년3월30일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2021.03.30	제20기 정기주주총회	상법 개정에 따른 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비 및 이익 배당 기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시, 전자투표 도입시 감사 선임 주주총회 결의요건 완화, 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비	관계법령 개정 사항 반영
2022.03.30	제21기 정기주주총회	발행예정 주식총수 변경(한도 증가) 및 사채 발행한도 확대 주주명부의 작성 및 비치에 관한 규정 정비	외형성장 비례 한도 증가 관계법령 개정 사항 반영

다. 사업목적 현황

구분	사업목적	사업영위 여부
1	반도체 및 액정 표시장치의 제조와 판매업	영위
2	반도체 제조기기 및 검사기기의 제조 판매, 무역, 임대, 서비스업	영위

3	방송 및 무선통신기기 제조 및 판매업	미영위
4	컴퓨터 기억장치 제조 및 판매업	미영위
5	전자카드 제조 및 판매업	미영위
6	기타 발전기 및 전기변환장치 제조 및 판매업	미영위
7	전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매	미영위
8	다이오드, 트랜지스터 및 유사반도체 제조업	미영위
9	산업용 가스의 제조, 정제, 충전 및 판매업	미영위
10	시스템통합구축서비스의 개발, 임대, 판매업	미영위
11	RFID 제품의 개발, 제조 및 판매업	미영위
12	LED 제품의 개발, 제조 및 판매업	미영위
13	소프트웨어의 개발용역 및 판매업	미영위
14	정보통신기기 제조 개발 용역업 및 판매업	미영위
15	전자상거래 및 인터넷 관련사업	미영위
16	노우하우 기술의 판매, 임대업	영위
17	수출입업 및 동 대행업	영위
18	부동산임대업	영위
19	부동산 개발 및 판매업	영위
20	신재생에너지 및 환경관련 사업	영위
21	기타 신재생에너지를 통한 전력 생산 및 판매업	영위
22	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

※ 최근 3사업연도 동안 변경 또는 추가된 사업목적은 없습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 2001년 8월에 설립되어 2005년 10월 코스닥시장에 상장된 반도체 후공정 전문 기업입니다. 또한, 한국채택국제회계기준 적용 기업으로, 비재무사항에 기재한 연결 대상법인에는 당사를 비롯한 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)와 HT MICRON SEMICONDUCTORES S.A., Hana Micron Vina Co.,Ltd 를 포함합니다. 당사 및 주요종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 또한, 하나머티리얼즈(주)의 종속회사인 하나에스앤비인베스트먼트(주)는 신기술사업 투자부문의 사업을 진행하고 있습니다.

주요사업부문	구분	회사명	주요 사업부문의 내용
반도체 제조	지배회사	하나마이크론(주)	반도체 패키징 & 테스트
	종속회사	HT MICRON SEMICONDUCTORES S.A.	반도체 패키징 & 테스트
	종속회사	Hana Micron Vina Co.,Ltd	반도체 패키징 & 테스트
반도체 재료	종속회사	하나머티리얼즈(주)	반도체식각장비의 Silicon parts 등
신기술사업금융	종속회사	하나에스앤비인베스트먼트(주)	신기술사업 투자 등

(1) 반도체 제조 부문

반도체 제조부문은 반도체 산업의 Back-end 분야인 반도체 패키징 및 테스트를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 업계선두의 반도체 패키징 및 테스트 기술을 보유한 전문 엔지니어들로 구성되어 있는 반도체 후공정 전문기업으로 글로벌 반도체 산업의 선두주자를 주요 고객처로 두고 있습니다. 반도체 제조 부문은 경쟁사 대비 납기와 품질에서의 경쟁력과 모바일용 D 램 Stack Chip 등의 공정기술에서의 우위를 바탕으로, 2024년 1분기 매출액은 전년 동기대비 25% 증가한 매출 2,112억원, 영업이익은 297% 증가한 43억원을 달성하였습니다. 향후에는 고객사와의 협력관계를 더욱 공고히 하는 한편, 고부가가치 메모리 제품 확대 및 비메모리 패키징, 테스트 사업확대를 통해 매출 및 수익성을 개선해 나갈 계획입니다.

(2) 반도체 재료 부문

반도체 재료부문은 반도체 등의 제조공정에 사용되는 실리콘 부품(Si-Parts)사업과 신규사업인 실리콘카바이드사업(SiC-Parts)으로 구성되며, 이는 반도체의 핵심 제조공정인 에칭(식각)공정에 사용되는 소모성 부품입니다. 최근 반도체 공정에서의 고집적도를 위한 선풍 미세화에 따른 고밀도 플라즈마 환경의 도입과 Dry Etching 공정의 확산으로 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 반도체 재료부문은 독보적인 경쟁력을 유지하며 2024년 1분기 매출액은 전년 동기 대비 17% 감소한 571억원, 영업이익은 61% 감소한 62억원을 달성하였습니다.

(3) 신기술사업금융 부문

당사의 종속회사인 하나에스앤비인베스트먼트 주식회사는 반도체 및 배터리 산업에서 사용되는 소재/부품/장비 업종 내 신기술사업자 및 중소/신규 스타트업(Start-up)기업 투자 지원 및 육성을 목적으로 설립 되었습니다. 투자 대상 기업 각각의 상황에 맞는 동반 성장 환경을 구축할 수 있도록 다양한 측면의 기업 지원 사업을 진행하고 있으며 2024년 1분기 매출액은 6.4억원, 영업이익은 3.9억원을

달성하였습니다.

연결실체가 영위하고 있는 사업에 대한 자세한 산업분석등의 내용은 동 보고서의 'II 사업의 내용' '7. 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

사업구분	매출 유형	품 목	구체적용도	주요 상표등	제24기 1분기	
					매출액	비율(%)
반도체제조	제품외	PKG	반도체칩부품화	-	189,557,853	70.5
		기타	-	-	21,753,036	8.1
반도체재료	제품외	실리콘부품	반도체 공정소모품	-	48,395,537	18.0
		기타	특수가스外	-	8,615,008	3.2
신기술사업금융	투자외	기타	이자수익外	-	639,275	0.2
합계	-	-	-	-	268,960,709	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

품 목		구분	제24기 1분기	제23기	제22기
반도체 제조	PKG	내수	269	241	333
		수출	322	119	214
반도체 재료	실리콘 부품	내수	1,727,746	1,760,193	1,561,632
		수출	-	-	-

※ 산출기준

- 각 거래처 및 모델별 상이한 가격으로 판매되어 당분기의 총 매출액을 총 판매수량으로 나눈 산술 평균 가격을 기재하였음.
- 반도체재료 부문 수출의 경우 비정규적인 제품 생산 등으로 가격의 등락이 존재하며, 각 거래처 및 모델별 상이한 가격에 따라 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하고 정확한 가격의 변동 추이를 파악하기 어려워 기재를 생략하였음.
- 기타 매출품목은 품목이 다양하고 가격이 일정치 않으므로 기재하지 않음.

※ 주요 가격변동원인

- 반도체제조: 연도별 평균단가 차이는 제품모델별 판매량 증감에 따른 차이임.
- 반도체재료: 반도체 업황에 따른 시장수급에 의한 가격결정요인이 큼.

3. 원재료 및 생산설비

1) 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업 부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액 (비율)	비고
반도체 제조	원재료	PCB	BGA계열 제품용 인쇄회로기판	47,339	-
				30.94%	
	원재료	Gold Wire	Chip의 Pad와 L/F의 Lead간을 연결해 주는 순금 또는 합금재질의 선	1,745	-
				1.14%	
	원재료	Lead Frame	Chip과 주변회로를 연결하기 위한 금속체 회로기판	0	-
				0.00%	
	원재료	EMC	Wire Bonding된 반제품을 PKG화하는 성형재료	2,609	-
				1.71%	
	원재료	Wafer	반도체 소자의 재료	45,895	-
				30.00%	
	원재료	소자	반도체 물질로 전자회로를 구성	44,582	-
				29.14%	
원재료	기타	-	4,740	-	
			3.10%		
반도체 재료	원재료	Poly-Si	작은 실리콘 결정체들로 이루어진 물질로 반도체 웨이퍼를 만드는 데 사용	3,410	-
				2.23%	
	원재료	Ingot	폴리실리콘을 녹여 원기둥 모양의 결정으로 만든 것으로 웨이퍼를 잘라내기 전의 덩어리	2,098	-
				1.37%	
	원재료	기타	-	581	-
				0.37%	
합 계	-	-	-	152,998	-
				100.00%	

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목 (단위)	구분	제24기 1분기	제23기	제22기
PCB (pcs)	국내	575	468	320
	수입	315	928	832
Lead Frame (pcs)	국내	-	-	17
	수입	-	-	-

Gold Wire (ft)	국내	122	114	104
	수입	-	-	-
EMC (kg)	국내	107,429	85,110	68,904
	수입	55,943	41,795	28,200
Ingot (kg)	국내	-	-	-
	수입	194,159	187,844	183,105

※ 산출기준: 당분기에 발생한 총 구매비용을 총 구매수량으로 나누어 산정하였습니다.

2) 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(단위 : 천개, 백만원)

사업 부문	품 목	단위	제24기 1분기	제23기 연간	제22기 연간
반도체 제조	반도체 (PKG,Test,Module)	천개	546,750	2,008,800	1,539,000
반도체 재료	실리콘부품 (Electrode & Ring)	백만원	44,512	192,052	222,789

① 반도체 제조

- 시간당 생산량*일 가동시간(22.5시간)*월 가동일수(30일)*월수(3개월)
- 제24기 1분기 = 270K/hr*22.5hr/1일*30일*3개월 = 546,750K

② 반도체 재료(실리콘부품)

- 생산능력 = 당분기 총제조비용(재료비, 노무비, 경비) 기준
각 사업연도 최대생산월 금액 * 각 사업연도 영업개월수로 일괄 계산

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

사업 부문	품 목	단위	제24기 1분기	제23기 연간	제22기 연간
반도체 제조	반도체	천개	381,039	1,345,273	1,303,995
반도체 재료	실리콘 부품	백만원	39,819	160,253	205,196

(2) 당해 사업연도의 가동률

사업 부문	품목	단위	당분기생산가능수량 (당분기가동가능시간)	당분기실제생산수량 (당분기실제가동시간)	평균가동률
----------	----	----	--------------------------	--------------------------	-------

반도체 제조	반도체	천개	546,750	381,039	69.79%
반도체 재료	실리콘 부품	시간	1,123,872	577,339	51.37%

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등

반도체 제조 사업부문은 충남 아산에 제조시설, 경기 성남 분당구에 R&D 센터를 두고 있으며, 브라질과 베트남에 현지법인을 두고 있습니다. 또한 반도체 재료 사업부문은 충남 천안 백석, 충남 아산 음봉에 제조시설을 두고 있으며, 경기 용인의 기흥오피스 등에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 영업 등의 활동을 수행하고 있습니다.

사업부문	사업장	소재지	주요 사업	비고
반도체 제조	아산사업장	충남 아산시 음봉면 연암울금로 77	반도체 제품 제조	본사
	판교 R&D센터	경기 성남시 분당구 판교로 255번길 35	R&D, 영업	-
	브라질 현지법인	Av. Unisions, 950 Ssa Leopoldo RS 93022-000 Brasil	반도체 제품 제조	HT MICRON
	베트남 현지법인	CNSG-02-01, Van Trung Industrial Zone, Van Trung Commune, Viet Yen ward, Bac Giang Province, Viet Nam	반도체 제품 제조	Hana Micron Vina Co.,Ltd
반도체 재료	천안사업장	충남 천안시 서북구 3공단3로 42	부품 제조, 연구개발 등	하나머티리얼즈(주)
	아산사업장	충남 아산시 음봉면 소동리 561	부품 제조, SiC	
	기흥오피스	경기 용인시 기흥구 서천로 121	영업, CS 등	
신기술 사업금융	서울오피스	서울시 강남구 테헤란로22길 13, 예동빌딩 8층(역삼동)	신기술사업금융	-

(2) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산]

(단위 : 천원)

(단위: 천원)							
구분	기초	취득	처분	감가상각	대체	환율변동효과	분기말
토지	90,983,665	3,220,920	-	-	6,224,804	1,440	100,430,829
건물	81,063,350	-	-	(803,015)	9,337,207	230,131	89,827,673
건축물	6,554,205	15,980	-	(121,151)	-	8,906	6,457,940
기계장치	641,291,874	4,295,894	(469,182)	(30,085,842)	5,912,460	6,019,698	626,964,902
공구와기구 외	18,855,745	1,430,825	-	(1,362,777)	85,588	150,597	19,159,978
건설중인자산	163,707,117	19,858,514	-	-	(5,998,048)	204,637	177,772,220
합계	1,002,455,956	28,822,133	(469,182)	(32,372,785)	15,562,011	6,615,409	1,020,613,542

(3) 시설투자 현황

사업부문	구분	투자기간	대상자산	금액	비고
반도체 재료	신/증설, 보완투자	'24.1~'24.3	기계장치 등	11,536	Si, SiC 부품

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 천원)

사업 부문	매출 유형	품 목		제24기 1분기	제23기	제22기
반도체 제조	제품	PKG	수 출	183,704,896	613,654,002	375,946,873
			내 수	5,852,957	24,768,852	22,947,700
			합 계	189,557,853	638,422,855	398,894,573
		기타제품	수 출	18,320,990	58,779,529	19,888,344
			내 수	400,856	2,259,430	3,556,781
			합 계	18,721,846	61,038,959	23,445,125
		소계	수 출	202,025,886	672,433,532	395,835,216
			내 수	6,253,813	27,028,282	26,504,481
			합 계	208,279,700	699,461,814	422,339,698
	기타 매출	수 출	2,881,956	34,516,757	150,820,951	
		내 수	149,234	416,197	13,910,843	
		합 계	3,031,190	34,932,954	164,731,794	
반도체 재료	제품	실리콘부품 (Electrode, Ring)	수 출	17,275,384	66,762,322	113,965,068
			내 수	31,120,153	135,538,373	156,581,792
			합 계	48,395,537	202,300,695	270,546,860
		기타제품	수 출	3,746,439	6,878,715	4,757,137
			내 수	4,457,141	21,917,784	30,701,588
			합 계	8,203,579	28,796,499	35,458,724
		소계	수 출	21,021,823	73,641,036	118,722,204
			내 수	35,577,294	157,456,157	187,283,380
			합 계	56,599,117	231,097,194	306,005,584
	기타매출	수 출	8,852	46,296	42,974	
		내 수	402,576	2,070,813	1,275,843	
		합 계	411,429	2,117,109	1,318,816	
신기술 사업금융	기타	수출	-	-	-	
		내수	639,275	362,413	-	
		합계	639,275	362,413	-	
합 계		수 출	225,938,517	780,637,621	665,421,346	
		내 수	43,022,192	187,333,864	228,974,547	
		합 계	268,960,709	967,971,485	894,395,892	

주1) 신기술사업금융의 매출은 이자수익 및 투자자산 처분(평가)이익 등으로 구성되어 있습니다.

나. 판매경로

(단위 : 천원, %)

품목	구분	판매경로	판매경로별 매출액(천원)	비중(%)
반도체제조 (패키징)	국내	당사→고객사	6,403,047	2.4
	수출	당사→고객사	204,907,842	76.2
반도체재료 (실리콘 부품)	국내	당사→고객사	35,979,870	13.4
	수출	당사→고객사	21,030,675	7.8
신기술사업금융	기타	기타	639,275	0.2
합계			268,960,709	100.0

다. 판매방법 및 조건

(1) 반도체 제조

구분	판매경로	결제조건	부대비용 비용부담
국내	직접판매	현금, B2B전자결제	상호협약하에 일부부담
수출	직접판매	T/T	상호협약하에 일부부담

(2) 반도체 재료

매출유형	품 목	구 분	판매경로
정품 공급	부품 (Si, SiC 등)	내 수	당사 → 장비업체 → End-User
		수 출	당사 → 장비업체 → End-User
직판	부품 (Si, SiC 등)	내 수	국내 고객에게 직판
		수 출	해외 업체로 직수출

라. 판매전략

사업부문	내용
반도체 제조	<ul style="list-style-type: none"> - 고부가가치 신규 제품 적기 개발 및 출시로 영업력 확보 (시장변화에 대응) - 생산성 향상을 통한 원가절감으로 가격 경쟁력 확보 - 글로벌 경영전략에 따른 해외 고객 확보
반도체 재료	<ul style="list-style-type: none"> - 해외 대형거래선 확보를 통한 안정적 거래선 확보 - 종합반도체 회사와의 CO-WORK를 통한 경쟁력 구축(기술, 가격) - 신규 소재 개발을 통한 고객 Needs 부응

마. 수주상황

연결실체의 제품은 주로 시스템을 통하여 고객사로부터 매월의 Forecast를 자체적으로 파악하고 그에 따른 수요 변화를 예측하고 있습니다. 또한, 매일 수시로 시스템을 통하여 고객사의 물량이 접수되고, 수주된 물량은 단기간 내에 매출로 발생하여 별도의 수주관리가 필요하지 않습니다.

구분	판매경로	결제조건	부대비용 비용부담
국내	직접판매	현금, B2B전자결제	상호협약하에 일부부담
수출	직접판매	T/T	상호협약하에 일부부담

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.

재무위험 관리활동은 주로 회사의 재무부서에서 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다.

재무위험관리와 관련된 범주별 금융상품의 장부가액 및 순손익과 차입금 세부 내역에 대한 정보는 동 보고서의 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석 15. 장·단기차입금」 주석을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 파생상품 거래 현황

연결실체는 외화자산 및 부채의 환율변동 위험을 회피하기 위해 통화선도계약을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 체결 중인 통화선도계약 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천USD)

구분	계약처	매도계약금액	약정환율(원)	계약기간
통화선도(1M)	신한은행	US\$30,000	1,312.75	2024.03.13~2024.04.15
통화선도(1M)	씨티은행	US\$30,000	1,329.30	2024.03.18~2024.04.18
합계	-	US\$60,000	1,321.03	-

보고기간말 현재 연결실체가 체결 중인 파생상품계약과 관련하여 당기손익으로 계상된 평가손익 및 거래손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	당분기		전분기	
	평가이익(손실)	거래이익(손실)	평가이익(손실)	거래이익(손실)
통화선도계약	(1,472)	(214)	-	-

합계	(1,472)	(214)	-	-
----	---------	-------	---	---

주1) 평가이익(손실)은 보고기간 말의 매매기준율을 기초로 거래은행에서 제공한 평가 내역을 이용하였습니다.

다. 옵션계약

연결실체는 하나더블유엘에스(주)에서 발행한 전환우선주와 관련한 옵션 계약 및 제12회 무보증 사모 영구 전환사채와 관련하여 옵션 계약을 체결하였으며, 이와 관련된 자세한 내용은 동 보고서의 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 28. 우발채무와 약정사항」 주석을 참조하여 주시기 바랍니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

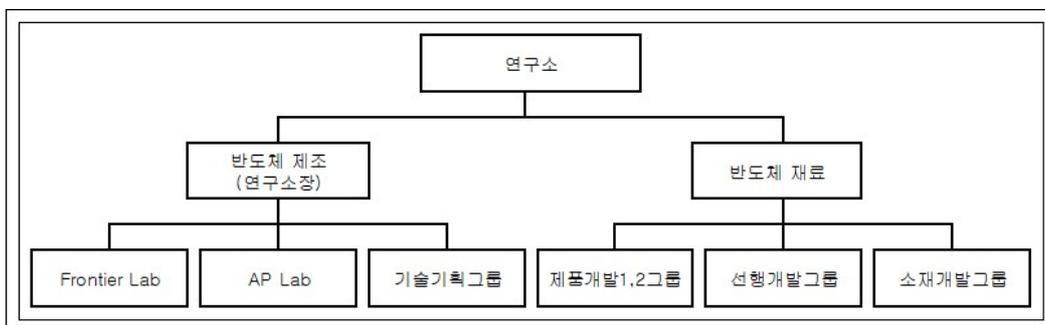
가. 경영상의 주요계약 등

연결실체가 체결한 경영상의 주요계약 내용은 다음과 같습니다.

구분	계약일	계약기간	계약상대처	계약내역	계약금액
반도체 제조	2001.11.01	자동연장	삼성전자(주)	거래기본계약서(반도체패키징)	-
	2004.06.01	자동연장	SK하이닉스	거래기본계약서(반도체패키징)	-
	2021.11.12	2029.12.31	SK하이닉스	사업협력 및 외주임가공 계약(반도체후공정)	-
반도체 재료	2011.07.18	자동연장	삼성전자(주)	거래기본계약서(Electrode, Ring등)	-
	2009.04.16	자동연장	Tokyo Electron Ltd.	OEM공급계약(Electrode, Ring등)	-
	2012.03.06	자동연장	Applied Materials, Inc	물품거래기본계약서(Electrode, Ring등)	-

나. 연구개발활동

(1) 연구개발 담당조직



(2) 연구개발비용

과 목	제24기 1분기	제23기	제22기	비 고
원 재 료 비	6,108,905	16,481,256	18,624,450	-

인 건 비	1,303,476	4,864,053	5,414,513	-	
감 가 상 각 비	194,195	640,941	919,135	-	
위 탁 용 역 비	254,084	811,895	818,454	-	
기 타	1,158,447	7,301,148	6,100,137	-	
연구개발비용 계	9,019,107	30,099,293	31,876,689	-	
회계처리	판매비와 관리비	2,957,925	12,160,355	11,455,907	-
	제조경비	6,061,182	17,938,938	20,420,782	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 ÷ 당기매출액 × 100]	3.35%	3.11%	3.56%	-	

(3) 연구개발 실적

최근 3사업연도의 연구개발 실적은 아래와 같습니다.

【반도체 제조부문】

(1) FcBGA-HS type 고객 Qualification

연구과제명	FcBGA-HS type 개발
연구결과	1) Hat type의 방열판을 붙인 FcBG-HS type을 개발하여 LSI 제품의 문제인 발열을 효과적으로 해소 할 수 있는 방법 개발 2) Heat spread type Flip chip을 개발 3) Display drive IC 및 GPU등 display와 graphic Chip에서 높은 발열로 필수적으로 필요한 Heat spread 기술개발
기대효과	1) FcFBGA-SiP부터 FcBGA-HS type까지 Flip chip 관련 제품 line up을 구축함으로써 다양한 요구조건을 갖는 고객과 본격적인 Flip Chip business 기회를 확보 2) 고성능의 High-end 급의 Flip chip PKG 기술을 확보 함으로써 한층 높은 Flip Chip 기술을 확보하게 됨

(2) FOWLP POP 개발

연구과제명	3D FOWLP 기술 개발
연구결과	1) EMC에 Laser drilling으로 Via를 뚫고 Metal로 Via fill을 하는 통상적인 Via 형성 방법에 비하여 공정을 단순하고 품질 확인이 단순 함 2) Die face up 형태의 FOWLP로 기 원천특허인 Die face down에 문제가 되지 않음 3) Cu core ball을 활용하여 FOWLP의 thickness를 얇게 만들 수 있어 Total height를 낮게 만들 수 있음
기대효과	1) Fan out wafer level POP 기술 확보로 FOWLP SiP 기술개발도 가능하게 됨 2) Molded wafer를 grinding 하여 Cu core 노출을 하는 기술로 POP 두께를 매우 얇게 구현이 가능 3) FOWLP 원천 특허에 문제가 되지 않은 기술을 확보 함으로써 특허문제를 해결 및 다른 형태의 FOWLP에 응용 적용 할 수 있음

(3) 네트워크 비콘 및 게이트웨어 비콘 개발

연구과제명	관제형 네트워크 비콘 및 게이트웨이 비콘 개발
-------	---------------------------

연구결과	1) Bluetooth Low Energy 통신 기술에 기반한 메쉬 네트워크를 지원하는 비콘 장치 개발 2) 네트워크 비콘들과 일반형 비콘들을 관제하고 스캔하는 게이트웨이 비콘 개발 3) 게이트웨이 비콘을 컨트롤하는 클라우드 플랫폼 개발
기대효과	1) 주요 통신사에 O2O 용 일반형 비콘, 관제형 네트워크 비콘, 게이트웨이 비콘 및 플랫폼 공급 중 2) 스마트 호텔, 관공서, 작업장, 아파트 향으로 솔루션 공급 추진 중 3) 스마트 물류용 솔루션 개발에 토대가 됨

(4) Bio Intra-oral flexible package 상용기술개발

연구과제명	치과용 Bio intra-oral flexible sensor package 기술 개발
연구결과	1) 인체 구강의 형상에 따라 휘어지는 치과용 x-ray detector sensor packaging 기술 개발 2) 치아를 감을 수 있는 정도로 휘어지면서 기존 rigid 제품과 유사한 기능과 신뢰성까지 확보 3) CIS 등 실리콘 기반의 두껍고 잘 휘지 않는 칩을 유연하게 만드는 공정과 소재 기술 확보
기대효과	1) 인체의 형상에 따라 휘어지는 치과용 x-ray detector 세계최초 상용기술 확보 2) 다양한 Wearable device에 적용 할 수 있는 반도체 flexible packaging 기반 기술 확보

(5) Fingerprint Sensor package 상용기술개발

연구과제명	지문인식 센서 package 기술 개발
연구결과	1) 스마트폰용 정전방식의 지문인식 패키지 개발 2) Low loop height wire Bonding 기술 확보($\leq 30\mu\text{m}$) 3) FPS용 High Dk EMC 개발($Dk=4, 7$) 4) Thin mold Clearance 기술 개발($\leq 50\mu\text{m}$)
기대효과	1) 양산 제품에 적용 및 신규 고객 Promotion 진행 2) FPS 관련 선행 기술 확보 및 중국 시장공략 가능성 확보

(6) Thick Cu 재배선

연구과제명	Thick RDL 기술 개발
연구결과	1) Wired Charger용 두꺼운 구리 도금 배선 공정 개발 2) Thick plating solution 기술 확보 3) Thick passivation coverage 기술 확보 4) 재배선 영역 확대 기술 확보
기대효과	1) 기존 WLCSP 대비 전력효율 향상을 통한 고 기능소자 제작 기반기술 확보 2) 전력 반도체(PMIC) 및 충전 소자(Charge IC) 등 다양한 application WLCSP 상용화 기술 확보

(7) 3차원 플렉서블 반도체 패키징

연구과제명	3차원 플렉서블 반도체 패키징 기술개발
연구결과	1) 실리콘 기반 반도체 소자를 여러 층으로 적층해도 구부러지고, 전기 접속을 유지할 수 있는 유연한 기계적 특성의 패키징 기술 확보 2) 2층으로 적층된 3차원 플렉서블 반도체 패키지를 굽힘 반경 10mm로 굽혔다 폼다를 10,000번 반복해도 전기적 특성 변화 없는 성능을 유지

기대효과	1) 이번에 개발한 3차원 플렉서블 반도체 패키징 기술은 미국과 유럽 등에서 컨소시엄을 구성해 개발하고 있는 것보다 앞선 세계 최초의 기술 2) 웨어러블디바이스, 스마트카드, 센서 모듈, 메디컬 디바이스 등 실리콘 웨이퍼 기반 디바이스 시장 고속 성장으로 활용가치 증폭
------	---

(8) 디스플레이 일체형 지문인식 모듈 개발

연구과제명	디스플레이 일체형 지문인식 모듈 개발
연구결과	1) 차별화된 광학구조를 적용한 지문인식 모듈 개발로 기존 제품의 문제점을 완벽하게 보완하면서도 모듈 자체의 두께가 매우 얇은 세계 최고의 지문인식 기술 확보 2) 기존 제품의 문제점인 Dry-finger(건조한 손의 지문 인식 어려움), Sunlight(태양광이 강한 곳에서 지문 인식 어려움), 2D Fake(2D 지문 위조) 이슈를 완벽하게 해결
기대효과	1) 세계 최고 수준의 디스플레이 일체형(언더디스플레이) 지문인식 모듈 공정 개발로 최근 급성장하고 있는 디스플레이 일체형 지문인식센서 시장에서의 수혜 예상

(9) 스마트카드용 지문인식 모듈 개발

연구과제명	스마트카드용 지문인식 모듈 개발
연구결과	1)스마트카드에 지문인식 모듈을 탑재하려면 Bending(2축 굽힘), Twist(비틀림), Wrapping(형상 굽힘) 등 다수의 ISO(국제표준기구) 신뢰성 시험을 통과 2) 기존 반도체 패키징 기술보다 한층 얇고 유연한 패키징 기술이 필수적으로 독자적으로 개발한 유연 패키징 기술 '하나플렉스(HANAflexTM)'를 활용 높은 신뢰성과 내구도를 확보
기대효과	1) 글로벌 카드사들이 스마트카드 상용화를 추진하는 상황에서 신용카드에 탑재 가능한 얇고 유연한 지문인식 모듈을 개발함으로써 카드 시장 진출에 교두보를 마련할 수 있게됨

(10) PCIe Gen3(x4) NVMe M.2 SSD 개발

연구과제명	PC용 Sequential Read 2Gbps급 M.2 SSD 개발
연구결과	1)PCIe Gen3(x4) M.2 22*80mm PCB 개발 2) 2.2Gbps급 Sequential Read성능, 3.5W급 저전력 제품 개발 3) 두께 2.3mm로 lap-top PC에 적합한 보급형 250GB/128GB 확보 4) NVMe protocol test용GUI환경auto-test program 개발
기대효과	1) 다양한 M.2 form-factor PCB design 능력 확보 및 원가 최적화 기반Mid-end급 SSD design 능력 확보로 Low-cost/ High-end급 SSD개발 가능

(11) 메디컬 패치용 ECG sensor module 기술 개발

연구과제명	메디컬 디바이스용 Bendable & Thin packaging 기술 개발
연구결과	1) 저전력 ECG 센서 모니터링 기술 개발 (≤1mA) 2) low latency 모니터링 기술 개발 (≤5mS) 3) ECG 신호 필터 및 Heart Rate / S-T 등 데이터 추출 알고리즘 개발 4) 유연(Flexible) 점착용 하이드로겔 소자 적용 공정기술 개발 5) 유연 인체 무해한 ECG 패치 및 디바이스 개발
기대효과	1) 저전력 기술 확보로 보다 에너지 효율적인 제품 개발이 가능 2) 데이터 알고리즘 기술 확보로 데이터 신뢰성 향상과 안정성 향상 3) BLE(Bluetooth Low Energy) 통신의 저 전력 설계기술을 통한 타사대비 3배의 Battery Life 향상

【반도체 재료부문】

구분	연구과제명	연구내용 및 기대효과	개발시기
1	480mm 단결정 실리콘 잉곳 성장기술 개발	450mm 웨이퍼 공정에 필요한 실리콘 부품을 직접 공급함으로써 수입대체, 원가절감, 생산성 향상에 기여	2011년
2	Growth reaction 탄화규소 부품개발	Growth reaction 탄화규소(SiC) Focus Ring을 개발함으로써 회사의 수익성 개선에 기여	2015년
3	반도체 공정용 CVD SiC F/R 개발	CVD 탄화규소(SiC) F/R을 개발함으로써 회사의 수익성 개선에 기여	2017년
4	비저항 수율 향상된 Si Ingot 개발	High resistivity ingot의 spec out loss 감소 및 고부가가치(70~80Ωcm) 제품을 개발함으로써 수익성 개선	2018년
5	정전척(ESC Chuck)용 알루미늄(AI2O3)개발	완성도 높은 알루미늄의 플레이트 공급을 통해 매출 증대 기여	2018년
6	CVD SiC Coating 기술 개발	Susceptor Coating으로 확대하여 기술력 향상	2018년
7	반도체히터용 AlN 소재개발	회사의 사업다양화를 통한 안정적인 수익창출에 기여	2018년
8	대구경 단결정 실리콘 소재 개발	고밀도 플라즈마 장비 부품용 대구경 단결정 실리콘 소재 개발을 통한 대구경 부품 제조 기술확보	2019년 ~ 2021년

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황(특허권등)

연결실체는 영위하는 사업과 관련하여 국내 149건, 해외 12건의 등록된 특허권을 다수 보유하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 지적재산권의 보유 현황은 다음과 같습니다.

구분	국내	해외	합계
특허	149	12	161
실용신안	2		2
상표	4	1	5
디자인	2		2
합계	157	13	170

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유현황(상세)' 참조

나. 법규, 정부 규제에 관한 사항

※ 해당사항이 없습니다.

다. 환경 관련 규제사항

연결실체는 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에

적극적으로 대응하고 있으며, 사업장 내 발생하는 환경오염물질의 저감, 자원의 효율적 이용, 환경경영체계 구축을 통해 환경 보전 및 지속가능한 사회발전이 되도록 최선의 노력을 다하고 있습니다. 효율적인 관리를 위해 환경경영시스템(ISO14001) 인증을 완료하였습니다.

(1) 온실가스 배출 관리

연결실체는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제42조에 따라 2012년 6월 29일 온실가스 목표 관리업체로 지정되었으며, 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조에 따라 2014년 9월 12일 온실가스배출권 할당대상 업체로 지정되었습니다. 이에 온실가스, 에너지 배출 목표량 및 할당량을 달성하기 위해 추가적인 규제 준수비용 및 온실가스 배출권구매비용이 수반 될 수 있습니다. 연결실체는 체계적인 에너지 관리 시스템 구축 및 감축 활동을 통해 온실가스 감축 목표를 달성할 계획입니다.

또한, 당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 정부에 보고하고 있으며, 정부에 보고한 명세서에 따른 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

구분	2023년	2022년	2021년
온실가스(tCO2e)	38,138	39,895	33,355
에너지(TJ)	772	830	693

라. 산업분석 등

[반도체 제조 부문]

(1) 반도체 산업의 개요

반도체 산업은 정보통신산업, 전기·전자산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 첨단산업에 없어서는 안될 핵심산업으로서 우리 생활의 3대 필수요소로 공기, 물, 그리고 반도체라고 할 수 있을 정도로 일상생활과 매우 밀접한 관계가 되었습니다. 반도체 산업은 산업의 고유 성격인 첨단성, 기능성으로 인해 미래 첨단산업 분야의 기술향상을 이끄는 중요한 동력원이 되고 있으며 특히 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요산업의 생산구조 고도화를 위한 기간산업이라 불리고 있습니다.

반도체산업은 크게 반도체 소자제조업, 반도체장비 및 원·부자재 제조업등을 모두 포함하며 반도체 산업의 인프라를 구성하는 기초·기반기술, 지식산업으로 구분할 수 있으며, 작게는 설계, 웨이퍼가공, 조립 및 테스트 사업부문으로 나눌 수 있습니다.

구분	특징	주요기업
종합 반도체 기업 (IDM)	·설계, WAFER 가공, 조립, 마케팅을 일괄수행 ·대규모 R&D 및 설비투자 필요	한국: 삼성전자, SK하이닉스 미국: Intel, Texas Instruments, Micron 일본: Toshiba, Renesas
패키징 전문기업	·가공된 Wafer의 조립/Packaging 전문 ·축적된 경험 및 거래선 확보 필요	한국: SFA반도체, 시그네틱스 대만: ASE, ChipMOS 미국: Amkor Technology
Foundry 업체	·Wafer 가공 및 Chip 제조 전문 업체 ·초기 설비투자 규모가 크고, 적정생산 규모 필요	한국: 동부하이텍, 매그나칩 대만: TSMC, UMC 중국: SMIC
설계 전문 기업	·생산설비 없는 IC 디자인 전문회사 ·창의적인 인력 및 기술력 필요	한국: 실리콘웍스, 엠텍비전 미국: Qualcomm, Broadcom, AMD

(2) 반도체 패키징 사업의 개요

반도체 패키징은 회로가 설계된 반도체 칩에 전기적 특성 등을 전달 할 수 있도록 연결하고 외부환경으로부터 안전하게 보호하기 위한 성형을 하여 다른 회로부품이나 인쇄회로기판과의 전기적 연결기능을 제공하는 역할을 수행하고 있어 반도체 패키징은 반도체 칩(소자)을 제품화하는 최종 결과물입니다. 최근에는 디지털 네트워크의 정보화 사회로의 급속한 진전으로 고성능, 고기능화(복합화, 융합화)와 소형화의 요구에 따라 반도체 패키징 기술이 더더욱 중요한 자리를 차지하게 되었으며, 최근에는 칩 사이즈와 동일한 크기의 CSP(Chip Size Package)와 여러개의 칩을 하나의 패키지로 구성한 MCP(Multi Chip Package), SiP(System in Package) 등 초소형화와 복합화로 발전하고 있습니다.

(3) 반도체 산업의 특성

반도체 산업의 특성은 첨단 과학 및 산업 모든 분야 전반에 걸쳐 막대한 영향으로 국가의 첨단 기술과 경쟁력을 향상시키는 견인차 역할을 수행하고 있으며, 대규모의 설비투자과 연구개발 투자가 수조원 이상 소요 되어 경기 변동과 기술의 변화속도를 리드해 나가는 타이밍 산업인 관계로 반도체 싸이클을 잘 관리하는 능력이 사업의 중요한 승패요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 반도체 산업은 부가가치 체인별 분업화가 급속히 확산되어 단일기업의 수직계열 생산체제에서 설계전문(Fabless), 파운드리전문, 패키징전문기업 등으로 전문화되고 있습니다.

따라서, 패키징 산업은 대규모 종합반도체회사와 설계전문회사, 파운드리 전문회사와의 네트워크가 잘 이루어져야만 원가, 납기, 품질 등 전체 제품의 경쟁력을 갖추수가 있으며 최근 모바일기기 및 정보기기 시장의 다양화로 패키지 형태는 더욱 더 소형화, 복합다양화가 되어감에 따라 부가가치를 높이는 첨단산업으로서 역할을 하고 있습니다.

(4) 산업의 성장성

1980년대 이후 급속한 발전을 이루어 온 국내 반도체 산업은 단일품목으로는 1992년 이래국가 총수출의 10% 정도를 차지할 정도로 우리경제의 중추적 역할을 수행하고 있습니다. 전방산업인 Set 시장 및 소비가전 시장의 확대와 모바일 인터넷 확산에 따른 스마트폰, 태블릿PC 등 인터넷 가능기기의 고성장 및 노트북을 포함한 PC 시장의 지속 성장으로 반도체 시장규모는 더욱 확대될 전망입니다. 반도체 패키징 산업 또한 반도체 산업 전반과 맥락을 같이하여 삼성전자, 하이닉스 등에서 제조되는 소자를 최종 사용자의 요구 규격에 맞도록 패키징 전문 업체에서 패키징 해야하는 필연적인 관계를 유지하고 있으며, 신 패키지 개발에 동참하여 반도체 산업 전체에 차지하는 비중은 날로 높아져 가고 있습니다.

(5) 경쟁요소

패키징 사업의 최고의 경쟁수단은 최단 납기와 최고의 품질관리 입니다. 반도체 패키징은 웨이퍼로부터 가공된 칩을 외부환경으로부터 안전하게 보호해주는 기능과 함께 인쇄회로 기판에 원활한 기능적 연결을 수행하기 위해 표준화된 패키지 외형을 가지도록 여러 조립과정을 거쳐 최종 반도체 완제품을 만들게 됩니다. 패키지 조립과정은 고가의 시설과 기술, 그리고 각 공정마다 엄격한 품질관리를 필요로 하며 패키징의 문제가 발생시에는 셋트제품까지 문제가 발생하는 중요한 사업으로 최고의 품질이 요구됩니다. 이를 위하여 안정적인 인력수급을 바탕으로 한 숙련된 노동력이 필요로 합니다.

또한, 장치산업의 특성상 높은 투자와 제반 인프라를 유지하여야 하는 관계로 많은 고정비가 필요로 합니다. 따라서 가격 경쟁력을 갖기 위해서는 제품마다의 생산규모를 키우고, 설비의 가동율을 높여야 하며, 차별화된 생산인프라를 갖추어야 하므로 반도체 패키징 산업은 이른바 '규모의 경제'가 핵심요소라 할 수 있습니다.

(6) 영업개황

당사는 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고있으며 업

계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있는 전문 엔지니어들로 구성되어 있는 반도체 패키징 전문 기업입니다.

반도체 패키징 사업은 반도체 IC를 컴퓨터, 정보통신기기, 산업용기기, 가전제품 등에 실장하기 위하여 일정한 소재기판을 이용, IC를 접합시키는 분야로 각 패키지별 제조설비 및 공정 보유여부, 공정 및 설비기술 대응 능력, 주문에 따른 단기납기 대응 능력과 엄격한 품질관리 능력, 원가수준 등이 요구됩니다.

당사는 현재 최고의 품질과 원가경쟁력으로 삼성전자, 하이닉스 등 종합반도체회사로부터의 수주량 및 수주제품군이 지속적으로 증가하고 있으며 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 삼성전자 및 하이닉스를 안정적인 수요처로 경쟁력을 강화함은 물론 파운드리 업체와 팹리스 업체로 수요처를 넓혀감으로써 수익성 제고 및 시장확대를 가속화하고 있습니다.

(7) 시장점유율 등

당사의 주요 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스의 경우, 반도체 패키징을 당사 외에 앰코코리아, ASE 코리아, SFA반도체, 시그네틱스 등으로부터 공급 받고 있습니다. 시장점유율은 반도체 패키징의 국내 시장규모 및 시장점유율에 대한 객관적인 자료가 존재하지 않아 정확한 규모를 확인하기 어려우나, 글로벌 패키징 업체를 제외한 국내 주요 패키징 업체들의연간 매출액 규모로 추정해 볼 때, 국내 주요 패키징 업체들간의 점유율은 서로 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

[반도체 재료 부문]

(1) 반도체 재료 산업의 개요

반도체재료란 반도체 소자를 직접 구성하는 재료, 소자를 제조하는데 사용되는 소재, 소자를 조립하여 완성품을 만드는데 사용되는 재료를 모두 포함합니다. 반도체 소자를 완성하기 위해서는 수십 단계의 물리적, 화학적 처리가 필요하며 이러한 공정을 위해서는 소자를 직접적으로 구성하는 소재뿐만 아니라 공정상의 화학적 처리만을 위해서 이용되는 재료, 공정 과정 중의 소모성 부품도 필요하므로 매우 넓은 범위의 재료산업의 뒷받침이 필요합니다.

반도체 재료를 기능상으로 분류하면 기능재료, 공정재료, 구조재료 등의 크게 세 가지로 분류할 수 있으며 반도체 제조공정에 따라 전공정재료와 후공정재료로 분류됩니다. 일반적으로 기능재료와 공정재료는 전공정재료에 해당되고 구조재료는 후공정에 해당됩니다. 또한 기능상 분류에서 당사의 제품영역인 장비재료를 별도로 분류하기도 합니다.

【반도체 재료의 기능적 구분】

구분	종류	용도
기능재료	웨이퍼	칩의 기판
공정재료	포토마스크	석영유리에 회로를 묘화한 회로도 원판
	펠리클	마스크의 오염방지를 위한 보호막
	포토리지스트	웨이퍼에 회로를 인쇄하기 위한 감광제
	공정가스	성막, 에칭, 도핑 등에 사용되는 다종의 가스
	화학약품	세정, 에칭, 리소그라피 공정에 사용
	배선재료	웨이퍼 상에 주입되어 회로로 사용
구조재료	PCB	칩과 외부회로와의 접속을 위한 지지대
	본딩와이어	칩과 리드프레임을 연결
	봉지재	칩을 밀봉하기 위한 Epoxy수지

주) 자료 : 반도체산업협회

(2) 반도체 재료 사업의 개요

반도체 재료 중 기능재료인 실리콘 웨이퍼, 공정재료인 포토마스크, 구조재료인 리드프레임이 전체시장의 60% 정도를 차지하고 있습니다.

【3대 반도체 재료】

구분	정의
웨이퍼 (Wafer)	반도체 물질 또는 기판 위에 부착된 물질로서 얇은 판 또는 평평한 디스크 모양으로 하나 이상의 회로나 디바이스가 동시에 공정이 진행된 다음 Chip 상태로 나누어짐.
포토마스크 (Photomask)	웨이퍼 위에 그려질 회로패턴의 모양을 유리판 위에 그려놓은 것으로 각 패턴은 빛을 막는 불투명지역과 통과시키는 투명지역이 있음. 포토마스크는 이물질, 크롬과 같은 물질을 석영판 위에 입혀 만듦.
PCB (Printed Circuit Board)	회로 설계를 근거로 하여 부품을 접속하는 전기배선을 배선도형 형태로 절연 물상의 동박에 형성하여 전기도체로 표현된 제품임 원판인 동박 적층판(Copper CLAD Laminated Board) 주재료와 다층 PCB (동박 Copper , 절연체 Prepreg), Pattern (Dry Flim) 알카리 약품, 불변성 잉크) 등의 부재료가 사용됨

기능 재료인 실리콘 웨이퍼는 반도체의 근간이 되는 소재로서 컴퓨터, 통신 제품, 소비가전을 포함한 거의 모든 전자제품의 필수 부품입니다. 고도의 기술이 필요한 박막 원형 디스크 모양의 실리콘 웨이퍼는 다양한 크기(지름 6인치~12인치)로 제작되며, 대부분의 반도체 기기, 칩 제작의 기판재료로 사용됩니다. 실리콘 웨이퍼의 원료인 실리콘(Silicon)은 현재 가장 훌륭한 반도체 재료로 사용되고 있습니다. 실리콘은 일반적으로 산화물인 SiO₂의 형태로 모래, 암석, 광석 등으로 존재하며, 이들은 지각의 1/3 정도를 구성하고 있어 지구상에 매우 풍부하게 존재하여 반도체 산업에 매우 안정적으로 공급될 수 있는 재료인 동시에 독성이 전혀 없어 환경적으로도 매우 우수한 재료입니다. 이러한 장점으로 인하여 실리콘은 반도체 산업에서 다양한 형태로 이용되며 전자제품, 산업용 기계, 인공위성 등 모든 산업분야에서 없어서는 안 될 매우 중요한 소재로 각광받고 있습니다.

(3) 반도체 재료산업의 특성

반도체 재료산업은 반도체 소자의 고집적화에 따라 높은 정밀도의 재료가 요구되므로, 소자업체의 공정전환에 따라 새로운 재료의 개발을 위한 R&D투자가 필수적이며, 정밀가공 및 분석을 위한 고급 기술인력 및 고가의 장비가 필요하고 신소재 개발 및 물성분석기술을 선도하기 때문에 기술적 파급효과가 큰 첨단산업이라 할 수 있습니다. 특히 나노기술시대에 진입하면서 차세대 반도체 소자의 개발에 필요한 재료들의 기능이 매우 중요한 기술적 인자로 부각됨에 따라 반도체 재료산업이 첨단화 되어가고 있습니다. 즉 기술적 중요성이 재료산업의 가장 큰 특성이라 할 수 있습니다.

반도체 재료산업의 또 다른 특성은 진입장벽의 초기효과가 매우 크다는 것입니다. 반도체 재료는 반도체 제조원가에서 차지하는 비중이 타산업에 비해 상대적으로 낮은 반면, 전체 수율 및 불량 발생에는 절대적인 영향을 미친다는 이유로 소자업체들이 수급선 전환을 꺼리는 특성을 갖습니다. 이는 초기 진입업체에게 유리한 환경을 조성합니다. 또한 반도체의 라이프사이클이 짧아지면서 소재의 라이프사이클도 동일하게 짧아지고 있는 경향을 보이는데, 이는 기술의 변화속도가 매우 빠름을 보여주고 있습니다. 기존 기술에 의한 재료의 경우 단가인하 압력에서 자유롭지 못하나, 신기술의 경우 다시 초기효과를 누리는 중점구조를 갖게 됩니다. 이러한 초기 진입효과와 빠른 기술변화 속도는 결과적으로 반도체 재료산업의 높은 진입장벽적 특성을 나타내고 있습니다.

(4) 반도체 재료 산업의 성장성

세계 반도체 재료산업은 전방산업인 반도체 소자산업에 직접적 연관성을 갖습니다. 과거 재료산업의 성장을 변동폭은 반도체 경기 사이클보다 작은 것이 특징이었습니다. 그러나 2006년 이후 12인치 웨이퍼 비중 확대 및 신규 패키징 등장으로 기존 반도체 재료 및 신소재의 소요량이 증가하며 재료산업의 성장을 변동폭이 확대되는 추세에 있습니다. 공정 진화가 빠른 국내 반도체 시장에서는 이러한 모습이 더욱 강화되고 있는 것으로 추정되며 비메모리 비중이 높은 세계 반도체 재료시장의 성장 속도는 완만한 모습을 그릴 것으로 예상할 수 있습니다.

(5) 영업개황

연결실체의 반도체 재료부문이 현재 영위하고 있는 주력 사업분야는 반도체의 핵심 제조공정인 에칭(식각) 공정에 사용되는 Silicon 소재의 Electrode, Ring 등 소모성 구조기능성 부품(Parts)의 제조입니다. 제4차 산업혁명의 도래와 IT산업의 눈부신 성장에 기인하여 반도체산업은 소자의 고집적화 및 반도체 Wafer의 대구경화에 따라 반도체공정의 생산성과 수율향상이 반도체산업의 성패를 좌우할 만큼 중요해지고 있으며, 당사의 대구경 단결정 Silicon Ingot 성장과 정밀 부품가공 기술의 중요성이 부각되고 있습니다. 반도체 Wafer의 재료인 Silicon과의 친화성을 높이기 위해 반도체 제조 관련 Silicon 부품의 수요가 지속 증가하고 있습니다. 또한 당사는 Tokyo Electron, 세메스를 비롯한 장비 제조업체와 삼성전자 등 반도체 제조업체를 고객으로 확보하고 있어 기술력과 품질수준은 검증되어 있으며, 향후 실리콘 부품의 비중 증가에 따라 매출이 확대될 것으로 보고 있습니다.

이중 Silicon 소재는 반도체산업에서 사용되는 가장 기초적인 고기능성 소재이면서 고부가가치소재입니다. 반도체 재료 사업부문은 반도체 공정, 특히 Etching 장비용 구조기능성의 소모성 부품을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 반도체 공정의 미세화와 기술 전환 및 3D 적층화 등의 변화로 인해 당사 부품의 공급량은 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 반도체 FAB의 가동률이 부품의 수요에 가장 큰 영향요인으로 FAB 가동률이 높을수록 부품의 사용빈도가 증가합니다. 또한 FAB 투자규모의 증가에 따라 영향력이 있으며, FAB 투자를 결정하는 가장 큰 요인은 DRAM, NAND, 시스템반도체 등 반도체 소자를 사용하는 모바일기기, 휴대폰, 태블릿, PC, 서버 등 전자제품 수요 및 국내외 경기의 영향을 받게 됩니다. 메모리반도체의 수요 증대에 의한 생산설비의 추가 및 반도체 FAB의 신설 등 투자 증가로 연결실체의 반도체재료 부문의 부품 수요도 상대적으로 크게 나타날 것으로 전망됩니다. SEMI(국제반도체장비재료협회)의 전망에 따르면 반도체 장비시장은 2023년에는 업황에 따른 일시적 감소가 있을 것으로 예상되나, 세계 각국의 반도체산업 투자의 영향으로 이후에는 반도체 시장의 성장이 두드러질 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따른 반도체 장비시장의 성장 및 규모 확대는 반도체 장비 소모성부품의 수요증가 및 규모확대로 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

[세그먼트 별 반도체 장비 매출 전망]

(단위 : 십억달러)	2022	2023F	2024F	2025F
Assembly & packaging Equipment	5.78	3.99	4.95	5.95
Test Equipment	7.52	6.32	7.20	8.42
Wafer Fab Equipment	94.10	90.59	93.16	109.76
Total Market	107.40	100.90	105.31	124.13

※ 자료 : SEMI (2023년 12월)

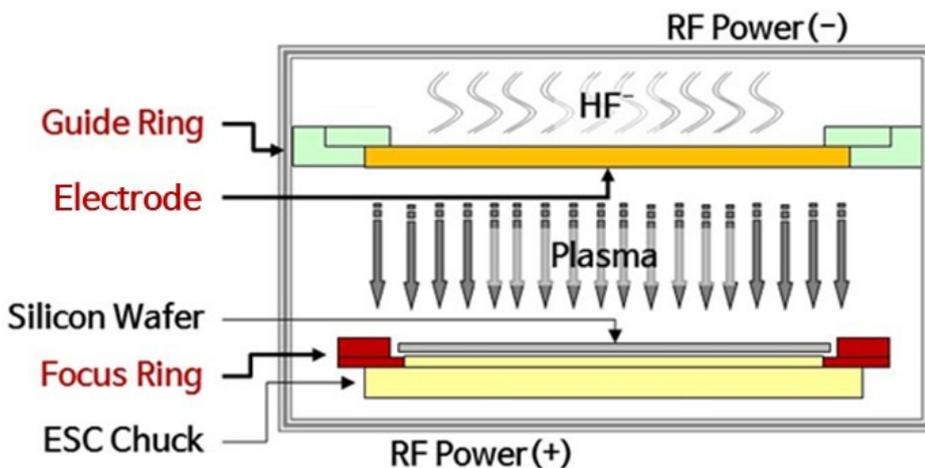
(6) 주요 제품

반도체 재료부문의 제품은 반도체 제조공정 중 에칭공정에 사용되는 핵심부품인 Silicon 소재의

Electrode와 Ring 등으로 에칭시 식각 능력을 좌우할 만큼 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품입니다.

제품	적용공정	기능 및 용도
Electrode	Dry Etching	·Gas를 통과시켜 Si Wafer의 표면에 각종 가스를 일정하게 분사시켜 주는 역할
Ring	Dry Etching	·챔버(Chamber)내에서 플라즈마가 정확한 위치로 모여지도록 하는 역할 ·Electrode를 웨이퍼에 평행하게 고정시켜주는 역할

아래의 그림에서 보시는 바와 같이 Electrode는 Plasma Etching 공정에서 Gas를 균일하게 흘려주고 Plasma를 균일하게 생성시켜 Wafer에 미세선을 Etching하는 반도체 부품이고, Ring은 Plasma Etching 공정의 핵심 부품으로 Electrode에서 생성된 Plasma가 Wafer에 균일하게 퍼지도록 안내해주는 역할과 하부의 ESC(정전척)을 보호하는 반도체 부품입니다. Silicon Ring 및 Electrode는 소모성 부품으로 Etching 공정의 식각 비율에 영향을 미쳐 반도체 소자의 수율을 좌우하며, 최근 공정기술의 미세화로 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.



- Guide Ring : Electrode를 Wafer에 평행하게 고정시켜주는 역할
- Focus Ring : Plasma가 정확한 위치로 모여지도록 하는 역할
- Electrode: Gas를 통과시켜 Wafer 표면에 Plasma를 균일하게 분사시킴

※ 자료 : 업계 자료

(7) 사업의 경쟁력을 좌우하는 요인 및 경쟁우위 사항

당사는 Ingot 생산(소재기술)부터 부품 가공(가공기술), 세정(에칭기술) 등 일관생산공정 프로세스를 구축하고 있으며 이를 통해 고객이 원하는 납기와 품질 수준으로 경쟁우위의 제품을 공급하고 있습니다.

이에 따른 당사의 경쟁우위 사항은 ① 최적의 잉곳 성장 기술력 확보, ② 일관생산 프로세스 구축, ③ 정밀 부품가공 기술 확보, ④ 글로벌 메이저 장비업체의 정품 공급 등이 있습니다.

(8) 신규 사업

주요종속회사인 하나머티리얼즈(주)는 실리콘부품 위주의 사업구조에서 사업 및 제품 포트폴리오를 다각화하고자 파인세라믹부품사업(SiC)을 추진하고 있습니다. 이를 통해 반도체 제조공정 변화에 유연하게 대처하고, 반도체 부품 소재를 다양화하여 사업경쟁력을 강화하고자 합니다. 이는 최근 반도체 공정에서의 고집적도를 위한 선풍 미세화에 따른 고밀도 플라즈마 환경의 도입과 Dry Etching 공정 도입이 확산되면서 고온 공정의 제어 필요성이 확대되고 있는 상황에 대응하고자 합니다.

- 신규사업 내용

신규사업 추진을 위한 신제품 개발 내용은 아래와 같습니다.

신규사업	주요 내용
CVD SiC	·반도체 공정용 CVD SiC Parts 개발 ·CVD SiC Ring 양산을 통한 매출 및 수익성 증대

III. 재무에 관한 사항

아래 제24기1분기, 제23기, 제22기 요약(연결)재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 외부감사인으로부터 감사(검토)를 받은 재무정보입니다.

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제24기 1분기 (2024년03월31일)	제23기 (2023년12월31일)	제22기 (2022년12월31일)
[유동자산]	509,804,209	431,596,264	383,477,864
· 현금및현금성자산	104,456,333	106,682,628	100,683,159
· 단기금융상품	12,169,958	6,476,837	2,284,659
· 매출채권및기타채권	168,240,113	102,860,134	82,770,349
· 당기손익-공정가치측정금융자산	8,177,552	23,874,627	
· 재고자산	189,831,576	172,006,809	182,894,202
· 기타유동자산	26,928,677	19,695,229	14,845,495
[비유동자산]	1,295,105,363	1,293,493,868	1,025,570,931
· 유형자산	1,020,613,542	1,002,455,956	807,665,219
· 무형자산	36,919,832	35,898,065	20,939,321
· 투자자산	217,494,722	228,517,085	175,587,199
· 매각예정자산	1,097,350	6,774,195	1,097,350
· 기타비유동자산	18,979,918	19,848,567	20,281,843
자산총계	1,804,909,572	1,725,090,132	1,409,048,795
[유동부채]	705,295,703	644,682,194	442,084,131
[비유동부채]	570,791,700	536,020,568	478,749,144
부채총계	1,276,087,403	1,180,702,762	920,833,275
[지배기업 소유주지분]	294,338,034	309,057,769	264,109,940
· 자본금	26,068,238	23,989,927	23,960,927
· 기타불입자본	192,801,202	194,351,207	140,140,631
· 기타자본구성요소	35,412,693	30,498,248	23,117,370
· 이익잉여금	40,055,901	60,218,387	76,891,012
[비지배지분]	234,484,136	235,329,601	224,105,580
자본총계	528,822,170	544,387,369	488,215,520
부채 및 자본총계	1,804,909,572	1,725,090,132	1,409,048,795

구	단	(2024년01월01일~ 2024년03월31일)	(2023년01월01일~ 2023년12월31일)	(2022년01월01일~ 2022년12월31일)
매출액		268,960,709	967,971,485	894,395,892
영업이익		10,826,212	57,904,676	103,548,272
법인세비용차감전순이익(손실)		(20,356,825)	13,978,753	90,660,181
당기순이익(손실)		(16,855,504)	963,095	58,230,572
지배기업 소유주지분		(18,110,351)	(13,513,956)	2,830,148
비지배지분		1,254,847	14,477,051	55,400,423
기타포괄이익(손실)		5,054,941	5,992,236	8,033,417
총포괄손익		(11,800,563)	6,955,331	66,263,989
지배기업 소유주지분		(13,086,252)	(7,132,859)	9,796,316
비지배지분		1,285,688	14,088,190	56,467,673
지배지분에 대한 주당손익(원)		(411)	(313)	66
연결에 포함된 회사수		13	13	12

나. 요약별도재무정보

(단위 : 천원)

구	분	제24기 1분기 (2024년03월31일)	제23기 (2023년12월31일)	제22기 (2022년12월31일)
[유동자산]		316,397,411	251,527,079	261,639,321
· 현금및현금성자산		53,870,397	17,507,687	26,842,043
· 단기금융상품				373,749
· 매출채권및기타채권		194,763,221	165,411,303	185,479,533
· 당기손익-공정가치측정금융자산		9,073,573	24,791,650	
· 재고자산		37,722,018	26,801,454	40,888,053
· 기타유동자산		20,968,202	17,014,985	8,055,942
[비유동자산]		713,160,964	731,673,700	685,068,608
· 유형자산		292,458,306	292,145,433	288,566,988
· 무형자산		5,302,834	4,275,133	5,101,219
· 종속,공동기업투자주식		255,846,458	269,444,695	237,147,801
· 투자자산		56,832,964	64,519,901	59,658,569
· 매각예정자산		1,097,350	1,097,350	1,097,350
· 기타비유동자산		101,623,053	100,191,188	93,496,680
자산총계		1,029,558,375	983,200,779	946,707,929
[유동부채]		483,721,291	453,530,225	315,209,546
[비유동부채]		190,143,802	156,600,915	273,640,802
부채총계		673,865,092	610,131,140	588,850,348
[자본금]		26,068,238	23,989,927	23,960,927
[기타불입자본]		265,380,112	266,930,117	212,719,541

[기타자본구성요소]	21,096,731	16,793,184	9,760,022
[이익잉여금]	43,148,203	65,356,412	111,417,090
자본총계	355,693,283	373,069,640	357,857,581
부채 및 자본총계	1,029,558,375	983,200,779	946,707,929
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법
구 분	(2024년01월01일~ 2024년03월31일)	(2023년01월01일~ 2023년12월31일)	(2022년01월01일~ 2022년12월31일)
매출액	177,404,049	581,861,179	608,136,889
영업이익	6,312,727	16,672,502	52,170,309
법인세비용차감전순이익(손실)	(25,913,734)	(36,569,870)	35,157,763
당기순이익(손실)	(19,902,592)	(42,986,958)	16,537,524
기타포괄이익(손실)	4,396,922	6,355,534	7,628,626
총포괄손익	(15,505,669)	(36,631,424)	24,166,150
주당순손익(원)	(408)	(897)	345

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 24 기 1분기말 2024.03.31 현재

제 23 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 24 기 1분기말	제 23 기말
자산		
Ⅰ.유동자산	509,804,209,073	431,596,263,534
(1)현금및현금성자산	104,456,333,088	106,682,628,169
(2)단기금융상품	12,169,957,800	6,476,837,224
(3)매출채권	137,103,089,529	80,582,932,855
(4)계약자산	16,031,509,549	13,700,732,975
(5)당기손익-공정가치측정금융자산	8,177,551,822	23,874,627,387
(6)기타유동금융자산	15,105,514,136	8,576,467,712
(7)기타유동자산	21,126,997,840	18,457,751,492
(8)당기법인세자산	5,801,679,482	1,237,477,111
(9)재고자산	187,574,313,589	169,749,546,371
(10)계약원가	2,257,262,238	2,257,262,238
Ⅱ.매각예정비유동자산	1,097,350,091	6,774,195,237
Ⅲ.비유동자산	1,294,008,013,241	1,286,719,673,103
(1)장기금융상품	883,320,119	373,030,371
(2)당기손익-공정가치측정금융자산	7,567,603,800	9,250,659,500
(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,111,743,031	1,111,743,031

(4)기타비유동금융자산	3,356,526,138	2,532,707,833
(5)기타비유동자산	4,442,181,383	4,652,199,805
(6)유형자산	1,020,613,541,560	1,002,455,955,877
(7)투자부동산	207,746,487,038	218,154,682,723
(8)무형자산	36,919,831,722	35,898,064,966
(9)사용권자산	5,593,018,887	5,883,295,165
(10)공동기업및관계기업투자주식	1,068,887,672	
(11)순확정급여자산	4,704,871,891	6,407,333,832
자산총계	1,804,909,572,405	1,725,090,131,874
부채		
Ⅰ.유동부채	705,295,702,519	644,682,194,150
(1)매입채무	95,133,636,821	55,901,275,754
(2)당기손익-공정가치측정금융부채	1,575,830,583	
(3)기타유동금융부채	126,358,709,643	105,687,837,826
(4)단기차입금	333,721,466,852	292,300,675,995
(5)유동성장기차입금	65,847,778,481	63,664,196,114
(6)유동성사채	74,853,835,083	119,743,384,756
(7)당기법인세부채	2,488,899,285	3,233,850,235
(8)기타유동부채	2,900,375,480	1,608,721,200
(9)리스부채	2,415,170,291	2,542,252,270
Ⅱ.비유동부채	570,791,700,248	536,020,568,287
(1)장기차입금	496,030,711,289	502,339,718,539
(2)사채	44,890,218,993	
(3)당기손익-공정가치측정금융부채		325,610,688
(4)기타비유동금융부채	10,559,909,588	12,931,958,785
(5)리스부채	1,285,618,188	1,413,676,723
(6)이연법인세부채	18,025,242,190	19,009,603,552
부채총계	1,276,087,402,767	1,180,702,762,437
자본		
Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	294,338,033,957	309,057,768,838
(1)자본금	26,068,237,500	23,989,927,000
(2)기타불입자본	192,801,202,170	194,351,207,246
(3)기타자본구성요소	35,412,693,131	30,498,247,571
(4)이익잉여금(결손금)	40,055,901,156	60,218,387,021
Ⅱ.비지배지분	234,484,135,681	235,329,600,599
자본총계	528,822,169,638	544,387,369,437
자본과부채총계	1,804,909,572,405	1,725,090,131,874

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 24 기 1분기		제 23 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
I.매출	268,960,709,331	268,960,709,331	237,890,459,525	237,890,459,525
II.매출원가	239,553,941,373	239,553,941,373	202,974,993,424	202,974,993,424
III.매출총이익	29,406,767,958	29,406,767,958	34,915,466,101	34,915,466,101
IV.판매비	814,250,262	814,250,262	535,267,387	535,267,387
V.관리비	17,766,305,736	17,766,305,736	17,597,509,497	17,597,509,497
VI.영업이익(손실)	10,826,211,960	10,826,211,960	16,782,689,217	16,782,689,217
VII.기타영업외수익	13,044,711,974	13,044,711,974	10,111,754,741	10,111,754,741
VIII.기타영업외비용	8,584,086,201	8,584,086,201	4,802,805,883	4,802,805,883
IX.금융수익	4,261,425,697	4,261,425,697	3,407,903,422	3,407,903,422
X.금융비용	39,853,976,240	39,853,976,240	10,125,104,762	10,125,104,762
XI.지분법손익	(51,112,328)	(51,112,328)	46,293,650	46,293,650
XII.법인세비용차감전순이익(손실)	(20,356,825,138)	(20,356,825,138)	15,420,730,385	15,420,730,385
XIII.법인세비용(수익)	(3,501,320,988)	(3,501,320,988)	1,551,588,194	1,551,588,194
XIV.분기순이익(손실)	(16,855,504,150)	(16,855,504,150)	13,869,142,191	13,869,142,191
XV.분기순이익(손실)의 귀속				
(1)지배기업 소유주지분	(18,110,351,402)	(18,110,351,402)	4,325,860,944	4,325,860,944
(2)비지배지분	1,254,847,252	1,254,847,252	9,543,281,247	9,543,281,247
XVI.기타포괄손익	5,054,940,792	5,054,940,792	10,109,921,491	10,109,921,491
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	137,745,313	137,745,313	149,546,793	149,546,793
1.순확정급여부채의 재측정요소	143,394,570	143,394,570	142,327,778	142,327,778
2.지분법자본변동	(5,649,257)	(5,649,257)	7,219,015	7,219,015
(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,917,195,479	4,917,195,479	9,960,374,698	9,960,374,698
1.해외사업장환산손익	4,917,195,479	4,917,195,479	9,960,374,698	9,960,374,698
XVII.분기총포괄이익(손실)	(11,800,563,358)	(11,800,563,358)	23,979,063,682	23,979,063,682
XVIII.포괄손익의 귀속				
(1)지배기업 소유주지분	(13,086,251,755)	(13,086,251,755)	14,404,217,673	14,404,217,673
(2)비지배지분	1,285,688,397	1,285,688,397	9,574,846,009	9,574,846,009
XIX.주당순손익				
(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(411)	(411)	100	100
(2)희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(411)	(411)	100	100

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본											
	지배기업 소유주지분										비지배지분	자본 합계
	자본금	기타포괄자본					신용자본증권	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계		
주식발행초과금		기타자본잉여금	주식선택권	자기주식	계							
2023.01.01 (기초자본)	23,960,927,000	220,423,941,266	(29,750,085,410)	1,989,278,966	(52,522,503,455)		140,140,631,387	23,117,369,779	76,891,012,321	264,109,940,487	224,105,579,567	488,215,520,054

분기순이익(손실)										4,325,860,944	4,325,860,944	9,543,281,247	13,869,142,191
순확정급여재측정요소										115,045,917	115,045,917	27,281,861	142,327,778
지분법자본변동								2,377,384		2,377,384	2,377,384	4,841,631	7,219,015
해외사립환산손익								9,960,933,428		9,960,933,428	9,960,933,428	(558,730)	9,960,374,698
주식보상비용				385,770,868				385,770,868		385,770,868	385,770,868	218,846,982	604,617,850
주식매수선택권의행사													
신종자본증권의발행			4,242,503,808			47,993,624,760	52,236,128,568				52,236,128,568		52,236,128,568
전환권의 행사													
배당금의 지급										(2,158,888,550)	(2,158,888,550)	(3,927,568,200)	(6,086,456,750)
2023.03.31 (기말자본)	23,960,927,000	220,423,941,286	(25,507,581,602)	2,375,049,834	(52,522,503,455)	47,993,624,760	192,762,530,823	33,080,680,591	79,173,030,632	328,977,169,046	229,971,704,358	558,948,873,404	
2024.01.01 (기초자본)	23,989,927,000	220,783,983,991	(25,507,581,602)	3,603,683,552	(52,522,503,455)	47,993,624,760	194,351,207,246	30,498,247,571	60,218,387,021	309,057,768,838	235,329,600,599	544,387,369,437	
분기순이익(손실)										(18,110,351,402)	(18,110,351,402)	1,254,847,252	(16,855,504,150)
순확정급여재측정요소										109,654,087	109,654,087	33,740,483	143,394,570
지분법자본변동										(2,845,166)	(2,845,166)	(2,804,091)	(5,649,257)
해외사립환산손익										4,917,290,726	4,917,290,726	(95,247)	4,917,195,479
주식보상비용				(324,698,636)			(324,698,636)			(324,698,636)	(324,698,636)	487,225,485	162,526,849
주식매수선택권의행사	47,150,000	1,150,946,509		(327,646,649)						823,299,860	823,299,860	870,449,860	870,449,860
신종자본증권의발행													
전환권의 행사	2,031,160,500	41,136,267,231				(43,184,873,531)	(2,048,606,300)				(17,445,800)		(17,445,800)
배당금의 지급										(2,161,788,550)	(2,161,788,550)	(2,618,378,800)	(4,780,167,350)
2024.03.31 (기말자본)	26,068,237,500	263,071,197,731	(25,507,581,602)	2,951,338,267	(52,522,503,455)	4,808,751,229	192,801,202,170	35,412,693,131	40,055,901,156	294,338,033,957	234,484,135,681	528,822,169,638	

2-4. 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표

제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 24 기 1분기	제 23 기 1분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,323,213,694	1,285,037,594
(1)분기순이익(손실)	(16,855,504,150)	13,869,142,191
(2)조정	66,877,620,057	36,214,005,813
(3)순운전자본의변동	(31,234,510,508)	(37,854,916,414)
(4)이자의 수취	344,765,186	365,645,857
(5)이자의 지급	(14,785,464,850)	(5,023,281,501)
(6)법인세납부액(환급액)	(3,023,692,041)	(6,285,558,352)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(25,920,956,436)	(121,385,675,955)
(1)유형자산의 취득	(23,333,926,533)	(91,865,338,466)
(2)유형자산의 처분	597,266,074	
(3)무형자산의 취득	(2,803,410,163)	(8,922,539,295)
(4)무형자산의 처분		114,995
(5)투자부동산의 취득	(1,747,872,606)	(20,439,517,252)
(6)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(9,000,000)
(7)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,683,055,700	
(8)관계기업투자주식의 취득	(1,120,000,000)	
(9)관계기업투자주식의 처분	1,172,482	
(10)단기금융상품의 증가	(5,673,041,404)	

(11)장기금융상품의 증가	(501,894,278)	(754,910)
(12)상각후원가측정금융자산의 취득	(810,000,000)	
(13)기타유동금융자산의 증가	(4,827,128)	(210,603,992)
(14)기타유동금융자산의 감소	479,622,569	75,863,000
(15)기타비유동금융자산의 증가	(417,770,000)	(563,900,035)
(16)기타비유동금융자산의 감소	540,668,851	550,000,000
(17)기타비유동자산의 증가	(10,000,000)	
(18)매각예정비유동자산의 처분	7,200,000,000	
III.재무활동으로 인한 현금흐름	24,767,418,666	117,057,087,940
(1)단기차입금의 차입	40,963,195,604	79,500,000,000
(2)단기차입금의 상환		(21,244,906,921)
(3)장기차입금의 차입		23,500,000,000
(4)유동성장기차입금의 상환	(15,585,048,952)	(9,761,299,663)
(5)사채의 발행	44,890,030,000	
(6)사채의 상환	(45,000,000,000)	
(7)종속기업의 주식매수선택권 행사	872,635,100	
(8)리스부채의상환	(602,947,286)	(3,424,731,145)
(9)임대보증금의 증가		105,000,000
(10)임대보증금의 감소	(753,000,000)	
(11)신증자본증권의 발행		47,993,624,760
(12)전환 관련 비용의 지급	(17,445,800)	
(13)정부보조금의 수취		389,400,909
IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,395,971,005)	1,481,057,803
V.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,226,295,081)	(1,562,492,618)
VI.기초현금및현금성자산	106,682,628,169	100,683,158,514
VII.기말현금및현금성자산	104,456,333,088	99,120,665,896

3. 연결재무제표 주석

제 24(당) 기 1분기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 03월 31일까지

제 23(전) 기 1분기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지

하나마이크론 주식회사와 그 종속기업

1. 일반사항

이 재무제표는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 하나마이크론(주)(이하 "당사" 또는 "지배기업")와 연결재무제표 작성대상 종속기업(이하 하나마이크론(주)와 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체")을 연결 대상으로 하여 작성된 요약분기연결재무제표입니다.

(1) 지배기업의 개요

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 하나마이크론(주)(이하"당사" 및 "지배 기업")는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 상장한 회사로서, 반도체 및 액정표시장치인 메모리 및 비메모리 조립 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 설립 후 수차례의 증자 및 합병 등을 통하여 당분기말 현재의 자본금은 보통주 26,068백만원이며, 당분기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)
최창호	8,669,972	16.63
하나머티리얼즈(주)	4,744,083	9.10
최대주주의 특수관계인	815,151	1.56
기타 소액주주 등	37,907,269	72.71
합계	52,136,475	100.00

(2) 종속기업 현황

1) 당분기말 현재 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다.

구분	주요 영업활동	소재지	지분율 (%)		결산월
			당분기말	전기말	
Hana Micron America, Inc.	반도체 마케팅 및 SI 사업	미국	100.00	100.00	12월
하나머티리얼즈(주)(*1)	반도체 소재 제조 및 판매업	한국	32.93	32.93	12월
(주)이피웍스(*2)	반도체 소재 제조 및 연구업	한국	51.19	51.19	12월
(주)이노메이트	반도체용 특수가스 제조 및 판매업	한국	79.75	79.75	12월
하나마이크론태양광(주)	태양광 발전업	한국	100.00	100.00	12월
Hana Micron Vietnam Co., Ltd.	반도체 패키징 & 테스트	베트남	100.00	100.00	12월
Hana Latin America, Ltda.	RFID 판매 및 SI 사업	브라질	99.76	99.76	12월
AniTrace, Inc.	RFID 판매 및 SI 사업	미국	100.00	100.00	12월
HT Micron Semicondutores S.A.	반도체 패키징 & 테스트	브라질	100.00	100.00	12월
Hana Micron VINA Co., Ltd.	반도체 패키징 & 테스트	베트남	100.00	100.00	12월
하나더블유엘에스(주)(*3)	반도체 패키징 & 테스트	한국	61.54	61.54	12월
Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.	반도체 패키징 & 테스트	브라질	100.00	100.00	12월
하나에스앤비인베스트먼트(주)(*4)	신기술사업금융	한국	100.00	100.00	12월

(*1) 하나머티리얼즈(주)의 경우 당사가 직접 보유한 지분에 대한 지분율은 당분기말과 전기말 현재 32.93%이나, 기타의 주주로부터 포괄적으로 위임받은 의결권(2,300,000주)을 포함한 의결권 보유 비율은 44.71%로 산정됩니다. 당분기말과 전기말 현재 당사는 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석 양상 등을 종합적으로 고려하여 당사가 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

(*2) 당사가 보유하고 있는 (주)이피웍스의 주식은 의결권이 존재하는 상환전환우선주(86,000주)이며, 당사의 의결권이 50%를 초과하기 때문에 종속기업으로 분류하고 있습니다.

(*3) 2021년 1월 1일자로 하나마이크론(주)의 BUMP사업부문을 물적분할하여 하나더블유엘에스(주)를 설립하였습니다. 물적분할 설립일 이후 발행한 전환우선주를 포함한 당분기말 현재 지분율은 61.54% 입니다.

(*4) 전기 중 하나머티리얼즈(주)가 신규 출자하여 설립하였습니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

연결실체의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

2.1.1 연결실체가 채택한 제·개정 기준서 및 해석서

연결실체는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기 지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야 하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야 하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 연결재무제표에 미치는 영향이 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '가상자산 공시'

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 연결실체가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여

통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2 회계정책

요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정 평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결실체는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어 집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약분기연결재무제표 작성 시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 부문정보

(1) 연결실체는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 부문에 대한 자원배분의 의사결정과 보고부문의 성과평가를 위하여 최고영업 의사결정자가 정기적으로 검토하는 연결실체 내 단위에 대한 내부보고를 기초로 영업부문을 채택하였습니다. 연결실체의 보고부문은 다음과 같습니다.

구분	주요 사업부문의 내용
반도체 제조 부문	반도체 패키징 & 테스트 등
반도체 재료 부문	반도체식각장비의 Silicon parts 등

신기술사업금융 부문	신기술사업 투자
------------	----------

(2) 당분기와 전분기 중 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래조정이 반영되기 전 금액으로 작성되었습니다.

1) 당분기

(단위: 천원)					
구분	반도체 제조	반도체 재료	신기술사업금융	연결 조정	합계
매출액	376,449,848	57,108,291	639,275	(165,236,705)	268,960,709
감가상각비 및 사용권자산상각비	25,604,206	8,520,142	20,745	(1,161,852)	32,983,241
무형자산상각비	2,009,826	217,001	212	-	2,227,039
부문영업손익	3,827,898	6,162,572	388,672	447,070	10,826,212

2) 전분기

(단위: 천원)				
구분	반도체 제조	반도체 재료	연결 조정	합계
매출액	234,958,795	68,469,789	(65,538,124)	237,890,460
감가상각비 및 사용권자산상각비	19,008,891	8,577,514	(799,287)	26,787,118
무형자산상각비	1,160,702	181,270	-	1,341,972
부문영업손익	(2,462,308)	15,704,881	3,540,116	16,782,689

(3) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 보고부문별 자산총액과 부채총액의 내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)					
구분	반도체 제조	반도체 재료	신기술사업금융	연결 조정	합계
자산총계	1,859,821,183	683,131,554	10,697,439	(748,740,604)	1,804,909,572
부채총계	1,365,962,213	290,177,391	386,869	(380,439,070)	1,276,087,403

2) 전기말

(단위: 천원)					
구분	반도체 제조	반도체 재료	신기술사업금융	연결 조정	합계
자산총계	1,768,563,881	672,388,753	10,129,255	(725,991,757)	1,725,090,132
부채총계	1,238,746,387	279,359,731	185,954	(337,589,310)	1,180,702,762

(4) 당분기와 전분기 중 연결실체의 지역별 영업현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	매출(*1)	비유동자산(*2)

	당분기	전분기	당분기말	전기말
한국	210,352,148	175,063,878	736,259,852	732,910,650
브라질	43,106,583	50,326,942	75,055,441	73,545,028
베트남	4,789,291	2,561,510	465,023,995	460,534,650
미국	1,395,035	3,068,891	44,660	53,871
기타	9,317,652	6,869,239	-	-
합계	268,960,709	237,890,460	1,276,383,948	1,267,044,199

(*1) 수익은 고객의 소재지에 기초한 국가에 귀속되어 있습니다.

(*2) 비유동자산은 종속기업별 소재지에 기초하였으며, 금융상품, 이연법인세자산, 순확정급여자산이 제외된 금액입니다.

(5) 당분기와 전분기 중 연결실체 매출의 10% 이상을 차지하는 주요 고객의 현황은 다음과 같습니다

1) 당분기

(단위: 천원)				
구분	매출액	비율	영업부문	
A	109,761,973	40.82%	반도체 제조 부문	
B	50,494,350	18.77%	반도체 제조 부문	
C	37,504,653	13.95%	반도체 재료 부문	

2) 전분기

(단위: 천원)				
구분	매출액	비율	영업부문	
A	49,899,559	20.98%	반도체 제조 부문	
B	67,257,269	28.27%	반도체 제조 부문	
C	44,873,265	18.86%	반도체 재료 부문	

5. 사용이 제한된 금융자산

당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)			
구분	당분기말	전기말	사용제한사유
정기예금	287,790	281,960	베트남 전력 공사 보증금
보통예금	5,529,884	5,294,203	이자 인출 제한 질권설정
합계	5,817,674	5,576,163	

6. 매출채권, 계약자산 및 기타금융자산

당분기말과 전기말 현재 매출채권, 계약자산 및 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위: 천원)											
구분	유동							비유동			
	매출채권	계약자산(*1)	기타유동금융자산				합계	기타비유동금융자산			합계
			미수금	단기대여금	미수수익	보증금		장기미수금	장기대여금	보증금	
총 장부금액	145,711,404	16,031,848	15,966,942	749,964	1,402,448	765,162	180,627,768	5,258,352	6,633,929	2,342,356	14,234,637
현재가치할인차금	-	-	-	-	-	(519)	(519)	-	-	(75,954)	(75,954)
손실총당금	(6,608,314)	(338)	(2,452,194)	-	(1,326,289)	-	(12,387,135)	(5,252,398)	(5,549,759)	-	(10,802,157)
순 장부금액	137,103,090	16,031,510	13,514,748	749,964	76,159	764,643	168,240,114	5,954	1,084,170	2,266,402	3,356,526

(*1) 계약자산은 고객이 자산을 인수하기 전에 진행률에 따라 인식한 수익과 관련한 대가로 인식합니다. 계약자산에 대한 청구권은 당분기말 현재 발생하지 않았으며, 고객이 자산을 인수한 시점에 계약자산으로 인식한 잔액은 매출채권으로 재분류합니다.

(2) 전기말

(단위: 천원)											
구분	유동							비유동			
	매출채권	계약자산(*1)	기타유동금융자산				합계	기타비유동금융자산			합계
			미수금	단기대여금	미수수익	보증금		장기미수금	장기대여금	보증금	
총 장부금액	88,835,273	13,700,853	9,466,476	724,068	1,300,473	803,751	114,830,894	5,206,122	5,597,100	2,305,295	13,108,517
현재가치할인차금	-	-	-	-	-	(1,865)	(1,865)	-	-	(64,948)	(64,948)
손실총당금	(8,252,340)	(120)	(2,446,672)	-	(1,269,763)	-	(11,968,895)	(5,197,630)	(5,313,231)	-	(10,510,861)
순 장부금액	80,582,933	13,700,733	7,019,804	724,068	30,710	801,886	102,860,134	8,492	283,869	2,240,347	2,532,708

(*1) 계약자산은 고객이 자산을 인수하기 전에 진행률에 따라 인식한 수익과 관련한 대가로 인식합니다. 계약자산에 대한 청구권은 전기말 현재 발생하지 않았으며, 고객이 자산을 인수한 시점에 계약자산으로 인식한 잔액은 매출채권으로 재분류합니다.

7. 재고자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)								
구분	당분기말				전기말			
	취득원가	평가손실 총당금	정부보조금	장부금액	취득원가	평가손실 총당금	정부보조금	장부금액
상품	4,999,755	-	-	4,999,755	580,684	-	-	580,684
제품	33,422,381	(1,274,877)	-	32,147,504	33,829,810	(1,920,776)	-	31,909,034
재공품	26,883,848	(1,604,038)	-	25,279,810	22,248,138	(1,422,860)	-	20,825,278
원재료	94,577,420	(5,808,159)	-	88,769,261	86,928,473	(5,015,128)	-	81,913,345
저장품	28,333,631	(514,319)	-	27,819,312	28,891,610	(142,286)	-	28,749,324
미착품	2,786,791	-	-	2,786,791	-	-	-	-
용지	5,815,815	-	(43,934)	5,771,881	5,815,815	-	(43,934)	5,771,881
합계	196,819,641	(9,201,393)	(43,934)	187,574,314	178,294,530	(8,501,050)	(43,934)	169,749,546

(2) 당분기 중 연결실체는 재고자산의 순실현가능가치에 따른 재고자산평가손실 700백만원(전분기: 921백만원)을 인식하였으며, 포괄손익계산서의 '매출원가'에 포함되었습니다.

(3) 연결실체의 재고자산은 차입금과 관련하여 담보로 제공되었습니다(주석 15 참조).

8. 공정가치 측정 금융자산

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산

당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
지분증권 등	7,567,604	9,250,660
파생상품자산(*1)	8,177,552	23,874,627
합계	15,745,156	33,125,287

(*1) 연결실체는 전기 중 제12회 무보증 사모 영구 전환사채를 발행하였으며, 동 전환사채는 제3자 지정가능한 매도청구권이 내재된 상품으로, 매도청구권을 별도로 분리하여 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 인식하였습니다. 한편, 후속기간 동안의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
비상장주식	1,111,743	1,111,743

9. 상각후원가 측정 금융자산

당분기말과 전기말 현재 상각후원가 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
사채(*)	-	-

(*) 연결실체는 제9회, 제10회, 제13회 무보증사모사채의 계약조건에 따라 취득한 후순위 유동화증권을 상각후원가 측정 금융자산으로 분류하였으며(주석 16 참조), 전기 이전 및 당분기 중 회수가능성을 평가하여 전액 손상을 인식하였습니다.

10. 공동기업투자 및 관계기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 공동기업투자 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
회사명	소재지	지분율(%)	당분기말		전기말	
			취득원가	장부금액	취득원가	장부금액
공동기업:						
Hana Innosys Latin America	브라질	50.00	637,403	-	637,403	-
흥국-하나에스앤비 뉴프라이밍 신기술투자조합(*1)	한국	50.00	1,050,000	999,069	-	-
관계기업:						
(주)솔머티리얼즈(*2)	한국	-	-	-	4,290,000	-
하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합(*3)	한국	6.54	70,000	69,819	-	-
합계			1,757,403	1,068,888	4,927,403	-

(*1) 당분기 중 종속기업인 하나에스앤비인베스트먼트(주)는 2024년 1월 흥국증권(주)의 금융 네트워크를 통한 혁신적인 기업을 발굴하기 위하여 흥국증권과 '흥국-하나에스앤비 뉴프라이밍 신기술투자조합' 펀드를 결성하였으며 해당 펀드는 하나에스앤비인베스트먼트(주), 흥국증권(주)(이하 업무집행조합원), 하나머티리얼즈(주), 흥국생명보험(주)(이하 유한책임조합원)가 참여하기로 하였습니다. 하나머티리얼즈(주)의 출자약정액은 100억원이며 이 중 10억원을 납입하였고, 하나에스앤비인베스트먼트(주)의 출자약정액은 5억원이며 이 중 5천만원을 납입하였습니다.

(*2) 전기말 지분율이 20% 미만이나, 이사선임권을 보유하여 피투자회사의 이사회 등에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였으며, 당분기 중 전액 매각함에 따라 전기말 매각 예정자산으로 분류하였습니다.

(*3) 당분기 중 종속기업인 하나에스앤비인베스트먼트(주)는 2024년 3월 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 펀드를 결성하였습니다. 하나에스앤비인베스트먼트(주)의 출자약정액은 2억원이며, 이 중 7천만원을 납입하였습니다. 당분기말 지분율이 20% 미만이나, 업무집행조합원으로서 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 공동기업투자 및 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 천원)				
회사명	기초	취득	지분법손익	분기말
흥국-하나에스앤비 뉴프라이밍 신기술투자조합	-	1,050,000	(50,931)	999,069
하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합	-	70,000	(181)	69,819
합계	-	1,120,000	(51,112)	1,068,888

2) 전분기

(단위: 천원)				
회사명	기초	지분법손익	지분법자본변동	분기말
(주)솔머티리얼즈	5,806,303	46,293	7,219	5,859,815

(3) 당분기말 현재 공동기업투자 및 관계기업투자의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)					
회사명	자산총액	부채총액	매출액	분기순손익	총포괄손익
흥국-하나에스앤비 뉴프라이밍 신기술투자조합	1,998,138	-	-	(101,862)	(101,862)
하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합	1,067,228	-	-	(2,772)	(2,772)

11. 유형자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)					
구분	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	장부금액
토지	100,430,829	-	-	-	100,430,829
건물	115,619,105	-	(25,791,432)	-	89,827,673
구축물	9,999,092	(171,291)	(3,369,861)	-	6,457,940
기계장치	1,212,962,497	(413,802)	(571,257,199)	(14,326,594)	626,964,902
공구와기구 외	95,052,650	-	(75,654,508)	(238,164)	19,159,978
건설중인자산	182,385,744	(4,260,822)	-	(352,702)	177,772,220
합계	1,716,449,917	(4,845,915)	(676,073,000)	(14,917,460)	1,020,613,542

2) 전기말

(단위: 천원)					
구분	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	장부금액
토지	90,983,665	-	-	-	90,983,665
건물	106,007,725	-	(24,944,375)	-	81,063,350
구축물	9,973,675	(173,574)	(3,245,896)	-	6,554,205
기계장치	1,197,800,245	(441,125)	(541,740,652)	(14,326,594)	641,291,874
공구와기구 외	93,297,017	-	(74,203,108)	(238,164)	18,855,745
건설중인자산	168,320,641	(4,260,822)	-	(352,702)	163,707,117
합계	1,666,382,968	(4,875,521)	(644,134,031)	(14,917,460)	1,002,455,956

(2) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 천원)							
구분	기초	취득	처분	감가상각	대체	환율변동효과	분기말
토지	90,983,665	3,220,920	-	-	6,224,804	1,440	100,430,829
건물	81,063,350	-	-	(803,015)	9,337,207	230,131	89,827,673
구축물	6,554,205	15,980	-	(121,151)	-	8,906	6,457,940
기계장치	641,291,874	4,295,894	(469,182)	(30,085,842)	5,912,460	6,019,698	626,964,902

공구와기구 외	18,855,745	1,430,825	-	(1,362,777)	85,588	150,597	19,159,978
건설중인자산	163,707,117	19,858,514	-	-	(5,998,048)	204,637	177,772,220
합계	1,002,455,956	28,822,133	(469,182)	(32,372,785)	15,562,011	6,615,409	1,020,613,542

2) 전분기

(단위: 천원)							
구분	기초	취득	처분	감가상각	대체	환율변동효과	분기말
토지	88,713,078	-	-	-	-	-	88,713,078
건물	75,476,137	42,089	-	(650,133)	4,997,986	713,719	80,579,798
구축물	6,593,307	430,603	(20,429)	(117,139)	21,900	51,366	6,959,608
기계장치	501,023,794	39,455,345	(1,131,905)	(24,020,215)	75,500,012	5,992,549	596,819,580
공구와기구 외	20,138,354	898,452	-	(1,365,875)	44,550	435,176	20,150,657
건설중인자산	115,720,549	67,377,395	-	-	(80,564,448)	2,666,944	105,200,440
합계	807,665,219	108,203,884	(1,152,334)	(26,153,362)	-	9,859,754	898,423,161

(3) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 유형자산은 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공되어 있습니다(주석 15 참조).

12. 투자부동산

(1) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
토지	15,054,201	21,279,005
건물	179,706,323	184,200,858
사용권자산	12,902,391	12,641,017
건설중인자산	83,572	33,803
합계	207,746,487	218,154,683

(2) 당분기와 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 천원)					
구분	기초	취득	환율변동효과	대체	분기말
토지	21,279,005	-	-	(6,224,804)	15,054,201
건물	184,200,858	1,658,706	3,183,966	(9,337,207)	179,706,323
사용권자산	12,641,017	-	261,374	-	12,902,391
건설중인자산	33,803	48,889	880	-	83,572
합계	218,154,683	1,707,595	3,446,220	(15,562,011)	207,746,487

2) 전분기

(단위: 천원)				
구분	기초	취득	환율변동효과	분기말
토지	21,245,053	-	-	21,245,053
건물	80,814,584	3,281,715	1,700,685	85,796,984
사용권자산	8,669,396	-	290,595	8,959,991
건설중인자산	52,559,504	17,686,736	1,761,771	72,008,011
합계	163,288,537	20,968,451	3,753,051	188,010,039

(3) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 투자부동산은 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공되어 있습니다(주석 15 참조).

13. 무형자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)					
구분	취득원가	정부보조금	상각누계액	손상차손누계액	장부금액
영업권	4,040,708	-	-	-	4,040,708
개발비	13,251,765	(1,025,053)	(6,918,791)	(1,058,122)	4,249,799
기타의무형자산	36,969,962	(22,917)	(15,374,912)	(150,557)	21,421,576
회원권	6,029,466	-	-	(822,118)	5,207,348
건설중인무형자산	6,308,141	-	-	(4,307,740)	2,000,401
합계	66,600,042	(1,047,970)	(22,293,703)	(6,338,537)	36,919,832

2) 전기말

(단위: 천원)					
구분	취득원가	정부보조금	상각누계액	손상차손누계액	장부금액
영업권	3,998,575	-	-	-	3,998,575
개발비	13,026,056	(1,025,053)	(6,116,094)	(1,047,513)	4,837,396
기타의무형자산	35,358,053	(24,167)	(13,778,939)	(150,557)	21,404,390
회원권	4,807,356	-	-	(822,118)	3,985,238
건설중인무형자산	5,936,814	-	-	(4,264,348)	1,672,466
합계	63,126,854	(1,049,220)	(19,895,033)	(6,284,536)	35,898,065

(2) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 천원)						
구분	기초	취득	상각	대체	환율변동 효과	분기말
영업권	3,998,575	-	-	-	42,133	4,040,708
개발비	4,837,396	-	(700,329)	62,858	49,874	4,249,799
기타의무형자산	21,404,390	1,082,796	(1,526,710)	203,306	257,794	21,421,576
회원권	3,985,238	1,222,110	-	-	-	5,207,348
건설중인무형자산	1,672,466	569,233	-	(266,164)	24,866	2,000,401
합계	35,898,065	2,874,139	(2,227,039)	-	374,667	36,919,832

2) 전분기

(단위: 천원)							
구분	기초	취득	처분	상각	대체	환율변동 효과	분기말
영업권	3,607,189	-	-	-	-	244,071	3,851,260
개발비	1,689,372	-	-	(392,633)	-	92,523	1,389,262
기타의무형자산	10,523,358	4,800,264	(1)	(949,339)	17,803	309,131	14,701,216
회원권	3,650,259	-	-	-	-	-	3,650,259
건설중인무형자산	1,469,143	4,262,485	-	-	(22,634)	178,130	5,887,124
합계	20,939,321	9,062,749	(1)	(1,341,972)	(4,831)	823,855	29,479,121

14. 사용권자산 및 리스부채

(1) 당분기말과 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
리스부채-유동	2,415,170	2,542,252
리스부채-비유동	1,285,618	1,413,677
합계	3,700,788	3,955,929

(2) 당분기말과 전기말 현재 유형별 사용권자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
토지	2,449,180	2,529,954
건물	1,602,833	1,833,698
차량운반구	1,377,593	1,266,978
비품	163,413	252,665

합계	5,593,019	5,883,295
----	-----------	-----------

(3) 당분기와 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 천원)					
구분	토지	건물	차량운반구	비품	합계
기초	2,529,954	1,833,698	1,266,978	252,665	5,883,295
증가	-	7,977	364,935	-	372,912
처분 등(*1)	(57,525)	-	(35,596)	-	(93,121)
환율변동효과	39,836	1,388	(1,678)	843	40,389
감가상각	(63,085)	(240,230)	(217,046)	(90,095)	(610,456)
분기말	2,449,180	1,602,833	1,377,593	163,413	5,593,019

(*1) 리스 계약 중도해지로 인한 처분 금액입니다.

2) 전분기

(단위: 천원)					
구분	토지	건물	차량운반구	비품	합계
기초	767,847	2,935,664	973,557	517,425	5,194,493
취득	2,992,795	118,761	570,148	-	3,681,704
환율변동효과	(215)	23,049	(17,203)	-	5,631
감가상각	(56,246)	(280,434)	(210,839)	(86,237)	(633,756)
분기말	3,704,181	2,797,040	1,315,663	431,188	8,248,072

(4) 당분기와 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기	전분기
사용권자산 감가상각비	610,456	633,756
리스부채 이자비용	45,544	49,446
단기리스 관련 비용	30,356	36,173
소액기초자산리스 관련 비용	357,398	211,882

당분기 중 리스의 총 현금유출은 1,186,298천원(전분기: 3,722,232천원) 입니다.

15. 장·단기차입금

(1) 단기차입금

당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)			
차입금 종류	차입처	당분기말 연이자율(%)	당분기말
시설자금대출	농협은행 등	4.51% ~ 7.05%	21,483,561
운전자금대출	대신증권 등	3.07% ~ 13.32%	216,737,906
무역금융대출	국민은행 등	3.95% ~ 5.12%	95,500,000
합계			333,721,467

2) 전기말

(단위: 천원)			
차입금 종류	차입처	전기말 연이자율(%)	전기말
시설자금대출	농협은행 등	4.68% ~ 7.06%	21,463,030
운전자금대출	대신증권 등	3.07% ~ 13.38%	201,837,646
무역금융대출	국민은행 등	3.95% ~ 5.26%	69,000,000
합계			292,300,676

(2) 장기차입금

당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)			
차입금 종류	차입처	당분기말 연이자율(%)	당분기말
채권유동화(*1)	한국산업은행	4.93% ~ 5.02%	56,800,000
채권유동화(*2)	한국산업은행 등	5.53% ~ 6.34%	27,200,000
채권유동화(*3)	하나머티리얼즈제일차유한회사 등	4.83%	11,000,000
시설자금대출	한국산업은행 등	1.93% ~ 8.33%	459,719,334
운전자금대출	국민은행 등	5.20% ~ 6.63%	26,643,887
소계			581,363,221
차감: 현재가치할인차금			(19,484,732)
차감: 유동성 대체액			(65,847,778)
합계			496,030,711

- (*1) 연결실체는 삼성전자(주), SK하이닉스(주)로부터 발생하는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하였습니다(주석 28 참조).
- (*2) 연결실체는 삼성전자(주), SK하이닉스(주)로부터 발생하는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하고, 그에 따라 취득한 수익권에 대하여 한국산업은행, 전북은행 및 하나마이크론제삼차 주식회사를 제1종 수익자로 지정하는 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 하나머티리얼즈(주)는 하나마이크론제삼차 주식회사를 위해 172억원의 자금보충의무 및 조건부채무인수 의무를 부담하고 있습니다(주석 28 참조).
- (*3) 연결실체는 도교일렉트론 코리아로부터 발생하는 미래 발생채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하고, 그에 따라 취득한 수익권에 대하여 하나머티리얼즈제일차 유한회사와 수익근질권 설정계약을 체결하였습니다. 그리고 하나머티리얼즈제일차 유한회사에 대하여 자금보충이행 사유가 발생할 때에는 자금보충의무를 부담하기로 약정하였습니다(주석 28 참조).

2) 전기말

(단위: 천원)			
차입금 종류	차입처	전기말 연이자율(%)	전기말
채권유동화(*1)	한국산업은행	4.93% ~ 5.02%	57,500,000
채권유동화(*2)	한국산업은행 등	5.53% ~ 6.49%	29,660,000
채권유동화(*3)	하나머티리얼즈제일차유한회사 등	4.83%	12,000,000
시설자금대출	한국산업은행 등	1.93% ~ 8.38%	456,201,842
운전자금대출	국민은행 등	5.46% ~ 6.79%	31,334,306
소계			586,696,148
차감: 현재가치할인차금			(20,692,233)
차감: 유동성 대체액			(63,664,196)
합계			502,339,719

- (*1) 연결실체는 삼성전자(주), SK하이닉스(주)로부터 발생하는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하였습니다(주석 28 참조).
- (*2) 연결실체는 삼성전자(주), SK하이닉스(주)로부터 발생하는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하고, 그에 따라 취득한 수익권에 대하여 한국산업은행, 전북은행 및 하나마이크론제삼차 주식회사를 제1종 수익자로 지정하는 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 하나머티리얼즈(주)는 하나마이크론제삼차 주식회사를 위해 188억원의 자금보충의무 및 조건부채무인수 의무를 부담하고 있습니다(주석 28 참조).
- (*3) 연결실체는 도교일렉트론 코리아로부터 발생하는 미래 발생채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하고, 그에 따라 취득한 수익권에 대하여 하나머티리얼즈제일차 유한회사와 수익근질권 설정계약을 체결하였습니다. 그리고 하나머티리얼즈제일차 유한회사에 대하여 자금보충이행 사유가 발생할 때에는 자금보충의무를 부담하기로 약정하였습니다(주석 28 참조).

(3) 차입금 관련 담보제공 및 지급보증 내역

1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 차입금과 관련된 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 천원)				
구분	담보권자	담보설정액	담보제공자산	관련 차입액
하나마이크론(주)	한국산업은행	196,998,346	토지, 건물,	105,268,054
	신한은행	35,427,600	기계장치 등	38,080,100
	농협은행	12,000,000	건물, 투자부동산	10,000,000
	국민은행	29,211,000	기계장치	24,342,500
	기업은행	24,999,960	건물, 기계장치	20,833,300
	한국수출입은행	22,750,000	채고자산	17,500,000
하나머티리얼즈(주)	씨티은행	13,910,000	건물	-
	한국산업은행	89,850,000	토지, 건물, 기계장치	47,392,700
	농협은행	30,000,000	토지, 건물, 기계장치	25,000,000
	한국수출입은행	19,500,000	채고자산	15,000,000
	우리은행	3,600,000	산업재산권	3,000,000
HANA Micron Vietnam Co., Ltd.	Shinhan Bank	23,959,172	토지, 건물, 기계장치	6,143,851
HT Micron Semicondutores S.A.	BNDES	24,597,213	기계장치	21,691,105

(*) 당분기말 현재 연결실체는 차입금 등에 대하여 보유 중인 토지 83,020,752천원, 건물 72,296,426천원, 투자부동산 53,149,958천원, 기계장치 215,792,590천원, 채고자산 108,946,952천원을 담보로 제공하고 있습니다.

② 전기말

(단위: 천원)				
구분	담보권자	담보설정액	담보제공자산	관련 차입액
하나마이크론(주)	한국산업은행	197,107,755	토지, 건물,	106,618,054
	신한은행	35,025,800	기계장치 등	39,648,550
	농협은행	12,000,000	건물, 투자부동산	10,000,000
	국민은행	36,479,503	기계장치	30,399,586
	기업은행	27,499,956	건물, 기계장치	22,916,630
	한국수출입은행	22,750,000	채고자산	-
하나머티리얼즈(주)	씨티은행	13,910,000	건물	-
	한국산업은행	89,850,000	토지, 건물, 기계장치	47,392,700
	농협은행	30,000,000	토지, 건물, 기계장치	25,000,000
	한국수출입은행	19,500,000	채고자산	15,000,000
	우리은행	3,600,000	산업재산권	3,000,000
HANA Micron Vietnam Co., Ltd.	Shinhan Bank	23,473,811	토지, 건물, 기계장치	6,019,390
HT Micron Semicondutores S.A.	BNDES	24,340,735	기계장치	22,504,764

(*) 전기말 현재 연결실체는 차입금 등에 대하여 보유 중인 토지 79,989,202천원, 건물 68,252,382천원, 투자부동산 60,694,665천원, 기계장치 225,762,080천원, 채고자산

103,285,777천원을 담보로 제공하고 있습니다.

2) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 차입금과 관련하여 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)			
구분	제공자	지급보증액	지급보증처
지급보증	최대주주	65,266,332	하나은행 등
		USD 13,680,000	
	한국무역보험공사	1,800,000	하나은행
	신용보증기금	4,500,000	신한은행

② 전기말

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)			
구분	제공자	지급보증액	지급보증처
지급보증	최대주주	65,716,472	하나은행 등
		USD 15,000,000	
	한국무역보험공사	1,800,000	하나은행
	신용보증기금	4,500,000	신한은행

3) 당분기말 현재 대신증권 등에 대한 차입금과 관련하여 지배기업이 보유 중인 종속기업 하나머티리얼즈(주)의 주식 4,507,981주(전기말: 4,152,383주)을 담보로 제공하고 있습니다.

4) 당분기말 현재 연결실체의 삼평동 소재 토지 및 건물은 임대보증금과 관련하여 270백만원(전기말: 428백만원)의 전세권이 설정되어 있습니다.

16. 사채

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

구분	제 10 회 사모사채	제 11 회 사모사채	제 13 회 사모사채
사채의 종류	제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 사채	제11회차 무보증 사모 사채	제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 사채
사채의 권면총액	25,000,000,000원	50,000,000,000원	45,000,000,000원
사채이율	표면이자율 : 3.12%, 만기이자율 : 3.12%	표면이자율 : 6.5%, 만기이자율 : 6.5%	표면이자율 : 4.51%, 만기이자율 : 4.51%
사채납입일	2021년 11월 29일	2022년 8월 9일	2024년 3월 28일
사채만기일	2024년 11월 29일	2024년 8월 9일	2027년 3월 28일

원금상환방법	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 11월 29일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.	원금은 만기에 일시 상환한다 (2024년 8월 9일). 다만, 원금 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.	원금은 만기에 일시 상환한다 (2027년 3월 28일). 다만, 원금상환기일이 대한민국 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 상환기일로 한다.
조기상환청구권(Put Option)	없음	없음	없음
조기상환권(Call Option)	사채의 발행일로부터 6개월이 경과한 날로부터 매 영업일	없음	사채의 발행일로부터 6개월이 경과한 날로부터 매 영업일

2) 전기말

구분	제 9 회 사모사채	제 10 회 사모사채	제 11 회 사모사채
사채의 종류	제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 사채	제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 사채	제11회차 무보증 사모 사채
사채의 권면총액	45,000,000,000원	25,000,000,000원	50,000,000,000원
사채이율	표면이자율 : 2.256%, 만기이자율 : 2.256%	표면이자율 : 3.12%, 만기이자율 : 3.12%	표면이자율 : 6.5%, 만기이자율 : 6.5%
사채납입일	2021년 5월 27일	2021년 11월 29일	2022년 8월 9일
사채만기일	2024년 5월 27일	2024년 11월 29일	2024년 8월 9일
원금상환방법	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 5월 27일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 11월 29일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.	원금은 만기에 일시 상환한다(2024년 8월 9일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
조기상환청구권(Put Option)	없음	없음	없음
조기상환권(Call Option)	사채의 발행일로부터 6개월이 경과한 날로부터 매 영업일	사채의 발행일로부터 6개월이 경과한 날로부터 매 영업일	없음

연결실체가 제9회, 제10회, 제13회 무보증사모사채 발행 계약조건에 따라 매입한 후순위유동화증권은 유동화회사가 근질권을 설정하고 있습니다(주석 9 참조).

(2) 당분기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
유동		
액면가액	75,000,000	120,000,000
사채할인발행차금	(146,165)	(256,615)
합계	74,853,835	119,743,385
비유동		
액면가액	45,000,000	-
사채할인발행차금	(109,781)	-

합계	44,890,219	-
----	------------	---

17. 매입채무와 기타금융부채

당분기말과 전기말 현재 매입채무와 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
유동부채:		
매입채무	95,133,637	55,901,276
기타유동금융부채		
미지급금	100,494,555	89,890,607
미지급비용	20,631,988	15,099,710
보증금	452,000	697,520
미지급배당금	4,780,167	-
소계	221,492,347	161,589,113
비유동부채:		
기타비유동금융부채		
장기미지급금	5,874,125	5,680,440
장기미지급비용	4,661,595	6,719,849
보증금	24,190	531,670
소계	10,559,910	12,931,959
합계	232,052,257	174,521,072

18. 퇴직급여제도

당분기말과 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 연결재무상태표 상 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	55,304,924	55,233,705
사외적립자산의 공정가치	(60,009,796)	(61,641,039)
순확정급여부채(자산)	(4,704,872)	(6,407,334)

19. 기타불입자본

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말

주식발행초과금	263,071,198	220,783,984
기타자본잉여금(*1)	(25,507,583)	(25,507,583)
자기주식	(52,522,503)	(52,522,503)
주식선택권	2,951,339	3,603,684
신종자본증권(*2)	4,808,751	47,993,625
합계	192,801,202	194,351,207

(*1) 전기 중 발행한 제12회 무보증 사모 영구 전환사채에 내재된 매도청구권 4,243백만원이 포함되어 있습니다(주석 8, 28 참조).

(*2) 연결실체는 전기 중 제12회 무보증 사모 영구 전환사채를 발행하였으며, 발행일 이후 일정기간 이 경과한 시점부터 상환할 수 있습니다. 동 전환사채는 만기일에 동일한 조건으로 만기를 계속 연장할 수 있고, 이자의 전부 또는 일부의 지급을 제한없이 정지할 수 있으므로 자본으로 분류하였습니다. 한편, 당분기 중 영구 전환사채의 매도청구권 일부가 행사되었고, 영구 전환사채의 일부가 전환청구됨에 따라 보통주 4,062,321주가 발행되었으며, 당분기말 현재 신종자본증권 잔액은 4,809백만원입니다(주석 26, 28 참조).

(2) 당분기말과 전기말 현재 자본으로 분류된 신종자본증권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
구분	발행일	만기일(*1)	액면이자율	만기수익률(*2)	당분기말	전기말
제12회 무보증 사모 영구 전환사채(*3)	2023-03-15	2053-03-15	0.00%	2.50%	4,809,390	48,000,000
차감: 발행비용					(639)	(6,375)
합계					4,808,751	47,993,625

(*1) 당사는 본 계약과 동일한 발행 조건으로 30년씩 계속하여 연장할 수 있으며, 발행일로부터 3년 후 매 3개월마다 중도상환 할 수 있습니다.

(*2) 만기수익률의 조정은 사채 발행 후 3년 경과 시 민간채권평가회사에서 제공하는 "당사 신용등급"에 해당하는 3년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균 이자율에 연 1.5%의 가산금리를 가산하여 정해지며, 이로부터 매 1년마다 직전 이자율에 연 1.0%의 가산금리를 가산하여 산정됩니다.

(*3) 상기 제12회 무보증 사모 영구 전환사채는 제3자 지정가능한 매도청구권이 내재된 상품으로, 매도청구권은 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하였습니다. 한편, 당분기 중 제12회 무보증 사모 영구 전환사채의 전환청구권 43,191백만원이 행사되었으며, 연결실체는 동 거래로 인하여 당기손익-공정가치 측정 금융자산 거래손실 13,869백만원을 인식하였습니다.

20. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
이익준비금(*1)	1,711,073	1,471,175
미처분이익잉여금(*2)	38,344,828	58,747,212
합계	40,055,901	60,218,387

(*1) 상법 상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

(*2) 당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하여 상법 상의 규정에 따라 초과한 금액 범위 내에서 당사의 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 이입 할 수 있으며, 제21기 정기주주총회의 승인을 받아 당사의 자본준비금 500억원을 이익잉여금으로 이입하였습니다.

21. 기타자본구성요소

당분기말과 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(882,711)	(882,711)
지분법자본변동	(9,619)	(6,774)
토지재평가손익	24,390,174	24,390,174
해외사업환산손익	11,914,849	6,997,559
합계	35,412,693	30,498,248

22. 주식선택권

(1) 지배기업의 주식선택권

1) 주식선택권 부여 내역

당분기말 현재 당사가 부여한 주식선택권의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구분	이동철	김정제 외 12명	이승범 외 2명
권리부여일	2019년 3월 27일	2021년 3월 30일	2022년 3월 30일
잔여수량	80,000주	163,700주	70,000주
부여방법	보통주 신주발행교부	보통주 신주발행교부	보통주 신주발행교부
행사가격	3,526원	9,275원	18,860원
행사가능기간	2021.3.27 ~ 2026.3.27	2023.3.30 ~ 2028.3.30	2024.3.30 ~ 2029.3.30

2) 보상원가 산정을 위한 제반가정 및 변수

당사는 주식선택권의 보상원가를 블랙·솔즈모형 및 이항모형을 이용한 공정가액접근법을 적용하여 산정하였으며, 주요 가정은 다음과 같습니다.

구분	2019년 3월 27일 부여	2021년 3월 30일 부여	2022년 3월 30일 부여
무위험이자율	1.76%	1.12%	2.91%
기대행사기간	2년	2년	2년
예상주가변동성	25.44%	64.29%	56.04%

3) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 주식기준보상비용은 각각 92,478천원과 209,119천원입니다.

(2) 종속기업 하나머티리얼즈(주)의 주식선택권

당분기말 현재 종속기업이 부여한 주식선택권의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구분	오경석 외 1명	양도환 외 3명	강동호	박상은	김현주
권리부여일	2018년 3월 19일	2021년 3월 22일	2023년 2월 3일	2023년 11월 9일	2024년 3월 8일
잔여수량	175,000주	75,000주	40,000주	7,000주	100,000주
부여방법	보통주 신주발행교부 자기주식교부 차액보상	보통주 신주발행교부 자기주식교부 차액보상	보통주 신주발행교부 자기주식교부 차액보상	신주교부 자기주식교부 차액보상	신주교부 자기주식교부 차액보상
행사가격	17,873원	34,274원	37,360원	50,400원	48,790원
행사가능기간	2020.3.19 ~ 2025.3.19	2023.3.22 ~ 2028.3.22	2025.2.3 ~ 2030.2.3	2023.11.9 ~ 2025.11.9	2026.3.8 ~ 2028.3.8

(3) 종속기업 하나더블유엘에스(주)의 주식선택권

당분기말 현재 종속기업이 부여한 주식선택권의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구분	신태희 외 1명
권리부여일	2022년 3월 20일
잔여수량	40,000주
부여방법	보통주 신주발행교부
행사가격	16,000원
행사가능기간	2024.3.30 ~ 2029.3.30

23. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채

23.1 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 당분기와 전분기 중 연결실체는 수익과 관련하여 포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기	전분기
고객과의 계약에서 생기는 수익	251,084,221	228,430,353
기타 원천으로부터의 수익	17,876,488	9,460,107
총 수익	268,960,709	237,890,460

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

당분기와 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기	전분기
수익인식 시점		
한 시점에 인식	103,211,404	121,285,987
기간에 걸쳐 인식	147,872,817	107,144,366
합계	251,084,221	228,430,353

23.2 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채

당분기말과 전기말 현재 고객과의 계약과 관련하여 인식한 자산과 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
계약자산	16,031,510	13,700,733
계약부채	-	-

24. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상가중평균 연간유효법인세율은 17.20%(2023년 3월 31일로 종료하는 중간기간에 대한 가중평균 연간유효법인세율: 10.06%)입니다.

25. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기	전분기
재고자산의 변동(제품, 재공품)	(4,693,002)	9,542,406
사용된 원재료 및 상품	164,166,572	128,643,545
종업원급여	35,869,797	37,894,512
감가상각비 및 사용권자산상각비	32,983,241	26,787,118
무형자산상각비	2,227,039	1,341,972
지급수수료	7,313,514	6,092,321
판매촉진비	29,670	28,438
수출제비용	439,298	90,694
기타	19,798,368	10,686,764
합계	258,134,497	221,107,770

26. 특수관계자와의 거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	당분기말	전기말
공동기업	Hana Innosys Latin America 흥국-하나에스앤비 뉴프라이밍 신기술투자 조합(*1)	Hana Innosys Latin America
관계기업	하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합 (*2)	(주)솔머티리얼즈(*3)
기타	최대주주 등	최대주주 등

(*1) 당분기 중 당사의 종속기업인 하나머티리얼즈(주)와 하나에스앤비인베스트먼트(주)가 신규 출자하여 설립하였습니다(주석 10 참조).

(*2) 당분기 중 당사의 종속기업인 하나에스앤비인베스트먼트(주)가 신규출자하여 설립하였습니다(주석 10 참조).

(*3) 연결실체가 보유한 (주)솔머티리얼즈의 주식을 당분기 중 전량 매각하였습니다(주석 10 참조).

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래내역은 없습니다.

(단위: 천원)			
구분	특수관계자의 명칭	매출 등	
		당분기	전분기
공동기업	흥국-하나에스앤비 뉴프라이밍 신기술투자조합	37,869	-
관계기업	하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합	572	-
합계		38,441	-

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권·채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)							
구분	특수관계자의 명칭	매출채권		미수금 등(*2)		미지급금 등	
		당분기말	전기말	당분기말	전기말	당분기말	전기말
공동기업	Hana Innosys Latin America(*1)	7,894,134	7,557,690	1,730,004	1,668,680	-	-
	흥국-하나에스앤비 뉴프라이밍 신기술투자조합	-	-	-	-	172,131	-
관계기업	하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합	-	-	-	-	15,478	-
합계		7,894,134	7,557,690	1,730,004	1,668,680	187,609	-

(*1) 상기 채권은 손실충당금이 고려되지 않은 총액이며, 당분기말과 전기말 현재 연결실체는 공동기업 Hana Innosys Latin America의 매출채권과 미수금 잔액에 대하여 손실충당금을 설정하고 있습니다.

(*2) 대여금 잔액은 제외되어 있으며, 대여금의 내역은 주석 26.(4)에 기재되어 있습니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자 대여금의 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: USD)		
구분	당분기말	전기말
Hana Innosys Latin America(*1)	USD 4,120,700	USD 4,120,700

(*1) 상기 대여금은 손실충당금이 고려되지 않은 총액이며, 당분기말과 전기말 현재 연결실체는 지배 기업의 종속기업인 Hana Micron America Inc.가 보유한 공동기업 대여금 전액에 대하여 손실충당금을 설정하고 있습니다.

(5) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)			
제공자	지급보증금액	지급보증내역	지급보증처
최대주주	65,266,332	차입금 지급보증	하나은행 등
	USD 13,680,000	외화지급보증	

2) 전기말

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)			
제공자	지급보증금액	지급보증내역	지급보증처
최대주주	65,716,472	차입금 지급보증	하나은행 등
	USD 15,000,000	외화지급보증	

(6) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다(주석 8 참조).

(단위: 천원)					
구분	특수관계자 유형	특수관계자 명칭	거래내역	당분기	전분기
출자(*1)	기타	최대주주 등	전환권행사	8,150,610	-

(*1) 당분기 중 제12회 무보증 사모 영구 전환사채의 제3자 지정 가능 매도청구권을 행사하여 최대주주 등은 전환사채 8,151백만원을 인수하였으며, 이후 전환권을 행사하여 당사의 보통주 766,610주(전환가액 10,632원)를 취득하였습니다. 연결실체는 상기 매도청구권 행사로 인하여 당기손익-공정가치 측정 금융자산 거래손실 13,869백만원을 인식하였습니다(주석 19 참조).

(7) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 등기이사 및 감사를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급됐거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기	전분기

급여 및 상여	879,206	896,842
퇴직급여	72,998	100,372
주식보상비용	105,107	77,966
합계	1,057,311	1,075,180

27. 현금흐름

당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기	전분기
1. 분기순이익(손실)	(16,855,504)	13,869,142
2. 조정	66,877,620	36,214,006
(1) 비용의 가산	77,133,740	43,591,349
퇴직급여	2,063,661	1,993,354
주식보상비용	315,925	143,089
감가상각비 및 사용권자산상각비	32,983,241	26,787,118
무형자산상각비	2,227,039	1,341,972
기타의대손상각비	-	22,501
외화환산손실	10,430,497	3,100,993
유형자산폐기손실	-	20,429
이자비용	14,486,741	8,548,184
법인세비용(수익)	(3,501,321)	1,551,588
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	1,838,384	-
당기손익-공정가치 측정 금융자산 거래손실	13,858,692	-
통화선도평가손실	1,471,852	-
사채상환손실	8,619	-
상각후원가 측정 금융자산 손상차손	810,000	-
지분법손실	51,112	-
기타	89,298	82,121
(2) 수익의 차감	(10,256,120)	(7,377,343)
외화환산이익	7,847,834	6,981,400
유형자산처분이익	72,421	-
이자수익	402,997	346,567
지분법이익	-	46,294
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	89,947	-
당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가이익	229,557	-
매각예정비유동자산처분이익	1,528,484	-
금융상품평가이익	-	2,643
대손충당금환입	858	5

기타	84,022	434
3. 순운전자본의 변동	(31,234,511)	(37,854,916)
매출채권의 증가	(52,080,247)	(15,694,191)
계약자산의 증가	(2,064,235)	(4,493,420)
기타유동금융자산의 증가	(1,931,807)	(4,590,217)
기타자산의 증가(감소)	(2,497,038)	889,120
재고자산의 증가(감소)	(16,405,620)	22,564,560
기타비유동금융자산의 감소(증가)	2,626	(494,874)
매입채무의 증가(감소)	34,349,034	(36,029,192)
기타유동금융부채의 증가(감소)	10,760,473	3,853,870
기타비유동금융부채의 감소(증가)	(1,958,808)	(2,232,028)
기타부채의 증가(감소)	1,291,654	(950,966)
퇴직금의 지급	(2,628,548)	(1,205,850)
사외적립자산의 증가	1,928,005	528,272
영업으로부터 창출된 현금흐름	18,787,605	12,228,232

28. 우발채무와 약정사항

(1) 연결실체는 삼성전자(주) 등과 외주가공과 관련된 거래기본계약 및 외주단가계약을 체결하고 있습니다.

(2) 2021년 11월 12일 종속기업인 Hana Micron Vina Co., Ltd.(이하 'Vina')는 SK하이닉스(주)(이하 'SKH')와 반도체 후공정 위탁 관련 외주임가공계약을 체결하였으며, 동 계약의 이행 보증을 위하여 지배기업은 SKH와 사업협력계약(이하 '본 계약')을 체결하였습니다. 본 계약에 포함되어 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

1) 자금조달 이행 의무

지배기업은 Vina로 하여금 본 계약 체결일로부터 180일 이내에 금융기관과 3천억원 이상의 1차 대출계약을 체결하고, 1차 대출계약일로부터 1년 이내에 1차 대출계약 상 대출금액과 합계액이 4천억원 이상이 되도록 2차 대출계약을 체결하도록 하여야 합니다. 만약 기한 내 대출계약이 체결되지 않을 경우 해당 기한의 말일로부터 3개월 이내에 Vina로 하여금 2천 5백억원 규모의 유상증자를 결의하도록 하고, 이에 따라 발행되는 Vina 주식을 지배기업이 전량 인수하기로 하였습니다.

Vina는 한국산업은행 및 한국수출입은행과 차입 계약을 체결(차입한도: USD 175,000,000)하였으며, 차입기간은 최초 인출일인 2022년 12월 5일로부터 5.5년으로 당분기말 현재 차입 실행 잔액은 USD 80,000,000 입니다. 또한, Vina는 Citibank N.A. 등과 차입 계약을 체결(차입한도: USD 200,000,000)하였으며, 당분기말 현재 차입 실행 잔액은 USD 118,000,000입니다.

2) 이행보증 의무

지배기업은 SKH와 Vina가 체결한 외주임가공계약과 관련하여, SKH에 대하여 Vina가 부담하는 계약 상 의무 일체의 이행을 보증하고, 의무 불이행으로 인하여 Vina가 SKH에 부담해야 하는 손해배상채

무 등 일체의 의무 이행을 1조원(외주임가공계약: 6천억원, 장비임대차계약: 4천억원)을 한도로 연대하여 보증해야 합니다.

3) 주식의 양도제한 등

지배기업은 본 계약의 계약기간 중, SKH의 사전 서면 동의 없이는 Vina의 주식 또는 신주인수권의 전부 또는 일부를 경쟁회사 및 경쟁회사의 계열회사 또는 특수관계인(이하 '금지된 양수인')에게 양도(담보의 제공, 제한 부담의 설정, 기타 처분행위를 모두 포함) 하거나, 금지된 양수인 이외의 제3자에게 지배기업이 소유한 Vina의 경영권을 상실하게 되는 결과를 초래하도록 보유주식을 양도할 수 없습니다. 또한, 지배기업은 경영권을 상실하지 아니하는 범위의 보유주식 일부를 금지된 양수인 이외의 제3자에게 양도하고자 하는 경우, SKH에게 우선적으로 해당 주식을 매수할 수 있는 권리를 부여하여야 합니다.

(3) 당분기말 현재 연결실체는 인허가 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 18,720백만원(전기말: 17,289백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 기타 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD, BRL)							
약정내용	금융기관명	약정한도					
		당분기말			전기말		
		외화금액 (USD)	외화금액(BRL)	원화금액	외화금액 (USD)	외화금액 (BRL)	원화금액
운전자금대출	한국산업은행 등	10,000,000	53,827,527	210,343,887	10,000,000	43,490,702	210,034,306
운전자금대출	한국수출입은행, 한국산업은행	175,000,000	-	-	175,000,000	-	-
시설자금대출	Citibank N.A. 등	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
무역금융대출	신한은행 등	-	-	105,500,000	-	-	105,500,000
시설자금대출	신한은행 등	5,000,000	137,136,125	194,335,471	5,000,000	132,908,651	182,584,101
외화지급보증	신한은행 등	7,000,000	-	-	10,000,000	-	-
회전신용대출	하나은행 LA Financial	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-
채권유동화	한국산업은행(*1)	-	-	56,800,000	-	-	57,500,000
채권유동화	하나마이크론제삼차 주식회사 (*2)	-	-	27,200,000	-	-	29,660,000
채권유동화	하나머티리얼즈제일차 유한회사 (*3)	-	-	11,000,000	-	-	12,000,000
사모사채	메리츠증권 등	-	-	120,000,000	-	-	120,000,000
전자외상매출채권담보대출	하나은행	-	-	40,010	-	-	40,010
선물환	신한은행 등	9,400,000	-	-	2,500,000	-	-
합계		409,400,000	190,963,652	725,219,368	405,500,000	176,399,353	717,318,417

(*1) 연결실체는 삼성전자(주), SK하이닉스(주)로부터 발생하는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하였습니다(주석 15 참조).

(*2) 연결실체는 삼성전자(주), SK하이닉스(주)로부터 발생하는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하고, 그에 따라 취득한 수익권에 대하여 한국산업은행, 전북은행 및 하나마이크론제삼차 주식회사를 제1종 수익자로 지정하는 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 연결실체는 하나마이크론제삼차 주식회사를 위해 172억원의 자금보충의무 및

조건부채무인수 의무를 부담하고 있습니다(주석 15 참조).

(*3) 연결실체는 도쿄일렉트론 코리아로부터 발생하는 미래 발생채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하고, 그에 따라 취득한 수익권에 대하여 하나머티리얼즈제일차 유한회사와 수익근질권 설정계약을 체결하였습니다. 그리고 하나머티리얼즈제일차 유한회사에 대하여 자금보충이행 사유가 발생할 때에는 자금보충의무를 부담하기로 약정하였습니다(주석 15 참조).

(5) 당분기말과 전기말 현재 자금보충 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
금융기관	약정한도액		제공자	구분
	당분기말	전기말		
하나머티리얼즈제일차 유한회사 (*1)	11,000,000	12,000,000	하나머티리얼즈(주)	자금보충(*1)
스마트파이낸싱제철차 주식회사 (*2)	20,000,000	20,000,000	하나머티리얼즈(주)	자금보충(*2)
하나마이크론제삼차 주식회사(*3)	17,200,000	18,760,000	하나머티리얼즈(주)	자금보충(*3)

(*1) 연결실체는 하나머티리얼즈제일차 유한회사를 통한 자금차입과 관련하여 채권 수납액으로 선순위채무를 이행하기에 자금이 부족한 것으로 업무수탁자인 한국산업은행이 판단하는 경우 부족자금 상당액을 대여(자금보충약정)하기로 약정을 체결하였습니다(주석 15 참조).

(*2) 연결실체는 스마트파이낸싱제철차 주식회사가 채권 수납액으로 지급채무를 이행하기에 자금이 부족할 것으로 예상되어 자금보충을 요청할 경우 부족자금 상당액을 지급해주시기로 약정을 체결하였습니다(주석 15 참조).

(*3) 연결실체는 하나마이크론제삼차 주식회사가 채권 수납액으로 지급채무를 이행하기에 자금이 부족할 것으로 예상되어 자금보충을 요청할 경우 부족자금 상당액을 대여하기로 하고 자금보충의무를 이행하지 아니하는 경우 연결실체가 인수대상채무를 인수하는 내용의 약정을 체결하였습니다(주석 15 참조).

(6) 지배기업은 종속기업인 하나더블유엘에스(주)가 발행한 전환우선주의 인수인과 주주간 계약을 체결하였으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	풋옵션1(*1)	풋옵션2	콜옵션
권리자	인수인	인수인	당사
의무자	당사	당사	인수인
행사사유	기한내 IPO 미달성 목표실적 미달 환경인허가 미취득	IPO 고의지연 미이행 주요계약사항 위반	IPO 공모가 기준 Refixing 후 투자자 보유지분 50% 이상
행사대상	투자자 주식 전부	투자자 주식 전부 또는 일부	투자자지분 50% -1주가 되는 주식수
행시기간	IPO기한 만료 후 6개월 내	행사사유 인지 후 6개월 내	IPO 공모가 기준 Refixing 후 1개월 이내
행사가액	신주 발행가액에 연복리 5%	신주 발행가액에 연복리 9%	신주 발행가액에 연복리 7% 적용

(*1) 연결실체는 풋옵션으로 인해 자기지분상품을 매입할 의무에 대한 상환금액의 현재가치에 해당하는 금융부채를 인식하여 장기미지급금으로 계상하였습니다.

(7) 연결실체가 제9회, 제10회, 제13회 무보증사모사채 발행 계약조건에 따라 매입한 후순위 유동화

증권 1,860백만원에 대하여 유동화회사가 근질권을 설정하고 있습니다(주석 16 참조).

(8) 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류 중인 소송은 2건이며, 연결실체는 동 소송의 전망을 예측할 수 없으나 소송 결과가 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

(9) 연결실체는 전분기 중 신종자본증권을 발행하였으며, 관련 약정의 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용
사채의 명칭	제12회 무보증 영구 전환사채
사채의 발행금액	48,000,000,000원
사채의 만기	2053년 3월 15일(30년), 단, 발행회사 재량에 따라 동일한 조건으로 만기연장 가능
표면이율	0.00%
만기보장수익률	만기보장수익률은 연 2.5%(연 복리로 계산)임. 본 사채 발행 후 3년이 되는 날에 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 "발행회사의 등급" 3년 만기 무보증 공모 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균에 연 1.00%의 가산금리를 가산하여 산정됨. 이후 매 1년째 되는 날마다 직전 이자율에 연 1.00%의 가산금리를 가산하여 산정됨
중도상환권	사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없음. 발행회사는 발행일로부터 36개월이 되는 날(2026년 3월 15일) 및 이후 매 3개월마다 본 사채 전부에 대하여 중도상환 할 수 있음
전환조건	10,632원/주
전환청구기간	본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2024년 3월 15일)부터 만기일 1개월 전(만기 비연장시 2053년 2월 15일)까지로 함
매도청구권	발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2024년 3월 15일)부터 36개월이 되는 날의 직전일(2026년 3월 14일)까지 매 3개월이 되는 날에 발행가액의 27% 내에서 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있음

연결실체는 상기 신종자본증권에 대하여 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않으므로 자본으로 분류하였으며, 제3자 지정 가능 매도청구권을 별도로 분리하여 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 인식하였습니다(주석 8, 19참조).

한편, 당분기 중 전환사채의 매도청구권 일부가 행사되었고, 전환사채의 일부가 전환청구됨에 따라 보통주 4,062,321주가 발행되었으며, 당분기말 현재 신종자본증권 잔액은 4,809백만원 입니다(주석 19 참조).

29. 금융위험관리

(1) 자본위험관리

연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.

연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 당분기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
부채	1,276,087,403	1,180,702,762
자본	528,822,170	544,387,369
부채비율	241.31%	216.89%

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)					
구분	상각후원가 측정금융자산	당기손익-공정가치 측정금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정금융자산	합계	공정가치
현금및현금성자산	104,456,333	-	-	104,456,333	(*1)
단기금융상품	12,169,958	-	-	12,169,958	(*1)
매출채권	137,103,090	-	-	137,103,090	(*1)
기타유동금융자산	15,105,514	-	-	15,105,514	(*1)
기타비유동금융자산	3,356,526	-	-	3,356,526	(*1)
장기금융상품	883,320	-	-	883,320	(*1)
공정가치측정금융자산	-	15,745,156	1,111,743	16,856,899	16,856,899
합계	273,074,741	15,745,156	1,111,743	289,931,640	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.

2) 전기말

(단위: 천원)					
구분	상각후원가 측정금융자산	당기손익-공정가치 측정금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정금융자산	합계	공정가치
현금및현금성자산	106,682,628	-	-	106,682,628	(*1)
단기금융상품	6,476,837	-	-	6,476,837	(*1)
매출채권	80,582,933	-	-	80,582,933	(*1)
기타유동금융자산	8,576,468	-	-	8,576,468	(*1)
기타비유동금융자산	2,532,708	-	-	2,532,708	(*1)
장기금융상품	373,030	-	-	373,030	(*1)
공정가치측정금융자산	-	33,125,287	1,111,743	34,237,030	34,237,030
합계	205,224,604	33,125,287	1,111,743	239,461,634	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)					
구분	상각후원가 측정금융부채	당기손익-공정가 치 측정금융부채	기타	합계	공정가치
매입채무	95,133,637	-	-	95,133,637	(*1)
기타유동금융부채	126,358,710	-	-	126,358,710	(*1)
단기차입금	333,721,467	-	-	333,721,467	(*1)
유동성장기차입금	65,847,778	-	-	65,847,778	(*1)
유동성사채	74,853,835	-	-	74,853,835	(*1)
장기차입금(*2)	496,030,711	-	-	496,030,711	491,026,964
사채(*2)	44,890,219	-	-	44,890,219	44,372,121
리스부채(*3)	-	-	3,700,788	3,700,788	(*1)
기타비유동금융부채	10,559,910	-	-	10,559,910	(*1)
공정가치측정금융부채	-	1,575,831	-	1,575,831	1,575,831
합계	1,247,396,267	1,575,831	3,700,788	1,252,672,886	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.

(*2) 수준 3으로 분류되며, 공정가치는 신용위험을 감안한 할인율을 고려한 현금흐름할인모형으로 계산되었습니다.

(*3) 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 리스부채입니다.

2) 전기말

(단위: 천원)					
구분	상각후원가 측정금융부채	당기손익-공정가 치 측정금융부채	기타	합계	공정가치
매입채무	55,901,276	-	-	55,901,276	(*1)
기타유동금융부채	105,687,837	-	-	105,687,837	(*1)
단기차입금	292,300,676	-	-	292,300,676	(*1)
유동성장기차입금	63,664,196	-	-	63,664,196	(*1)
유동성사채	119,743,385	-	-	119,743,385	(*1)
장기차입금(*2)	502,339,719	-	-	502,339,719	495,856,769
리스부채(*3)	-	-	3,955,929	3,955,929	(*1)
기타비유동금융부채	12,931,959	-	-	12,931,959	(*1)
공정가치측정금융부채	-	325,611	-	325,611	325,611
합계	1,152,569,048	325,611	3,955,929	1,156,850,588	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.

(*2) 수준 3으로 분류되며, 공정가치는 신용위험을 감안한 할인율을 고려한 현금흐름할인모형으로 계산되었습니다.

(*3) 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 리스부채입니다.

(4) 금융위험관리

1) 금융위험관리목적

연결실체의 재무부서는 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(외환위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험을 포함하고 있습니다.

요약분기재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2023년 12월 31일 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 한편, 연결실체의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

2) 시장위험관리

① 외환위험관리

연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다.

② 이자율위험관리

연결실체의 이자율위험은 주로 변동이자부 차입금에 연관되어 있으며, 이와 관련된 이자비용은 이자율위험에 노출되어 있습니다. 고정이자율이 적용되는 차입금의 경우이자율변동에 따른 당기손익이나 자본에 미치는 영향은 없습니다.

당분기말 현재 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 연간 이자비용은 6,452백만원(전기말: 6,115백만원) 만큼 증가 또는 감소합니다.

③ 기타 가격위험요소

연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다.

3) 신용위험관리

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 연결실체는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결실체가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며, 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신용위험은 매년 검토

되고 승인된 거래한도에 의하여 통제됩니다.

매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
자금보충약정(*1)	48,200,000	50,760,000

(*1) 자금보충약정과 관련된 연결실체의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대금액입니다.

한편, 연결실체는 신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 자금보충약정을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다.

4) 유동성위험관리

유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.

(5) 금융상품의 공정가치

1) 경영진은 장기차입금과 사채를 제외한 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액을 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

2) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격으로, 해당 공시가격에는 금리 상승 및 인플레이션, ESG관련 위험 등의 경제환경 변화에 대한 시장의 가정이 반영되어 있음 (수준 1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)
- 비상장 지분증권과 ESG관련 위험으로 인해 유의적인 관측불가능한 조정이 반영되는 금융상품과 같이, 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

① 다음 표는 최초 인식 후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.

가. 당분기말

(단위: 천원)				
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	15,745,156	15,745,156
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	1,111,743	1,111,743
당기손익-공정가치 측정 금융부채	-	1,575,831	-	1,575,831

나. 전분기말

(단위: 천원)				
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	33,125,287	33,125,287
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	1,111,743	1,111,743
당기손익-공정가치 측정 금융부채	-	325,611	-	325,611

당분기와 전분기 중 수준 1과 수준 2 간의 대체는 없습니다.

② 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산과 금융부채의 당분기와 전분기 중 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 당분기

(단위: 천원)					
구분	기초	취득	처분	평가손익	분기말
당기손익-공정가치 측정 금융자산	33,125,287	-	(15,541,747)	(1,838,384)	15,745,156
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,111,743	-	-	-	1,111,743

나. 전분기

(단위: 천원)					
구분	기초	취득	처분	평가손익	분기말
당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,409,847	4,242,504	-	-	9,652,351
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,082,512	-	-	-	1,082,512

3) 당분기말 현재 당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2 와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)				
구분	당분기말			

	공정가치	수준	가치평가방법	투입변수
당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,266,858	3	순자산접근법	기초자산 가격
	300,436	3	(*1)	-
	2,000,310	3	(*2)	-
	8,177,552	3	옵션가격결정모형	주가 변동성
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,011,743	3	현금흐름할인법	할인율
	100,000	3	(*3)	-
당기손익-공정가치 측정 금융부채	1,575,831	2	현금흐름할인법	환율, 할인율 등

- (*1) 해당 상환전환우선주의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우로서 취득원가를 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하였습니다.
- (*2) 전기 중 취득한 전환우선주로, 취득원가를 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하였습니다.
- (*3) 해당 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우로서 취득원가를 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하였습니다.

4. 재무제표

4-1. 재무상태표 재무상태표

제 24 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 24 기 1분기말	제 23 기말
자산		
Ⅰ. 유동자산	316,397,411,070	251,527,079,231
(1) 현금및현금성자산	53,870,396,860	17,507,687,024
(2) 매출채권	153,408,625,109	134,124,659,155
(3) 계약자산	3,943,204,705	1,005,055,476
(4) 기타유동금융자산	37,411,391,518	30,281,588,129
(5) 기타유동자산	15,169,850,639	15,783,273,523
(6) 당기손익-공정가치 측정 금융자산	9,073,572,884	24,791,649,787
(7) 당기법인세자산	5,798,351,582	1,231,711,971
(8) 재고자산	35,464,755,535	24,544,191,928
(9) 계약원가	2,257,262,238	2,257,262,238
Ⅱ. 매각예정비유동자산	1,097,350,091	1,097,350,091
Ⅲ. 비유동자산	712,063,614,173	730,576,350,166
(1) 장기금융상품	319,172,886	308,986,169
(2) 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,296,436,403	4,404,500,338
(3) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,111,743,031	1,111,743,031
(4) 기타비유동금융자산	93,696,875,703	92,238,437,330
(5) 기타비유동자산	1,705,677,704	1,813,034,067
(6) 유형자산	292,458,306,291	292,145,433,336

(7)투자부동산	51,424,784,087	59,003,658,122
(8)무형자산	5,302,834,054	4,275,132,769
(9)사용권자산	977,391,182	1,102,432,655
(10)종속기업및공동기업투자	255,846,457,555	269,444,694,563
(11)순확정급여자산	4,923,935,277	4,728,297,786
자산총계	1,029,558,375,334	983,200,779,488
부채		
Ⅰ.유동부채	483,721,290,681	453,530,224,755
(1)매입채무	90,911,154,274	50,261,824,315
(2)기타유동금융부채	38,994,224,833	34,257,291,574
(3)단기차입금	208,200,000,000	176,700,000,000
(4)유동성장기차입금	43,124,978,481	46,017,096,114
(5)유동성사채	74,853,835,083	119,743,384,756
(6)당기손익-공정가치측정금융부채	20,922,697,210	19,450,845,594
(7)당기법인세부채	344,498,013	337,559,606
(8)기타 유동부채	557,700,631	527,129,685
(9)금융보증부채	5,106,767,237	5,474,588,856
(10)리스부채	705,434,919	760,504,255
Ⅱ.비유동부채	190,143,801,557	156,600,915,031
(1)장기차입금	128,515,966,331	137,910,475,715
(2)사채	44,890,218,993	
(3)기타비유동금융부채	3,729,140,084	4,175,903,466
(4)리스부채	370,403,735	442,183,624
(5)이연법인세부채	12,638,072,414	14,072,352,226
부채총계	673,865,092,238	610,131,139,786
자본		
Ⅰ.자본금	26,068,237,500	23,989,927,000
Ⅱ.기타불입자본	265,380,111,661	266,930,116,737
Ⅲ.기타자본구성요소	21,096,731,060	16,793,184,111
Ⅳ.이익잉여금(결손금)	43,148,202,875	65,356,411,854
자본총계	355,693,283,096	373,069,639,702
자본과부채총계	1,029,558,375,334	983,200,779,488

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 24 기 1분기		제 23 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
Ⅰ.매출	177,404,048,871	177,404,048,871	131,314,915,389	131,314,915,389

II.매출원가	166,237,659,770	166,237,659,770	122,307,000,794	122,307,000,794
III.매출총이익	11,166,389,101	11,166,389,101	9,007,914,595	9,007,914,595
IV.판매비	329,939,586	329,939,586	366,833,840	366,833,840
V.관리비	4,523,722,971	4,523,722,971	4,682,449,412	4,682,449,412
VI.영업이익	6,312,726,544	6,312,726,544	3,958,631,343	3,958,631,343
VII.기타영업외수익	8,677,448,611	8,677,448,611	5,792,329,764	5,792,329,764
VIII.기타영업외비용	1,514,699,939	1,514,699,939	2,479,359,467	2,479,359,467
IX.금융수익	4,855,083,788	4,855,083,788	3,046,933,111	3,046,933,111
X.금융비용	26,978,605,744	26,978,605,744	7,026,792,608	7,026,792,608
XI.지분법손익	(17,265,686,868)	(17,265,686,868)	(9,164,542,493)	(9,164,542,493)
XII.법인세비용차감전순이익(손실)	(25,913,733,608)	(25,913,733,608)	(5,872,800,350)	(5,872,800,350)
XIII.법인세비용	(6,011,142,007)	(6,011,142,007)	(1,409,682,332)	(1,409,682,332)
XIV.분기순이익(손실)	(19,902,591,601)	(19,902,591,601)	(4,463,118,018)	(4,463,118,018)
XV.기타포괄손익	4,396,922,271	4,396,922,271	9,580,657,487	9,580,657,487
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목				
1.순확정급여부채의 재측정요소	93,375,322	93,375,322	101,883,243	101,883,243
2.지분법자본변동	16,472,465	16,472,465	109,513,078	109,513,078
(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목				
1.지분법자본변동	4,287,074,484	4,287,074,484	9,369,261,166	9,369,261,166
XVI.분기총포괄이익(손실)	(15,505,669,330)	(15,505,669,330)	5,117,539,469	5,117,539,469
XVII.주당순이익				
(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(408)	(408)	(93)	(93)
(2)희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(408)	(408)	(93)	(93)

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본								
	자본금	기타불입자본					기타자본항목	이익잉여금	자본 합계
		주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권	신종자본증권	기타불입자본 합계			
2023.01.01 (기초자본)	23,960,927,000	220,423,941,286	(9,693,679,374)	1,989,278,966		212,719,540,878	9,760,022,283	111,417,090,473	357,857,580,634
분기순이익(손실)								(4,463,118,018)	(4,463,118,018)
순확정급여부채의재측정요소								101,883,243	101,883,243
지분법자본변동							9,478,774,244		9,478,774,244
주식보상비용				385,770,868		385,770,868			385,770,868
주식매수선택권의행사									
신종자본증권의발행			4,242,503,808		47,993,624,760	52,236,128,568			52,236,128,568
배당금의 지급								(2,396,092,700)	(2,396,092,700)
신종자본증권의행사									
2023.03.31 (기말자본)	23,960,927,000	220,423,941,286	(5,451,175,566)	2,375,049,834	47,993,624,760	265,341,440,314	19,238,796,527	104,659,762,998	413,200,926,839
2024.01.01 (기초자본)	23,989,927,000	220,783,983,991	(5,451,175,566)	3,603,683,552	47,993,624,760	266,930,116,737	16,793,184,111	65,356,411,854	373,069,639,702
분기순이익(손실)								(19,902,591,601)	(19,902,591,601)
순확정급여부채의재측정요소								93,375,322	93,375,322
지분법자본변동							4,303,546,949		4,303,546,949
주식보상비용				(324,698,636)		(324,698,636)			(324,698,636)
주식매수선택권의행사	47,150,000	1,150,946,509		(327,646,649)		823,299,860			870,449,860

신종자본증권의발행									
배당금의 지급								(2,398,992,700)	(2,398,992,700)
신종자본증권의행사	2,031,160,500	41,136,267,231			(43,184,873,531)	(2,048,606,300)			(17,445,800)
2024.03.31 (기말자본)	26,068,237,500	263,071,197,731	(5,451,175,566)	2,951,338,267	4,808,751,229	265,380,111,661	21,096,731,060	43,148,202,875	355,693,283,096

4-4. 현금흐름표
현금흐름표

제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 24 기 1분기	제 23 기 1분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	22,492,155,169	(18,959,908,845)
(1)분기순이익(손실)	(19,902,591,601)	(4,463,118,018)
(2)조정	39,871,899,847	18,983,931,288
(3)순운전자본의변동	9,033,261,961	(25,038,555,224)
(4)이자의 수취	176,020,909	69,105,036
(5)이자의 지급	(6,260,255,737)	(5,572,513,204)
(6)법인세납부액(환급액)	(426,180,210)	(2,938,758,723)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(4,941,935,653)	(73,441,581,382)
(1)유형자산의 취득	(3,685,730,097)	(2,008,931,378)
(2)유형자산의 처분	1,088,106,572	3,644,651,922
(3)무형자산의 취득	(1,257,655,411)	(374,292,800)
(4)정부보조금의 수취		206,690,909
(5)종속기업투자주식의 취득		(6,562,400,000)
(6)단기금융상품의 증가		(9,000,000)
(7)장기금융상품의 증가	(10,186,717)	
(8)상각후원가측정금융자산의 취득	(810,000,000)	
(9)기타비유동금융자산의 증가	(267,470,000)	(68,888,300,035)
(10)기타비유동금융자산의 감소	1,000,000	550,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	18,810,981,870	86,755,364,388
(1)단기차입금의 차입	31,500,000,000	49,500,000,000
(2)단기차입금의 상환		(14,000,000,000)
(3)사채의 발행	44,890,030,000	
(4)사채의 상환	(45,000,000,000)	
(5)장기차입금의 차입		10,000,000,000
(6)유동성장기차입금의 상환	(12,442,198,952)	(6,618,449,663)
(7)임대보증금의 증가		105,000,000
(8)임대보증금의 감소	(753,000,000)	(4,190,000)
(9)리스부채의상환	(239,038,478)	(220,620,709)
(10)주식매수선택권의 행사	872,635,100	

(11)신증자본증권의 발행		47,993,624,760
(12)전환 관련 비용의 지급	(17,445,800)	
IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,508,450	397
V.현금및현금성자산의순증가(감소)	36,362,709,836	(5,646,125,442)
VI.기초현금및현금성자산	17,507,687,024	26,842,043,170
VII.기말현금및현금성자산	53,870,396,860	21,195,917,728

5. 재무제표 주석

제 24(당) 기 1분기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 03월 31일까지

제 23(전) 기 1분기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지

하나마이크론 주식회사

1. 당사의 개요

하나마이크론(주)(이하 "당사")는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 상장한 회사로서, 반도체 및 액정표시장치인 메모리 및 비메모리 조립 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 설립 후 수차례의 증자 및 합병 등을 통하여 당분기말 현재의 자본금은 보통주 26,068백만원이며, 당분기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)
최창호	8,669,972	16.63%
하나머티리얼즈(주)	4,744,083	9.10%
최대주주의 특수관계인	815,151	1.56%
기타 소액주주 등	37,907,269	72.71%
합계	52,136,475	100.00%

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

당사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

2.1.1 당사가 채택한 제·개정 기준서 및 해석서

당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용

하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기 지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야 하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야 하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 재무제표에 미치는 영향이 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 당사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여

통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2 회계정책

요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 매출채권, 계약자산 및 기타금융자산

당분기말과 전기말 현재 매출채권, 계약자산 및 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

구분	유동							비유동				
	매출채권	계약자산(*1)	기타유동금융자산				합계	기타비유동금융자산			합계	
			미수금	단기대여금	미수수익	보증금		장기미수금	장기대여금	보증금		
총 장부금액	163,979,793	3,943,544	36,718,713	300,000	3,237,753	401,470	208,581,273	28,948,636	95,151,300	1,202,056	125,301,992	
현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,371,330)	-	(3,371,330)	
손실충당금	(10,571,168)	(339)	(3,246,545)	-	-	-	(13,818,052)	-	(28,233,786)	-	(28,233,786)	
순 장부금액	153,408,625	3,943,205	33,472,168	300,000	3,237,753	401,470	194,763,221	28,948,636	63,546,184	1,202,056	93,696,876	

(*1) 계약자산은 고객이 자산을 인수하기 전에 진행률에 따라 인식한 수익과 관련한 대가로 인식합니다. 계약자산에 대한 청구권은 당분기말 현재 발생하지 않았으며, 고객이 자산을 인수한 시점에 계약자산으로 인식한 잔액은 매출채권으로 재분류합니다.

(2) 전기말

구분	유동							비유동				
	매출채권	계약자산(*1)	기타유동금융자산				합계	기타비유동금융자산			합계	
			미수금	단기대여금	미수수익	보증금		장기미수금	장기대여금	보증금		
총 장부금액	144,254,483	1,005,175	29,617,705	300,000	3,242,965	364,000	178,784,328	28,948,636	93,594,715	973,056	123,516,407	
현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,963,180)	-	(3,963,180)	
손실충당금	(10,129,824)	(120)	(3,243,082)	-	-	-	(13,373,026)	-	(27,314,790)	-	(27,314,790)	

순 장부금액	134,124,659	1,005,055	26,374,623	300,000	3,242,965	364,000	165,411,302	28,948,636	62,316,745	973,056	92,238,437
--------	-------------	-----------	------------	---------	-----------	---------	-------------	------------	------------	---------	------------

(*1) 계약자산은 고객이 자산을 인수하기 전에 진행률에 따라 인식한 수익과 관련한 대가로 인식합니다. 계약자산에 대한 청구권은 전기말 현재 발생하지 않았으며, 고객이 자산을 인수한 시점에 계약자산으로 인식한 잔액은 매출채권으로 재분류합니다.

5. 재고자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)								
구분	당분기말				전기말			
	취득원가	평가손실 총당금	정부보조금	장부금액	취득원가	평가손실 총당금	정부보조금	장부금액
상품	4,999,756	-	-	4,999,756	580,684	-	-	580,684
원재료	21,428,606	(871,277)	-	20,557,329	17,084,018	(888,672)	-	16,195,346
저장품	2,444,341	(166,376)	-	2,277,965	2,138,567	(142,286)	-	1,996,281
미착품	1,857,825	-	-	1,857,825	-	-	-	-
용지	5,815,815	-	(43,934)	5,771,881	5,815,815	-	(43,934)	5,771,881
합계	36,546,343	(1,037,653)	(43,934)	35,464,756	25,619,084	(1,030,958)	(43,934)	24,544,192

(2) 당분기 중 당사는 재고자산의 순실현가능가치에 따른 재고자산평가손실 7백만원(전분기: 23백만원)을 인식하였으며, 포괄손익계산서의 '매출원가'에 포함되었습니다.

(3) 당사의 재고자산은 차입금과 관련하여 담보로 제공되었습니다(주석 13 참조).

6. 공정가치 측정 금융자산

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산

당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
지분증권 등	2,557,824	2,557,824
파생상품자산(*1)	8,177,552	23,874,627
기타수취채권(*2)	2,634,633	2,763,699
합계	13,370,009	29,196,150

(*1) 당사는 전기 중 제12회 무보증 사모 영구 전환사채를 발행하였으며, 동 전환사채는 제3자 지정 가능한 매도청구권이 내재된 상품으로, 매도청구권을 별도로 분리하여 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 인식하였습니다. 한편, 후속기간 동안의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(*2) 당사는 전기 중 종속기업 Hana Micron Vina Co., Ltd.에 제공한 지급보증 관련하여 Hana Micron Vina Co., Ltd.로부터 수수료를 수취하는 계약을 체결하였으며, 동 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되지 않으므로 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 인식하였습니다.

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
비상장주식	1,111,743	1,111,743

7. 상각후원가 측정 금융자산

당분기말과 전기말 현재 상각후원가 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
사채(*1)	-	-

(*1) 당사는 제9회, 제10회, 제13회 무보증사모사채의 계약조건에 따라 취득한 후순위 유동화증권을 상각후원가 측정 금융자산으로 분류하였으며(주석 14 참조), 전기 이전 및 당분기 중 회수가능성을 평가하여 전액 손상을 인식하였습니다.

8. 종속기업투자 및 공동기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 종속기업투자 및 공동기업투자의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)							
회사명	소재지	당분기말			전기말		
		지분율(%)	취득원가	장부금액	지분율(%)	취득원가	장부금액
종속기업 :							
Hana Micron America Inc.	미국	100.00	36,114,183	-	100.00	36,114,183	-
하나머티리얼즈(주)(*1)	한국	32.93	9,928,088	95,144,880	32.93	9,928,088	93,246,462
(주)이피웍스(*2)	한국	51.19	5,622	-	51.19	5,622	-
(주)이노메이트	한국	79.75	4,115,018	-	79.75	4,115,018	-
하나마이크론태양광(주)	한국	100.00	-	-	100.00	-	-
Hana Micron Vietnam Co., Ltd.	베트남	100.00	6,553,904	-	100.00	6,553,904	61,327
Hana Micron Vina Co., Ltd.	베트남	100.00	212,079,480	139,434,662	100.00	212,079,480	150,804,371
HT Micron Semicondutores S.A.	브라질	100.00	85,806,546	19,825,911	100.00	85,806,546	21,860,365
하나더블유엘에스(주)(*3)	한국	61.54	40,479,239	1,441,005	61.54	40,479,239	3,472,170
Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.	브라질	100.00	6,304,847	-	100.00	6,304,847	-
소계			401,386,927	255,846,458		401,386,927	269,444,695
공동기업 :							
Hana Innosys Latin America	브라질	50.00	637,402	-	50.00	637,403	-
합계			402,024,329	255,846,458		402,024,330	269,444,695

(*1) 하나머티리얼즈(주)의 경우 당사가 직접 보유한 지분에 대한 지분율은 당분기말과 전기말 현재 32.93%이나, 기타의 주주로부터 포괄적으로 위임받은 의결권(2,300,000주)을 포함한 의결권 보유

비율은 44.71%로 산정됩니다. 당분기말과 전기말 현재 당사는 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석 양상 등을 종합적으로 고려하여 당사가 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

(*2) 당사가 보유하고 있는 (주)이피웍스의 주식은 의결권이 존재하는 상환전환우선주(86,000주)이며, 당사의 의결권이 50%를 초과하기 때문에 종속기업으로 분류하고 있습니다.

(*3) 2021년 1월 1일자로 하나마이크론(주)의 BUMP사업부문을 물적분할하여 하나더블유엘에스(주)를 설립합니다. 물적분할 설립일 이후 발행한 전환우선주를 포함한 당분기말 현재 지분율은 61.54%입니다.

(2) 당분기와 전분기 중 종속기업투자 및 공동기업투자의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 천원)				
회사명	기초	지분법손익	지분법 자본변동(*2)	분기말
하나머티리얼즈(주)	93,246,462	1,796,446	101,972	95,144,880
Hana Micron America Inc.	-	-	-	-
Hana Micron Vietnam Co., Ltd.(*1)	61,327	(61,327)	-	-
Hana Micron Vina Co.,Ltd.	150,804,371	(13,939,883)	2,570,174	139,434,662
HT Micron Semicondutores S.A.	21,860,365	(1,380,162)	(654,292)	19,825,911
하나더블유엘에스(주)	3,472,170	(2,031,165)	-	1,441,005
Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.(*1)	-	-	-	-
합계	269,444,695	(15,616,091)	2,017,854	255,846,458

(*1) Hana Micron Vietnam Co., Ltd., Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.의 지분법 중지로 인하여 인식하지 못한 미반영 지분법손실 및 지분법자본변동을 순투자의 일부인 대여금에서 추가로 인식하고 있습니다. 당분기 중 미반영 지분법손실 및 지분법자본변동으로 변동한 대여금은 Hana Micron Vietnam Co., Ltd. 152백만원 및 (-)199백만원, Hana Electronics Industria E Comercio Ltda. 1,498백만원 및 (-)840백만원이며, 상기 지분법손익 및 지분법자본변동에는 포함되어 있지 않습니다(주석 24 참조).

(*2) 종속기업투자주식에 대한 순투자의 일부인 화폐성항목에서 발생한 외환차이를 지분법자본변동으로 인식한 금액은 3,326백만원으로 상기 지분법자본변동에는 포함되어 있지 않습니다.

2) 전분기

(단위: 천원)					
회사명	기초	취득	지분법손익	지분법 자본변동(*2)	분기말
하나머티리얼즈(주)	84,043,432	-	4,529,852	109,513	88,682,797
Hana Micron Vietnam Co.,Ltd.(*1)	-	2,639,000	(2,639,000)	-	-
Hana Micron Vina Co.,Ltd.	95,529,141	-	(1,120,389)	3,119,294	97,528,046
HT Micron Semicondutores S.A.	33,725,387	-	(3,116,237)	2,152,754	32,761,904

하나더블유엘에스(주)	23,849,841	-	(2,248,664)	-	21,601,177
Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.(*1)	-	3,923,400	(3,923,400)	-	-
합계	237,147,801	6,562,400	(8,517,838)	5,381,561	240,573,924

(*1) Hana Micron Vietnam Co., Ltd., Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.의 지분법 증지로 인하여 인식하지 못한 미반영 지분법손실 및 지분법자본변동을 순투자의 일부인 대여금에서 추가로 인식하고 있습니다. 전분기 중 미반영 지분법손실 및 지분법자본변동으로 변동한 대여금은 Hana Micron Vietnam Co., Ltd. 2,111백만원 및 (-)20백만원, Hana Electronics Industria E Comercio Ltda. (-)1,541백만원 및 영(0)원이며, 상기 지분법손익 및 지분법자본변동에는 포함되어 있지 않습니다(주석 24 참조).

(*2) 종속기업투자주식에 대한 순투자의 일부인 화폐성항목에서 발생한 외환차이를 지분법자본변동으로 인식한 금액은 4,097백만원으로 상기 지분법자본변동에는 포함되어 있지 않습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 지분법 적용의 증지로 인하여 인식하지 못한 종속기업 및 공동기업의 주요 누적 미반영 지분법손실 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
구분	당분기말			전기말		
	지분법자본변동	지분법손실	합계	지분법자본변동	지분법손실	합계
Hana Micron America Inc.	504,984	(3,520,448)	(3,015,464)	545,682	(3,574,208)	(3,028,526)
(주)이노메이트	-	(5,514,387)	(5,514,387)	-	(5,315,569)	(5,315,569)

9. 유형자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)				
구분	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	장부금액
토지	48,917,437	-	-	48,917,437
건물	30,240,042	-	(8,360,373)	21,879,669
구축물	5,148,664	-	(2,373,471)	2,775,193
기계장치	468,329,271	(225,166)	(256,833,844)	211,270,261
공구와기구 외	64,481,944	-	(59,147,158)	5,334,786
건설중인자산	2,280,960	-	-	2,280,960
합계	619,398,318	(225,166)	(326,714,846)	292,458,306

2) 전기말

(단위: 천원)				
구분	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	장부금액
토지	45,885,888	-	-	45,885,888

건물	25,692,717	-	(8,155,749)	17,536,968
구축물	5,148,664	-	(2,308,833)	2,839,831
기계장치	468,029,031	(240,883)	(249,253,038)	218,535,110
공구와기구 외	63,979,381	-	(58,639,505)	5,339,876
건설중인자산	2,007,760	-	-	2,007,760
합계	610,743,441	(240,883)	(318,357,125)	292,145,433

(2) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 천원)						
구분	기초	취득	처분	감가상각	대체	분기말
토지	45,885,888	-	-	-	3,031,549	48,917,437
건물	17,536,968	-	-	(204,624)	4,547,325	21,879,669
구축물	2,839,831	-	-	(64,638)	-	2,775,193
기계장치	218,535,110	2,259,537	(1,470,823)	(8,359,563)	306,000	211,270,261
공구와기구 외	5,339,876	502,563	-	(507,653)	-	5,334,786
건설중인자산	2,007,760	579,200	-	-	(306,000)	2,280,960
합계	292,145,433	3,341,300	(1,470,823)	(9,136,478)	7,578,874	292,458,306

2) 전분기

(단위: 천원)						
구분	기초	취득	처분	감가상각	대체	분기말
토지	43,835,477	-	-	-	-	43,835,477
건물	16,317,993	-	-	(150,805)	-	16,167,188
구축물	3,098,382	-	-	(64,638)	-	3,033,744
기계장치	217,836,303	1,056,582	(1,131,905)	(7,901,996)	285,000	210,143,984
공구와기구 외	5,225,424	286,077	-	(482,201)	-	5,029,300
건설중인자산	2,253,409	706,490	-	-	(285,000)	2,674,899
합계	288,566,988	2,049,149	(1,131,905)	(8,599,640)	-	280,884,592

(3) 당분기말과 전기말 현재 당사의 유형자산은 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공되어 있습니다(주석 13 참조).

10. 투자부동산

(1) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말

토지	21,420,623	24,452,172
건물	30,004,161	34,551,486
합계	51,424,784	59,003,658

(2) 당분기와 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 천원)					
구분	기초	취득	공정가치 변동	대체	분기말
토지	24,452,172	-	-	(3,031,549)	21,420,623
건물	34,551,486	-	-	(4,547,325)	30,004,161
합계	59,003,658	-	-	(7,578,874)	51,424,784

2) 전분기

(단위: 천원)					
구분	기초	취득	공정가치 변동	대체	분기말
토지	24,191,319	-	-	-	24,191,319
건물	33,769,007	-	-	-	33,769,007
합계	57,960,326	-	-	-	57,960,326

(3) 당분기말과 전기말 현재 당사의 투자부동산은 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공되어 있습니다(주석 13 참조).

11. 무형자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)					
구분	취득원가	정부보조금	상각누계액	손상차손누계액	합계
기타의무형자산	14,699,693	(22,917)	(10,838,067)	-	3,838,709
회원권	1,617,948	-	-	(276,410)	1,341,538
건설중인자산	122,587	-	-	-	122,587
합계	16,440,228	(22,917)	(10,838,067)	(276,410)	5,302,834

2) 전기말

(단위: 천원)					
구분	취득원가	정부보조금	상각누계액	손상차손누계액	합계

기타의무형자산	14,677,762	(24,167)	(10,525,675)	-	4,127,920
회원권	395,838	-	-	(276,410)	119,428
건설중인자산	27,785	-	-	-	27,785
합계	15,101,385	(24,167)	(10,525,675)	(276,410)	4,275,133

(2) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 천원)					
구분	기초	취득	상각	대체	분기말
기타의무형자산	4,127,920	21,930	(311,141)	-	3,838,709
회원권	119,428	1,222,110	-	-	1,341,538
건설중인자산	27,785	94,802	-	-	122,587
합계	4,275,133	1,338,842	(311,141)	-	5,302,834

2) 전분기

(단위: 천원)					
구분	기초	취득	상각	대체	분기말
기타의무형자산	4,688,227	441,007	(301,569)	11,852	4,839,517
회원권	387,428	-	-	-	387,428
건설중인자산	25,564	3,081	-	(16,684)	11,961
합계	5,101,219	444,088	(301,569)	(4,832)	5,238,906

12. 사용권자산 및 리스부채

(1) 당분기말과 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
리스부채-유동	705,435	760,504
리스부채-비유동	370,404	442,184
합계	1,075,839	1,202,688

(2) 당분기말과 전기말 현재 유형별 사용권자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
건물	520,308	590,285
차량운반구	370,845	339,673

비품	86,238	172,475
합계	977,391	1,102,433

(3) 당분기말과 전분기말 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 천원)				
구분	건물	차량운반구	비품	합계
기초	590,285	339,673	172,475	1,102,433
증가	-	108,017	-	108,017
감가상각	(69,977)	(76,845)	(86,237)	(233,059)
분기말	520,308	370,845	86,238	977,391

2) 전분기

(단위: 천원)				
구분	건물	차량운반구	비품	합계
기초	870,191	414,269	517,425	1,801,885
증가	-	137,357	-	137,357
감가상각	(69,977)	(65,658)	(86,237)	(221,872)
분기말	800,214	485,968	431,188	1,717,370

(4) 당분기와 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기	전분기
사용권자산 감가상각비	233,059	221,872
리스부채 이자비용	13,583	20,578
단기리스 관련 비용	58,354	11,999
소액기초자산리스 관련 비용	2,666	17,589

당분기 중 리스의 총 현금유출은 313,641천원(전분기: 270,787천원) 입니다.

13. 장·단기차입금

(1) 단기차입금

당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)			
차입금 종류	차입처	당분기말 연이자율(%)	당분기말
운전자금대출	대신증권 등	3.07% ~ 6.30%	155,700,000
무역금융대출	신한은행 등	4.30% ~ 5.12%	52,500,000
합계			208,200,000

2) 전기말

(단위: 천원)			
차입금 종류	차입처	전기말 연이자율(%)	전기말
운전자금대출	대신증권 등	3.07% ~ 6.30%	145,700,000
무역금융대출	신한은행 등	4.56% ~ 5.26%	31,000,000
합계			176,700,000

(2) 장기차입금

당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)			
차입금 종류	차입처	당분기말 연이자율(%)	당분기말
시설자금대출	한국산업은행 등	2.50% ~ 5.11%	47,085,621
운전자금대출	국민은행 등	3.99% ~ 6.63%	41,643,887
채권유동화(*1)	한국산업은행	4.93% ~ 5.02%	56,800,000
채권유동화(*2)	한국산업은행 등	5.53% ~ 6.34%	27,200,000
소계			172,729,508
차감: 현재가치할인차금			(1,088,564)
차감: 유동성 대체액			(43,124,978)
합계			128,515,966

(*1) 당사는 삼성전자(주), SK하이닉스(주)로부터 발생하는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하였습니다(주석 26 참조).

(*2) 당사는 삼성전자(주), SK하이닉스(주)로부터 발생하는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하고, 그에 따라 취득한 수익권에 대하여 한국산업은행, 전북은행 및 하나마이크론제삼차 주식회사를 제1종 수익자로 지정하는 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 하나머티리얼즈(주)는 하나마이크론제삼차 주식회사를 위해 172억원의 자금보충의무 및 조건부채무인수 의무를 부담하고 있습니다(주석 26 참조).

2) 전기말

(단위: 천원)			
차입금 종류	차입처	전기말 연이자율(%)	전기말
시설자금대출	한국산업은행 등	2.50% ~ 5.56%	51,677,401
운전자금대출	국민은행 등	3.99% ~ 6.79%	46,334,306
채권유동화(*1)	한국산업은행	4.93% ~ 5.02%	57,500,000
채권유동화(*2)	한국산업은행 등	5.53% ~ 6.49%	29,660,000
소계			185,171,707
차감: 현재가치할인차금			(1,244,135)
차감: 유동성 대체액			(46,017,096)
합계			137,910,476

(*1) 당사는 삼성전자(주), SK하이닉스(주)로부터 발생하는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하였습니다(주석 26 참조).

(*2) 당사는 삼성전자(주), SK하이닉스(주)로부터 발생하는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하고, 그에 따라 취득한 수익권에 대하여 한국산업은행, 전북은행 및 하나마이크론제삼차 주식회사를 제1종 수익자로 지정하는 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 하나머티리얼즈(주)는 하나마이크론제삼차 주식회사를 위해 188억원의 자금보충의무 및 조건부채무인수의무를 부담하고 있습니다(주석 26 참조).

(3) 차입금 관련 담보제공 및 지급보증 내역

1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 차입금과 관련된 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 천원)			
담보권자	담보설정액	담보제공자산	관련 차입액
한국산업은행	196,998,346	토지, 건물, 기계장치 등	105,268,054
신한은행	35,427,600		38,080,100
농협은행	12,000,000	건물, 투자부동산	10,000,000
국민은행	29,211,000	기계장치	24,342,500
기업은행	24,999,960	건물, 기계장치	20,833,300
한국수출입은행	22,750,000	재고자산	17,500,000

(*) 당분기말 현재 당사는 차입금 등에 대하여 보유 중인 토지 48,018,883천원, 건물 21,774,468천원, 투자부동산 50,380,234천원, 기계장치 171,201,387천원, 재고자산 33,606,930천원을 담보로 제공하고 있습니다.

② 전기말

(단위: 천원)			
----------	--	--	--

담보권자	담보설정액	담보제공자산	관련 차입액
한국산업은행	197,107,755	토지, 건물, 기계장치 등	106,618,054
신한은행	35,025,800		39,648,550
농협은행	12,000,000	건물, 투자부동산	10,000,000
국민은행	36,479,503	기계장치	30,399,586
기업은행	27,499,956	건물, 기계장치	22,916,630
한국수출입은행	22,750,000	재고자산	-

(*) 전기말 현재 당사는 차입금 등에 대하여 보유 중인 토지 44,987,333천원, 건물 17,430,992천원, 투자부동산 57,959,108천원, 기계장치 177,601,798천원, 재고자산 24,544,192천원을 담보로 제공하고 있습니다.

2) 당분기말과 전기말 현재 차입금과 관련하여 타인으로부터 제공받은 지급보증 및 자금보충의 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)			
구분	제공자	지급보증액	지급보증처
지급보증	최대주주	86,266,332	하나은행 등
		USD 13,680,000	
	한국무역보험공사	1,800,000	하나은행
	신용보증기금	4,500,000	신한은행
자금보충	하나머티리얼즈(주)	20,000,000	스마트파이낸싱제철차 주식회사
		17,200,000	하나마이크론제삼차 주식회사

② 전기말

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)			
구분	제공자	지급보증액	지급보증처
지급보증	최대주주	86,716,472	하나은행 등
		USD 15,000,000	
	한국무역보험공사	1,800,000	하나은행
	신용보증기금	4,500,000	신한은행
자금보충	하나머티리얼즈(주)	20,000,000	스마트파이낸싱제철차 주식회사
		18,760,000	하나마이크론제삼차 주식회사

3) 당분기말 현재 대신증권 등에 대한 차입금과 관련하여 당사가 보유 중인 종속기업 하나머티리얼즈(주)의 주식 4,507,981주(전기말: 4,152,383주)를 담보로 제공하고 있습니다.

4) 당분기말 현재 당사의 삼평동 소재 토지 및 건물은 임대보증금과 관련하여 270백만원(전기말: 428백만원)의 전세권이 설정되어 있습니다.

14. 사채

(1) 당분기말과 전기말 현재 당사가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

구분	제 10 회 사모사채	제 11 회 사모사채	제 13 회 사모사채
사채의 종류	제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 사채	제11회차 무보증 사모 사채	제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 사채
사채의 권면총액	25,000,000,000원	50,000,000,000원	45,000,000,000원
사채이율	표면이자율 : 3.12%, 만기이자율 : 3.12%	표면이자율 : 6.5%, 만기이자율 : 6.5%	표면이자율 : 4.51%, 만기이자율 : 4.51%
사채납입일	2021년 11월 29일	2022년 8월 9일	2024년 3월 28일
사채만기일	2024년 11월 29일	2024년 8월 9일	2027년 3월 28일
원금상환방법	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 11월 29일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.	원금은 만기에 일시 상환한다(2024년 8월 9일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.	원금은 만기에 일시 상환한다(2027년 3월 28일). 다만, 원금상환기일이 대한민국 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 상환기일로 한다.
조기상환청구권(Put Option)	없음	없음	없음
조기상환권(Call Option)	사채의 발행일로부터 6개월이 경과한 날로부터 매 영업일	없음	사채의 발행일로부터 6개월이 경과한 날로부터 매 영업일

2) 전기말

구분	제 9 회 사모사채	제 10 회 사모사채	제 11 회 사모사채
사채의 종류	제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 사채	제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 사채	제11회차 무보증 사모 사채
사채의 권면총액	45,000,000,000원	25,000,000,000원	50,000,000,000원
사채이율	표면이자율 : 2.256%, 만기이자율 : 2.256%	표면이자율 : 3.12%, 만기이자율 : 3.12%	표면이자율 : 6.5%, 만기이자율 : 6.5%
사채납입일	2021년 5월 27일	2021년 11월 29일	2022년 8월 9일
사채만기일	2024년 5월 27일	2024년 11월 29일	2024년 8월 9일
원금상환방법	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 5월 27일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 11월 29일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.	원금은 만기에 일시 상환한다(2024년 8월 9일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
조기상환청구권(Put Option)	없음	없음	없음
조기상환권(Call Option)	사채의 발행일로부터 6개월이 경과한 날로부터 매 영업일	사채의 발행일로부터 6개월이 경과한 날로부터 매 영업일	없음

당사가 제9회, 제10회, 제13회 무보증사모사채 발행 계약조건에 따라 매입한 후순위유동화증권은 유

동화회사가 근질권을 설정하고 있습니다(주석 7 참조).

(2) 당분기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
유동		
액면가액	75,000,000	120,000,000
사채할인발행차금	(146,165)	(256,615)
합계	74,853,835	119,743,385
비유동		
액면가액	45,000,000	-
사채할인발행차금	(109,781)	-
합계	44,890,219	-

15. 매입채무와 기타금융부채

당분기말과 전기말 현재 매입채무와 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
유동부채:		
매입채무	90,911,154	50,261,824
기타유동금융부채		
미지급금	31,809,034	29,169,786
미지급비용	4,334,198	4,389,986
임대보증금	452,000	697,520
미지급배당금	2,398,993	-
금융보증부채	5,106,767	5,474,589
소계	135,012,146	89,993,705
비유동부채:		
기타비유동금융부채		
장기미지급금	3,379,130	3,318,413
보증금	350,010	857,490
소계	3,729,140	4,175,903
합계	138,741,286	94,169,608

16. 퇴직급여제도

당분기말과 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 당사의 의무로 인하여 발생하는 재무

상태표 상 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	27,860,302	28,422,726
사외적립자산의 공정가치	(32,784,237)	(33,151,024)
순확정급여부채(자산)	(4,923,935)	(4,728,298)

17. 기타불입자본

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
주식발행초과금	263,071,198	220,783,984
기타자본잉여금(*1)(*2)	(5,451,176)	(5,451,176)
주식선택권	2,951,339	3,603,684
신종자본증권(*3)	4,808,751	47,993,625
합계	265,380,112	266,930,117

(*1) 종속기업인 하나머티리얼즈(주)가 소유하고 있는 당사의 주식 취득가액 중 당사가 보유하고 있는 지분을 만큼 차감된 금액이 포함되어 있습니다(주석 8 참조).

(*2) 전기 중 발행한 제12회 무보증 사모 영구 전환사채에 내재된 매도청구권 4,243백만원이 포함되어 있습니다(주석 6, 26 참조).

(*3) 당사는 전기 중 제12회 무보증 사모 영구 전환사채를 발행하였으며, 발행일 이후 일정기간이 경과한 시점부터 상환할 수 있습니다. 동 전환사채는 만기일에 동일한 조건으로 만기를 계속 연장할 수 있고, 이자의 전부 또는 일부의 지급을 제한없이 정지할 수 있으므로 자본으로 분류하였습니다. 한편, 당분기 중 영구 전환사채의 매도청구권 일부가 행사되었고, 영구 전환사채의 일부가 전환청구됨에 따라 보통주 4,062,321주가 발행되었으며, 당분기말 현재 신종자본증권 잔액은 4,809백만원 입니다(주석 24, 26 참조).

(2) 당분기말과 전기말 현재 자본으로 분류된 신종자본증권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)						
구분	발행일	만기일(*1)	액면이자율	만기수익률(*2)	당분기말	전기말
제12회 무보증 사모 영구 전환사채(*3)	2023-03-15	2053-03-15	0.00%	2.50%	4,809,390	48,000,000
차감: 발행비용					(639)	(6,375)
합계					4,808,751	47,993,625

(*1) 당사는 본 계약과 동일한 발행 조건으로 30년씩 계속하여 연장할 수 있으며, 발행일로부터 3년 후 매 3개월마다 중도상환 할 수 있습니다.

(*2) 만기수익률의 조정은 사채 발행 후 3년 경과 시 민간채권평가회사에서 제공하는 "당사 신용등급"에 해당하는 3년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균 이자율에 연 1.5%의 가산금리를 가산하여 정해지며, 이로부터 매 1년마다 직전 이자율에 연 1.0%의 가산금리를 가산하여 산정됩니다

(*3) 상기 제12회 무보증 사모 영구 전환사채는 제3자 지정가능한 매도청구권이 내재된 상품으로, 매도청구권은 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하였습니다. 한편, 당분기 중 제12회 무보증 사모 영구 전환사채의 전환청구권 43,191백만원이 행사되었으며, 당사는 동 거래로 인하여 당기손익-공정가치 측정 금융자산 거래손실 13,869백만원을 인식하였습니다.

18. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
이익준비금(*1)	1,711,073	1,471,175
미처분이익잉여금(*2)	41,437,130	63,885,237
합계	43,148,203	65,356,412

(*1) 상법 상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

(*2) 당사에 적용된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하여 상법 상의 규정에 따라 초과한 금액 범위 내에서 당사의 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 이입 할 수 있으며, 제21기 정기주주총회의 승인을 받아 당사의 자본준비금 500억원을 이익잉여금으로 이입하였습니다.

19. 기타자본구성요소

당분기말과 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(882,711)	(882,711)
지분법자본변동	8,233,084	3,929,537
토지재평가손익	13,746,358	13,746,358
합계	21,096,731	16,793,184

20. 주식선택권

(1) 주식선택권부여 내역

당분기말 현재 당사가 부여한 주식선택권의 주요 내역은 다음과 같습니다.

구분	이동철	김정제 외 12명	이승범 외 2명
권리부여일	2019년 3월 27일	2021년 3월 30일	2022년 3월 30일
잔여수량	80,000주	163,700주	70,000주
부여방법	보통주 신주발행교부	보통주 신주발행교부	보통주 신주발행교부
행사가격	3,526원	9,275원	18,860원

행사가능기간	2021.3.27 ~ 2026.3.27	2023.3.30 ~ 2028.3.30	2024.3.30 ~ 2029.3.30
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

(2) 보상원가 산정을 위한 제반가정 및 변수

당사는 주식선택권의 보상원가를 블랙·솔즈모형 및 이항모형을 이용한 공정가액접근법을 적용하여 산정하였으며, 주요 가정은 다음과 같습니다.

구분	2019년 3월 27일 부여	2021년 3월 30일 부여	2022년 3월 30일 부여
무위험이자율	1.76%	1.12%	2.91%
기대행사기간	2년	2년	2년
예상주가변동성	25.44%	64.29%	56.04%

(3) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 주식기준보상비용은 각각 92,478천원과 209,119천원입니다.

21. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채

21.1 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 당분기와 전분기 중 당사는 수익과 관련하여 포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기	전분기
고객과의 계약에서 생기는 수익	177,011,271	130,780,918
기타 원천으로부터의 수익	392,778	533,997
총 수익	177,404,049	131,314,915

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

당분기와 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기	전분기
수익인식 시점		
한 시점에 인식	127,988,301	65,934,037
기간에 걸쳐 인식	49,022,970	64,846,881
합계	177,011,271	130,780,918

21.2 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채

당분기말과 전기말 현재 고객과의 계약과 관련하여 인식한 자산과 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
계약자산	3,943,205	1,005,055
계약부채	-	-

22. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상가중평균 연간유효법인세율은 23.26%(2023년 3월 31일로 종료하는 중간기간에 대한 가중평균 연간유효법인세율: 23.69%)입니다.

23. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기	전분기
사용된 원재료 및 상품	140,205,347	95,148,485
종업원급여	11,234,971	12,615,480
감가상각비 및 사용권자산상각비	9,369,537	8,821,512
무형자산상각비	311,141	301,569
지급수수료	1,852,525	1,843,642
판매촉진비	244,495	169,643
수출제비용	42,940	88,780
기타	7,830,366	8,367,173
합계	171,091,322	127,356,284

24. 특수관계자와의 거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 주요 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	당분기말	전기말
종속기업	하나머티리얼즈(주), Hana Micron America Inc., Hana Latin America, Ltda., (주)이피웍스, (주)이노메이트, 하나마이크론태양광(주), Hana Micron Vietnam Co., Ltd., Hana Micron Vina Co., Ltd., HT Micron Semicondutores S.A., AniTrace Inc., 하나더블유엘에스(주), Hana Electronics Industria E Comercio Ltda., 하나에스앤비(주)(*1)	하나머티리얼즈(주), Hana Micron America Inc., Hana Latin America, Ltda., (주)이피웍스, (주)이노메이트, 하나마이크론태양광(주), Hana Micron Vietnam Co., Ltd., Hana Micron Vina Co., Ltd., HT Micron Semicondutores S.A., AniTrace Inc., 하나더블유엘에스(주), Hana Electronics Industria E Comercio Ltda., 하나에스앤비(주)(*1)
공동기업	Hana Innosys Latin America	Hana Innosys Latin America
기타	흥국-하나에스앤비 뉴프라이밍 신기술투자조합(*2), 하나에스앤비로보틱스1호 신기술조합(*3), 최대주주 등	(주)솔머티리얼즈, 최대주주 등

(*1) 전기 중 당사의 종속기업인 하나머티리얼즈(주)가 신규 출자하여 설립하였습니다.

(*2) 당분기 중 당사의 종속기업인 하나머티리얼즈(주)와 하나에스앤비(주)가 신규출자하여 설립하였습니다.

(*3) 당분기 중 당사의 종속기업인 하나에스앤비(주)가 신규출자하여 설립하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

구분	특수관계자의 명칭	당분기			전분기		
		매출 등	유형자산 등 처 분	매입 등	매출 등	유형자산 등 처 분	매입 등
종속기업	Hana Micron America Inc.(*2)	-	-	244,496	44,090	-	203,866
	하나머티리얼즈(주)(*2)	305,282	-	214,002	429,748	-	298,342
	하나마이크론태양광(주)	5,069	-	-	5,013	-	-
	Hana Micron Vietnam Co., Ltd.(*2)	3,534,659	171,454	-	2,370,056	-	22,849
	HT Micron Semicondutores S.A.(*1)(*2)	31,851,449	-	-	16,753,038	-	70,620
	Hana Micron Vina Co., Ltd.(*1)(*2)	85,769,847	936,279	-	39,932,532	1,175,117	84,607
	하나더블유엘에스(주)	771,026	-	-	533,064	-	-
	Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.(*1)	9,157,605	-	-	6,584,756	-	-
합계	131,394,937	1,107,733	458,498	66,652,297	1,175,117	680,284	

(*1) 당분기 중 Hana Micron Vina Co., Ltd. 등에 대한 장비 구매대행 관련하여 수수료를 제외한 금액 613백만원(전분기: 25,164백만원)은 "매출 등" 및 "유형자산 등 처분"에서 제외되어 있습니다.

(*2) 당분기 중 Hana Micron Vina Co., Ltd. 등에 대해 지급보증과 관련한 금융보증수익 508백만원(전분기: 378백만원)과 지급보증손실 276백만원(전분기: 378백만원)은 "매출 등" 및 "매입 등"에서 제외되어 있습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권·채무잔액은 다음과 같습니다.

구분	특수관계자의 명칭	매출채권		미수금 등(*3)		미지급금 등(*3)	
		당분기말	전기말	당분기말	전기말	당분기말	전기말
종속기업	Hana Micron America Inc.	-	-	-	-	245,653	141,291
	하나머티리얼즈(주)	35,840	12,157	30,912	28,569	843,053	1,036,351
	(주)이피웍스(*1)	-	-	895,892	895,892	-	-
	하나마이크론태양광(주)	-	-	12,366	7,297	-	-
	Hana Micron Vietnam Co., Ltd.	895,566	3,383,706	13,540,938	13,324,822	544,721	3,666
	HT Micron Semicondutores S.A.(*4)	24,008,154	12,369,234	18,822,345	15,977,988	-	-
	AniTrace INC.(*1)	553,888	530,282	-	-	-	-
	Hana Micron Vina Co., Ltd.(*4)	101,602,330	98,779,184	24,167,307	20,270,624	886,335	-
	Hana Latin America, Ltda.(*1)	1,485,600	1,422,284	-	-	-	-
	하나더블유엘에스(주)	351,692	178,481	207,605	100,530	5,847	-
	Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.	10,723,592	3,458,323	7,254,708	6,637,251	-	-
공동기업	Hana Innosys Latin America(*2)	7,894,134	7,557,690	403,715	400,251	-	-
합계	147,550,796	127,691,341	65,335,788	57,643,224	2,525,609	1,181,308	

(*1) 상기 채권은 손실충당금이 고려되지 않은 총액이며, 당분기말 현재 당사는 종속기업인 Hana

Latin America Ltda., (주)이피웍스, AniTrace INC.의 매출채권 및 미수금 등에 대하여 각각 1,486백만원(전기말: 1,422백만원), 896백만원(전기말: 896백만원), 554백만원(전기말: 530백만원)의 손실충당금을 설정하고 있습니다.

(*2) 공동기업인 Hana Innosys Latin America에 대한 매출채권과 미수금 등은 전기 이전에 전액 손실충당금을 설정하였습니다.

(*3) 대여금 및 차입금은 잔액은 제외되어 있으며, 대여금 및 차입금의 잔액 및 변동내역은 주석 24.(4)에 기재되어 있습니다.

(*4) 당분기말 현재 HT Micron Semicondutores S.A., Hana Micron Vina Co., Ltd에 대한 미수금 등에는 장비 구매대행과 관련하여 공급업체에 지급한 금액이 각각 248백만원(전기말: 300백만원), 1,153백만원(전기말: 1,577백만원)이 제외되어 있습니다.

(4) 당분기와 전분기 중 특수관계자 대여금 및 차입금의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)						
구분		기초	증가	감소	분기말	미반영지분법손실 반영누계액(*2)
대여금	(주)이피웍스(*1)	6,671,000	-	-	6,671,000	-
	HT Micron Semicondutores S.A.(*1)(*3)	USD 22,500,000	-	-	USD 22,500,000	-
	Hana Micron Vietnam Co., Ltd.(*1)(*3)	USD 7,460,000	-	-	USD 7,460,000	USD 260,741
	Hana Micron Vina Co., Ltd.(*3)	USD 26,000,000	-	-	USD 26,000,000	-
	Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.(*1)(*3)	USD 18,000,000	-	-	USD 18,000,000	USD 8,225,321
차입금	하나머티리얼즈(주)	21,000,000	-	-	21,000,000	-

(*1) 상기 대여금은 손실충당금이 고려되지 않은 총액이며, 당분기말 현재 당사는 종속기업인 (주)이피웍스, Hana Micron Vietnam Co., Ltd., HT Micron Semicondutores S.A., Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.의 대여금에 대하여 각각 6,671백만원, USD 2,534,136, USD 7,392,355, USD 6,083,894의 손실충당금을 설정하고 있습니다. 당분기 중 손실로 인식한 금액은 없습니다.

(*2) Hana Micron Vietnam Co., Ltd., Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.의 지분법 중지로 인하여 인식하지 못한 미반영 지분법손실 및 지분법자본변동을 순투자의 일부인 대여금에서 추가로 인식하고 있습니다. 당분기 중 미반영 지분법손실 및 지분법자본변동으로 변동한 대여금은 Hana Micron Vietnam Co., Ltd. 152백만원 및 (-)199백만원, Hana Electronics Industria E Comercio Ltda. 1,498백만원 및 (-)840백만원입니다.

(*3) 상기 대여금은 현재가치할인차금이 고려되지 않은 총액이며, 당분기말 현재 당사는 종속기업인 HT Micron semicondutores S.A., Hana Micron Vietnam Co., Ltd., Hana Micron Vina Co., Ltd., Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.의 대여금에 대하여 각각 1,545백만원, 213백만원, 776백만원, 837백만원의 현재가치할인차금을 설정하고 있습니다.

2) 전분기

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)						
구분		기초	증가	감소	분기말	미반영지분법손실 반영누계액(*2)
대여금	(주)이피웍스(*1)	6,671,000	-	-	6,671,000	-
	HT Micron Semicondutores S.A.(*1)	USD 22,500,000	-	-	USD 22,500,000	-

	Hana Micron Vietnam Co., Ltd.(*1)	USD 7,460,000	-	-	USD 7,460,000	USD 316,068
	Hana Micron Vina Co., Ltd.	USD 35,000,000	USD 39,000,000	-	USD 74,000,000	-
	Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.	USD 3,000,000	USD 15,000,000	-	USD 18,000,000	USD 4,097,873
차입금	하나머티리얼즈(주)	21,000,000	-	-	21,000,000	-

(*1) 상기 대여금은 손실충당금 등이 고려되지 않은 총액이며, 전분기말 현재 당사는 종속기업인 (주)이피웍스, Hana Micron Vietnam Co., Ltd., HT Micron Semicondutores S.A.의 대여금에 대하여 각각 6,671백만원, USD 1,430,069, USD 6,028,178의 손실충당금을 설정하고 있습니다. 전분기 중 손실로 인식한 금액은 없습니다.

(*2) Hana Micron Vietnam Co., Ltd., Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.의 지분법 중지로 인하여 인식하지 못한 미반영 지분법손실 및 지분법자본변동을 순투자의 일부인 대여금에서 추가로 인식하고 있습니다. 전분기 중 미반영 지분법손실 및 지분법자본변동으로 변동한 대여금은 Hana Micron Vietnam Co., Ltd. 2,111백만원 및 (-)20백만원, Hana Electronics Industria E Comercio Ltda. (-)1,541백만원 및 영(0)원입니다.

(5) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)			
제공자	지급보증금액	지급보증내역	지급보증처
하나머티리얼즈(주)	20,000,000	차입금 자금보충약정	스마트파이낸싱제철차 주식회사
	17,200,000	차입금 자금보충약정	하나마이크론제삼차 주식회사
최대주주	86,266,332	차입금 지급보증	하나은행 등
	USD 13,680,000	외화지급보증	

2) 전기말

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)			
제공자	지급보증금액	지급보증내역	지급보증처
하나머티리얼즈(주)	20,000,000	차입금 자금보충약정	스마트파이낸싱제철차 주식회사
	18,760,000	차입금 자금보충약정	하나마이크론제삼차 주식회사
최대주주	86,716,472	차입금 지급보증	하나은행 등
	USD 15,000,000	외화지급보증	

(6) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(외화단위: USD, BRL)			
구분	지급보증금액	지급보증내역	지급보증처
Hana Micron America Inc.	USD 3,000,000	Stand by LC 지급보증	하나은행
HT Micron Semicondutores S.A.	USD 6,000,000	Corporate Guarantee	CITI BANK
	USD 2,925,000	Corporate Guarantee	CITI BANK

	BRL 99,000,000	Corporate Guarantee	BNDES
Hana Micron Vina Co., Ltd.	USD 12,000,000	Corporate Guarantee	CITI BANK
	USD 200,000,000	Corporate Guarantee	CITIBANK N.A. 등(*1)
	USD 210,000,000	Corporate Guarantee	한국산업은행 등(*2)
Hana Micron Vietnam Co., Ltd.	USD 6,000,000	Corporate Guarantee	Shinhan Vietnam

(*1) 당사는 SK하이닉스(주)와 사업협력계약을 체결하였으며, 동 사업협력계약 이행을 위해 Hana Micron Vina Co., Ltd.가 Citibank N.A. 등과 체결한 차입 계약에 따라 하나머티리얼즈(주)와 당사는 Hana Micron Vina Co., Ltd.에게 USD 200,000,000의 공동 연대보증을 제공하였습니다(주석 26 참조). 또한 당사는 하나머티리얼즈(주)가 제공한 채무보증의 실행력을 담보하기 위한 후속적 보완 조치의 건으로 당사가 보유하고 있던 하나머티리얼즈(주)의 보통주 987,633주 및 성남시 삼평동 소재의 토지, 건물 및 투자부동산(장부금액: 31,530백만원)을 하나머티리얼즈(주)에게 담보로 제공하였습니다(주석 26 참조).

(*2) 당사는 동 사업협력계약 이행을 위해 2023년 11월 24일 이사회 결의를 통하여 Hana Micron Vina Co., Ltd.가 한국산업은행 및 한국수출입은행과 체결한 차입 계약에 대한 USD 210,000,000의 채무보증을 제공하기로 결의하였습니다(주석 26 참조).

2) 전기말

(외화단위: USD)			
구분	지급보증금액	지급보증내역	지급보증처
Hana Micron America Inc.	USD 3,000,000	Stand by LC 지급보증	하나은행
HT Micron Semicondutores S.A.	USD 3,000,000	Stand by LC 지급보증	한국산업은행
	USD 6,000,000	Corporate Guarantee	CITI BANK
	USD 2,925,000	Corporate Guarantee	CITI BANK
	BRL 99,000,000	Corporate Guarantee	BNDES
Hana Micron Vina Co., Ltd.	USD 12,000,000	Corporate Guarantee	CITI BANK
	USD 200,000,000	Corporate Guarantee	CITIBANK N.A. 등(*1)
	USD 210,000,000	Corporate Guarantee	한국산업은행 등(*2)
Hana Micron Vietnam Co., Ltd.	USD 6,000,000	Corporate Guarantee	Shinhan Vietnam

(*1) 당사는 SK하이닉스(주)와 사업협력계약을 체결하였으며, 동 사업협력계약 이행을 위해 Hana Micron Vina Co., Ltd.가 Citibank N.A. 등과 체결한 차입 계약에 따라 하나머티리얼즈(주)와 당사는 Hana Micron Vina Co., Ltd.에게 USD 200,000,000의 공동 연대보증을 제공하였습니다(주석 26 참조). 또한 당사는 하나머티리얼즈(주)가 제공한 채무보증의 실행력을 담보하기 위한 후속적 보완 조치의 건으로 당사가 보유하고 있던 하나머티리얼즈(주)의 보통주 987,633주 및 성남시 삼평동 소재의 토지, 건물 및 투자부동산(장부금액: 31,569백만원)을 하나머티리얼즈(주)에게 담보로 제공하였습니다(주석 26 참조).

(*2) 당사는 동 사업협력계약 이행을 위해 2023년 11월 24일 이사회 결의를 통하여 Hana Micron Vina Co., Ltd.가 한국산업은행 및 한국수출입은행과 체결한 차입 계약에 대한 USD 210,000,000의 채무보증을 제공하기로 결의하였습니다(주석 26 참조).

(7) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다(주석 8 참조).

(단위: 천원)

구분	특수관계자 유형	특수관계자 명칭	거래내역	당분기	전분기
출자	종속기업	Hana Electronics Industria E Comercio Ltda.	현금출자	-	3,923,400
출자	종속기업	Hana Micron Vietnam Co., Ltd.	현금출자	-	2,639,000
출자(*1)	기타	최대주주 등	전환권행사	8,150,610	-

(*1) 당분기 중 제12회 무보증 사모 영구 전환사채의 제3자 지정 가능 매도청구권을 행사하여 최대주주 등은 전환사채 8,151백만원을 인수하였으며, 이후 전환권을 행사하여 당사의 보통주 766,610주(전환가액 10,632원)를 취득하였습니다. 당사는 상기 매도청구권 행사로 인하여 당기손익-공정가치 측정 금융자산 거래손실 13,869백만원을 인식하였습니다(주석 17 참조).

(8) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 등기이사 및 감사를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요경영진에게 지급됐거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기	전분기
급여 및 상여	318,651	239,861
퇴직급여	42,929	29,560
주식보상비용	-	10,052
합계	361,580	279,473

25. 현금흐름

당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기	전분기
1. 분기순손실	(19,902,592)	(4,463,118)
2. 조정	39,871,900	18,983,931
(1) 비용의 가산	56,599,491	31,841,283
퇴직급여	921,580	894,236
주식보상비용	92,478	209,119
감가상각비 및 사용권자산상각비	9,369,537	8,821,512
무형자산상각비	311,141	301,569
기타의대손상각비	-	22,501
외화환산손실	760,369	1,418,161
지분법손실	19,062,134	13,694,394
이자비용	7,819,163	6,097,446
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	1,838,384	-
당기손익-공정가치 측정 금융자산 거래손실	13,858,692	-

상각후원가 측정 금융자산 손상차손	810,000	-
통화선도평가손실	1,471,852	-
금융보증손실	275,540	377,513
사채상환손실	8,619	-
기타	2	4,832
(2) 수익의 차감	(16,727,591)	(12,857,347)
외화환산이익	4,916,311	4,296,306
유형자산처분이익	118,512	43,212
이자수익	3,217,852	2,191,896
지분법이익	1,796,447	4,529,851
기타의대손상각비환입	-	6,244
금융상품평가이익	-	2,643
금융보증수익	507,632	377,513
법인세수익	6,011,142	1,409,682
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	158,837	-
대손충당금환입	858	5
3. 순운전자본의 변동	9,033,262	(25,038,555)
매출채권의 (증가)감소	(16,886,401)	9,152,822
기타유동금융자산의 증가	(2,085,453)	(17,155,912)
기타자산의 (증가)감소	(173,651)	2,853,023
재고자산의 (증가)감소	(10,920,564)	7,842,665
계약자산의 증가	(2,938,368)	(17,133)
매입채무의 증가(감소)	40,134,773	(3,351,236)
기타유동금융부채의 증가(감소)	2,810,807	(24,260,625)
기타비유동금융부채의 증가	60,718	82,875
기타부채의 증가(감소)	30,571	(126,895)
퇴직금의 지급	(1,860,808)	(451,981)
사외적립자산의 증가	861,638	393,842
영업으로부터 창출된 현금흐름	29,002,570	(10,517,742)

26. 우발채무와 약정사항

(1) 당사는 삼성전자(주) 등과 제품의 공급과 관련된 거래기본계약 및 외주단가계약을 체결하고 있습니다.

(2) 2021년 11월 12일 당사의 종속기업인 Hana Micron Vina Co., Ltd.(이하 'Vina')는 SK하이닉스(주)(이하 'SKH')와 반도체 후공정 위탁 관련 외주임가공계약을 체결하였으며, 동 계약의 이행 보증을 위하여 당사는 SKH와 사업협력계약(이하 '본 계약')을 체결하였습니다. 본 계약에 포함되어 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

1) 자금조달 이행 의무

당사는 Vina로 하여금 본 계약 체결일로부터 180일 이내에 금융기관과 3천억원 이상의 1차 대출계약을 체결하고, 1차 대출계약일로부터 1년 이내 1차 대출계약 상 대출금액과 합계액이 4천억원 이상이 되도록 2차 대출계약을 체결하도록 하여야 합니다. 만약 기한 내 대출계약이 체결되지 않을 경우 해당 기한의 말일로부터 3개월 이내에 Vina로 하여금 2천 5백억원 규모의 유상증자를 결의하도록 하고, 이에 따라 발행되는 Vina 주식을 당사가 전량 인수하기로 하였습니다.

2) 이행보증 의무

당사는 SKH와 Vina가 체결한 외주임가공계약과 관련하여, SKH에 대하여 Vina가 부담하는 계약상의 무 일체의 이행을 보증하고, 의무 불이행으로 인하여 Vina가 SKH에 부담해야 하는 손해배상채무 등 일체의 의무 이행을 1조원(외주임가공계약: 6천억원, 장비임대차계약: 4천억원)을 한도로 연대하여 보증해야 합니다.

3) 주식의 양도제한 등

당사는 본 계약의 계약기간 중, SKH의 사전 서면 동의 없이는 Vina의 주식 또는 신주인수권의 전부 또는 일부를 경쟁회사 및 경쟁회사의 계열회사 또는 특수관계인(이하 '금지된 양수인')에게 양도(담보의 제공, 제한 부담의 설정, 기타 처분행위를 모두 포함)하거나, 금지된 양수인 이외의 제3자에게 당사가 소유한 Vina의 경영권을 상실하게 되는 결과를 초래하도록 보유주식을 양도할 수 없습니다. 또한, 당사는 경영권을 상실하지 아니하는 범위의 보유주식 일부를 금지된 양수인 이외의 제3자에게 양도하고자 하는 경우, SKH에게 우선적으로 해당 주식을 매수할 수 있는 권리를 부여하여야 합니다.

(3) 당사는 2023년 11월 24일 이사회 결의를 통하여 Hana Micron Vina Co., Ltd.에게 USD 210,000,000의 채무보증 제공을 결의하였습니다. 본 채무보증은 당사가 SK하이닉스(주)와 체결한 사업협력계약 이행을 위해 Hana Micron Vina Co., Ltd.가 한국산업은행 및 한국수출입은행과 체결한 차입 계약에 따라 실행 예정인 시설자금 차입금 관련하여 보증을 제공하여 신용을 보강하는 건입니다. 채무보증기간은 2023년 12월 5일로부터 4.5년으로, 당분기말 현재 차입 실행 잔액은 USD 80,000,000 입니다.

또한, 동 사업협력계약 이행을 위해 Hana Micron Vina Co., Ltd.가 Citibank N.A. 등과 2022년 11월 28일 체결한 차입 계약에 따라 하나머티리얼즈(주)와 하나마이크론(주)는 2023년 6월 28일 이사회 결의를 통하여 Hana Micron Vina Co., Ltd.에게 USD 200,000,000의 공동 연대보증을 제공하였습니다. 채무보증기간은 2023년 6월 29일부터 2029년 11월 28일까지로, 당분기말 현재 차입 실행 잔액은 USD 118,000,000입니다.

(4) 당분기말 현재 당사는 인허가 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 177백만원(전기말: 177백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(5) 당분기말과 전기말 현재 기타 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)					
약정내용	금융기관명	약정한도			
		당분기말		전기말	
		외화금액(USD)	원화금액	외화금액(USD)	원화금액

운전자금대출	한국산업은행 등	-	197,343,887	-	197,034,306
무역금융대출	신한은행 등	-	52,500,000	-	52,500,000
시설자금대출	신한은행 등	-	47,085,621	-	51,677,401
외화자금보증	신한은행 등	7,000,000	-	10,000,000	-
채권유동화	한국산업은행(*1)	-	56,800,000	-	57,500,000
채권유동화	하나마이크론제삼차 주식회사(*2)	-	27,200,000	-	29,660,000
사모사채	메리츠증권 등	-	120,000,000	-	120,000,000
전자외상매출채권담보대출	하나은행	-	40,010	-	40,010
선물환	신한은행 등	9,400,000	-	2,500,000	-
합계		16,400,000	500,969,518	12,500,000	508,411,717

(*1) 당사는 삼성전자(주), SK하이닉스(주)로부터 발생하는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하였습니다(주석 13 참조).

(*2) 당사는 삼성전자(주), SK하이닉스(주)으로부터 발생하는 채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 신탁원본으로 하여 한국산업은행과 신탁계약을 체결하고, 그에 따라 취득한 수익권에 대하여 한국산업은행, 전북은행 및 하나마이크론제삼차 주식회사를 제1종 수익자로 지정하는 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 하나머티리얼즈(주)는 하나마이크론제삼차 주식회사를 위해 172억원의 자금보충 의무 및 조건부채무인수 의무를 부담하고 있습니다(주석 13 참조).

(6) 당사는 종속기업인 하나더블유엘에스(주)가 발행한 전환우선주의 인수인과 주주간 계약을 체결하였으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	풋옵션1(*1)	풋옵션2	콜옵션
권리자	인수인	인수인	당사
의무자	당사	당사	인수인
행사사유	기한내 IPO 미달성 목표실적 미달 환경인허가 미취득	IPO 고의지연 미이행 주요계약사항 위반	IPO 공모가 기준 Refixing 후 투자자 보유지분 50% 이상
행사대상	투자자 주식 전부	투자자 주식 전부 또는 일부	투자자지분 50% -1주가 되는 주식수
행사기간	IPO기한 만료 후 6개월 내	행사사유 인지 후 6개월 내	IPO 공모가 기준 Refixing 후 1개월 이내
행사가액	신주 발행가액에 연복리 5%	신주 발행가액에 연복리 9%	신주 발행가액에 연복리 7% 적용

(*1) 당사는 주주간 계약에 따른 파생상품 공정가치 19,451백만원(전기말: 19,451백만원)을 당기손익-공정가치 측정 금융부채로 인식하였습니다.

(7) 당사가 제9회, 제10회, 제13회 무보증사모사채 발행 계약조건에 따라 매입한 후순위 유동화증권 1,860백만원에 대하여 유동화회사가 근질권을 설정하고 있습니다(주석 14 참조).

(8) 당분기말과 전기말 현재 당사가 피고로 계류된 소송사건은 없습니다.

(9) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증 내역은 주석 24 (6)에 기재되어 있습니다.

(10) 당사는 전분기 중 신종자본증권을 발행하였으며, 관련 약정의 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용
사채의 명칭	제12회 무보증 영구 전환사채
사채의 발행금액	48,000,000,000원

사채의 만기	2053년 3월 15일(30년), 단, 발행회사 재량에 따라 동일한 조건으로 만기연장 가능
표면이율	0.00%
만기보장수익률	만기보장수익률은 연 2.5%(연 복리로 계산)임. 본 사채 발행 후 3년이 되는 날에 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 "발행회사의 등급" 3년 만기 무보증 공모 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균에 연 1.00%의 가산금리를 가산하여 산정됨. 이후 매 1년째 되는 날마다 직전 이자율에 연 1.00%의 가산금리를 가산하여 산정됨
중도상환권	사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없음. 발행회사는 발행일로부터 36개월이 되는 날(2026년 3월 15일) 및 이후 매 3개월마다 본 사채 전부에 대하여 중도상환 할 수 있음
전환조건	10,632원/주
전환청구기간	본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2024년 3월 15일)부터 만기일 1개월 전(만기 비연장시 2053년 2월 15일)까지로 함
매도청구권	발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 날(2024년 3월 15일)부터 36 개월이 되는 날의 직전일(2026년 3월 14일)까지 매 3개월이 되는 날에 발행가액의 27% 내에서 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있음

당사는 상기 신증자본증권에 대하여 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않으므로 자본으로 분류하였으며, 제3자 지정 가능 매도청구권을 별도로 분리하여 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 인식하였습니다(주석 6, 17 참조).

한편, 당분기 중 전환사채의 매도청구권 일부가 행사되었고, 전환사채의 일부가 전환청구됨에 따라 보통주 4,062,321주가 발행되었으며, 당분기말 현재 신증자본증권 잔액은 4,809백만원 입니다(주석 17 참조).

27. 금융위험관리

(1) 자본위험관리

당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.

당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

당사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 당분기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
부채	673,865,092	610,131,140
자본	355,693,283	373,069,640
부채비율	189.45%	163.54%

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)					
구분	상각후원가측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정금융자산	기타포괄손익-공정 가치측정금융자산	합계	공정가치
현금및현금성자산	53,870,397	-	-	53,870,397	(*1)
매출채권	153,408,625	-	-	153,408,625	(*1)
기타유동금융자산	37,411,391	-	-	37,411,391	(*1)
기타비유동금융자산	93,696,876	-	-	93,696,876	(*1)
장기금융상품	319,173	-	-	319,173	(*1)
공정가치측정금융자산	-	13,370,009	1,111,743	14,481,752	14,481,752
합계	338,706,462	13,370,009	1,111,743	353,188,214	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.

2) 전기말

(단위: 천원)					
구분	상각후원가측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정금융자산	기타포괄손익-공정 가치측정금융자산	합계	공정가치
현금및현금성자산	17,507,687	-	-	17,507,687	(*1)
매출채권	134,124,659	-	-	134,124,659	(*1)
기타유동금융자산	30,281,588	-	-	30,281,588	(*1)
기타비유동금융자산	92,238,437	-	-	92,238,437	(*1)
장기금융상품	308,986	-	-	308,986	(*1)
공정가치측정금융자산	-	29,196,150	1,111,743	30,307,893	30,307,893
합계	274,461,357	29,196,150	1,111,743	304,769,250	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 천원)					
구분	상각후원가측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정금융부채	기타	합계	공정가치
매입채무	90,911,154	-	-	90,911,154	(*1)
기타유동금융부채	38,994,225	-	-	38,994,225	(*1)
단기차입금	208,200,000	-	-	208,200,000	(*1)
유동성장기차입금	43,124,978	-	-	43,124,978	(*1)
유동성사채	74,853,835	-	-	74,853,835	(*1)
장기차입금(*3)	128,515,966	-	-	128,515,966	127,219,552
사채(*3)	44,890,219	-	-	44,890,219	44,372,121
리스부채(*2)	-	-	1,075,839	1,075,839	(*1)
금융보증부채	-	-	5,106,767	5,106,767	(*1)
기타비유동금융부채	3,729,140	-	-	3,729,140	(*1)
당기손익-공정가치측정금융부 채	-	20,922,697	-	20,922,697	20,922,697
합계	633,219,517	20,922,697	6,182,606	660,324,820	

- (*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.
- (*2) 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 리스부채입니다.
- (*3) 수준 3으로 분류되며, 공정가치는 신용위험을 감안한 할인율을 고려한 현금흐름할인모형으로 계산되었습니다.

2) 전기말

(단위: 천원)					
구분	상각후원가측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정금융부채	기타	합계	공정가치
매입채무	50,261,824	-	-	50,261,824	(*1)
기타유동금융부채	34,257,292	-	-	34,257,292	(*1)
단기차입금	176,700,000	-	-	176,700,000	(*1)
유동성장기차입금	46,017,096	-	-	46,017,096	(*1)
유동성사채	119,743,385	-	-	119,743,385	(*1)
장기차입금(*3)	137,910,476	-	-	137,910,476	136,086,821
리스부채(*2)	-	-	1,202,688	1,202,688	(*1)
금융보증부채	-	-	5,474,589	5,474,589	(*1)
기타비유동금융부채	4,175,903	-	-	4,175,903	(*1)
당기손익-공정가치측정금융부 채	-	19,450,846	-	19,450,846	19,450,846
합계	569,065,976	19,450,846	6,677,277	595,194,099	

- (*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시 대상에서 제외하였습니다.
- (*2) 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 리스부채입니다.
- (*3) 수준 3으로 분류되며, 공정가치는 신용위험을 감안한 할인율을 고려한 현금흐름할인모형으로 계산되었습니다.

(4) 금융위험관리

1) 금융위험관리목적

당사의 재무부서는 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(외환위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험을 포함하고 있습니다.

요약분기재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2023년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 한편, 당사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

2) 시장위험

① 외환위험관리

당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율

변동으로 인한 위험의 노출정도는 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다.

② 이자율위험관리

당사의 이자율위험은 주로 변동이자부 차입금에 연관되어 있으며, 이와 관련된 이자비용은 이자율위험에 노출되어 있습니다. 고정이자율이 적용되는 차입금의 경우 이자율변동에 따른 당기손익이나 자본에 미치는 영향은 없습니다.

당분기말 현재 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우 연간 이자비용은 2,402백만원(전기말: 2,305백만원) 만큼 증가 또는 감소합니다.

③ 기타 가격위험요소

당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 당사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다.

3) 신용위험관리

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 당사는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 당사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 당사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며, 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신용위험은 매년 검토되고 승인된 거래한도에 의하여 통제됩니다.

매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
금융보증계약(*1)	619,075,460	597,414,765

(*1) 금융보증계약과 관련된 당사의 최대노출정도는 지급보증한도금액으로 신용위험발생시 당사가 지급해야 될 최대 금액입니다.

한편, 당사는 신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다.

4) 유동성위험관리

유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.

(5) 금융상품의 공정가치

1) 경영진은 장기차입금과 사채를 제외한 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산과 금융부채의 장부금액을 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

2) 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격으로, 해당 공시가격에는 금리 상승 및 인플레이션, ESG관련 위험 등의 경제환경 변화에 대한 시장의 가정이 반영되어 있음 (수준 1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)
- 비상장 지분증권과 ESG관련 위험으로 인해 유의적인 관측불가능한 조정이 반영되는 금융상품과 같이, 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

① 다음 표는 최초 인식 후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.

가. 당분기말

(단위: 천원)				
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	13,370,009	13,370,009
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	1,111,743	1,111,743
당기손익-공정가치 측정 금융부채	-	1,471,851	19,450,846	20,922,697

나. 전기말

(단위: 천원)				
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	29,196,150	29,196,150
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	1,111,743	1,111,743
당기손익-공정가치 측정 금융부채	-	-	19,450,846	19,450,846

당분기와 전분기 중 수준 1과 수준 2 간의 대체는 없습니다.

② 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당분기와 전분기 중 변동 내용은 다음과 같습니다

가. 당분기

(단위: 천원)					
구분	기초	취득	처분	평가손익	분기말
당기손익-공정가치 측정 금융자산	29,196,150	-	(14,146,594)	(1,679,547)	13,370,009
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,111,743	-	-	-	1,111,743
당기손익-공정가치 측정 금융부채	19,450,846	-	-	-	19,450,846

나. 전분기

(단위: 천원)					
구분	기초	취득	처분	평가손익	분기말
당기손익-공정가치 측정 금융자산	615,731	4,242,504	-	-	4,858,235
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,082,512	-	-	-	1,082,512
당기손익-공정가치 측정 금융부채	11,545,932	-	-	-	11,545,932

3) 당분기말 현재 당사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)				
구분	당분기말			
	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수
당기손익-공정가치 측정 금융자산	257,079	3	순자산접근법	기초자산 가격
	300,436	3	(*1)	-
	2,000,309	3	(*2)	-
	2,634,633	3	현금흐름할인법	할인율
	8,177,552	3	옵션가격결정모형	주가 변동성
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,011,743	3	현금흐름할인법	가중평균자본비용
	100,000	3	(*3)	-
당기손익-공정가치 측정 금융부채	19,450,846	3	옵션가격결정모형	무위험할인율, 유사기업변동성
	1,471,851	2	현금흐름할인법	환율, 할인율

(*1) 해당 상환전환우선주의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우로서 취득원가를 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하였습니다.

(*2) 전기 중 취득한 전환우선주로, 취득원가를 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하였습니다.

(*3) 해당 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우로서 취득원가를 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하였습니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다.

배당가능이익 범위 내에서 성장을 위한 투자, 주주가치 제고 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있으며, 향후에도 미래 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며, 자사주 매입 및 소각 계획 등은 현재 고려하고 있지 않습니다.

- 당사 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제57조(이익배당)	
①	이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
②	이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③	제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④	이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 주요 배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제24기 1분기	제23기	제22기
주당액면가액(원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-16,856	-13,514	2,830
(별도)당기순이익(백만원)		-19,903	-42,987	16,538
(연결)주당순이익(원)		-411	-313	66
현금배당금총액(백만원)		-	2,399	2,396
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	84.66
현금배당수익률(%)	보통주	-	0.17	0.49
	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	50
	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	-	-	-	-

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
-	2	0.22	0.31

주1) 당사는 제22기 부터 제23기 까지 2회 연속 결산배당을 진행하였습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2001.08.23	-	보통주	100,000	5,000	5,000	설립
2002.06.01	-	보통주	170,000	5,000	5,000	구주주및제3자배정
2002.09.17	유상증자(일반공모)	보통주	60,000	5,000	55,000	-
2002.12.23	무상증자	보통주	270,000	5,000	-	-
2003.06.10	-	보통주	30,000	5,000	-	합병
2004.01.09	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	15,000	-
2004.02.05	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	5,000	50,000	-
2005.03.18	주식분할	보통주	7,700,000	500	-	액면분할
2005.04.08	유상증자(제3자배정)	보통주	800,000	500	7,500	-
2005.10.08	유상증자(제3자배정)	보통주	2,125,000	500	7,600	-
2006.12.01	주식매수선택권행사	보통주	55,000	500	3,000	-
2009.11.09	무상증자	보통주	3,204,000	500	-	-
2010.07.28	신주인수권행사	보통주	1,541,306	500	3,244	BW행사
2010.12.15	신주인수권행사	보통주	961,538	500	5,200	BW행사
2010.12.22	신주인수권행사	보통주	134,615	500	5,200	BW행사
2010.12.27	신주인수권행사	보통주	57,692	500	5,200	BW행사
2011.03.04	신주인수권행사	보통주	480,769	500	5,200	BW행사
2011.04.11	신주인수권행사	보통주	96,153	500	5,200	BW행사
2011.05.04	신주인수권행사	보통주	57,692	500	5,200	BW행사
2011.06.02	신주인수권행사	보통주	134,615	500	5,200	BW행사

2011.07.09	유상증자(제3자배정)	보통주	3,455,160	500	13,024	제3자배정
2012.05.25	신주인수권행사	보통주	783,453	500	3,191	BW행사
2012.06.28	신주인수권행사	보통주	783,453	500	3,191	BW행사
2018.01.31	전환권행사	보통주	40,758	500	4,907	제7회차 CB
2018.03.06	전환권행사	보통주	30,568	500	4,907	제7회차 CB
2018.03.13	전환권행사	보통주	285,306	500	4,907	제7회차 CB
2019.03.21	전환권행사	보통주	329,207	500	4,040	제7회차 CB
2019.03.22	전환권행사	보통주	346,534	500	4,040	제7회차 CB
2019.04.25	전환권행사	보통주	827,965	500	4,040	제7회차 CB
2019.05.02	전환권행사	보통주	490,098	500	4,040	제7회차 CB
2019.05.09	전환권행사	보통주	519,801	500	4,040	제7회차 CB
2019.06.12	전환권행사	보통주	129,949	500	4,040	제7회차 CB
2019.10.28	전환권행사	보통주	393,564	500	4,040	제7회차 CB
2019.11.04	전환권행사	보통주	34,653	500	4,040	제7회차 CB
2019.11.12	전환권행사	보통주	1,856,435	500	4,040	제7회차 CB
2019.12.26	전환권행사	보통주	12,376	500	4,040	제7회차 CB
2019.12.20	전환권행사	보통주	7,425	500	4,040	제7회차 CB
2020.01.16	전환권행사	보통주	27,227	500	4,040	제7회차 CB
2020.03.05	전환권행사	보통주	1,589,845	500	3,862	제8회차 CB
2020.03.05	주식매수선택권행사	보통주	13,140	500	5,430	-
2020.04.29	전환권행사	보통주	1,064,214	500	3,862	제8회차 CB
2020.09.04	전환권행사	보통주	33,661	500	3,862	제8회차 CB
2020.09.08	전환권행사	보통주	31,071	500	3,862	제8회차 CB
2020.09.15	주식매수선택권행사	보통주	125,650	500	5,430	-
2020.09.29	주식매수선택권행사	보통주	52,760	500	5,430	-
2020.09.29	주식매수선택권행사	보통주	7,000	500	5,216	-
2020.10.30	주식매수선택권행사	보통주	26,090	500	5,430	-
2020.11.30	주식매수선택권행사	보통주	8,280	500	5,430	-
2020.12.30	주식매수선택권행사	보통주	1,400	500	5,430	-
2020.12.30	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	5,216	-
2021.01.29	주식매수선택권행사	보통주	27,280	500	5,430	-
2021.02.05	전환권행사	보통주	1,165,196	500	3,862	제8회차 CB
2021.02.26	주식매수선택권행사	보통주	1,400	500	5,430	-
2021.03.26	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,216	-
2021.03.26	주식매수선택권행사	보통주	52,580	500	5,430	-
2021.04.26	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	5,216	-
2021.12.16	유상증자(주주배정)	보통주	8,000,000	500	18,150	-
2021.12.17	무상증자	보통주	7,986,975	500	-	-
2023.11.28	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	9,275	-
2023.12.11	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	9,275	-
2023.12.13	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	9,275	-

2024.01.05	주식매수선택권행사	보통주	24,000	500	9,275	-
2024.01.12	주식매수선택권행사	보통주	4,800	500	9,275	-
2024.01.17	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	9,275	-
2024.01.19	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	9,275	-
2024.02.02	주식매수선택권행사	보통주	16,000	500	9,275	-
2024.02.05	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	9,275	-
2024.02.06	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	9,275	-
2024.03.06	주식매수선택권행사	보통주	5,500	500	9,275	-
2024.03.15	전환권행사	보통주	4,062,321	500	10,632	제12회차 영구CB

나. 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 전환형 조권부자본증권 등 발행현황
 ※ 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
하나마이크론 주식회사	신종자본증권	사모	2023.03.15	4,809	0.0%	-	2053.03.15	미상환	-
합 계	-	-	-	4,809	-	-	-	-	-

주1) 당분기 중 제12회차 영구전환사채의 전환 청구권 43,191백만원이 행사되어 보고서 제출일 현재 미상환 잔액은 4,809백만원 입니다.
 (자세한 사항은 2024년 3월 15일자 '전환청구권행사' 공시를 참조 하시기 바랍니다.)

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
		미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항이 없습니다.

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
		미상환	공모	-	-	-	-	-	-

잔액	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항이 없습니다.

라. 회사채 미상환 잔액

- 연결실체

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	75,000	-	45,000	-	-	-	-	-
	합계	75,000	-	45,000	-	-	-	-	-

- 하나마이크론(주)

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	75,000	-	45,000	-	-	-	-	-
	합계	75,000	-	45,000	-	-	-	-	-

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	4,809	-	4,809
	합계	-	-	-	-	-	4,809	-	4,809

주1) 당분기 중 제12회차 영구전환사채의 전환 청구권 43,191백만원이 행사되어 보고서 제출일 현재 미상환 잔액은 4,809백만원 입니다.(자세한 사항은 2024년 3월 15일자 '전환청구권행사' 공시를 참조 하시기 바랍니다.)

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항이 없습니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금 사용내역

연결실체는 2021년 12월 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 실시하였으며, 이에 따른 공모자금의 사용 내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액	
유상증자 (주주배정 후 실권주 일반공모)	12	2021.12.16	시설자금:107,416 운영자금:3,000 기타(예비비):34,784	145,200	시설자금:107,416 운영자금:3,000 기타(예비비):34,784	145,200	-

나. 사모자금 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액	
회사채	9회차	2021.05.27	채무상환 및 운영자금	45,000	채무상환:38,000 운영자금:7,000	45,000	-
회사채	10회차	2021.11.29	채무상환 및 운영자금	25,000	채무상환:19,000 운영자금:6,000	25,000	-
회사채	11회차	2022.08.09	채무상환 및 운영자금	50,000	채무상환:17,000 운영자금:33,000	50,000	-
신종자본증권	12회차	2023.03.15	운영자금 및 투자자금	48,000	운영자금:20,000 투자자금:28,000	48,000	-
회사채	13회차	2024.03.28	채무상환	45,000	채무상환:45,000	45,000	-
제3자배정 유상증자*	-	2019.01.07	시설자금	4,854	시설자금	4,854	-

주1) 제3자배정 유상증자는 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)의 사항입니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

당사는 2021년 1월 1일 BUMP 사업부문을 분할하여 종속회사 하나더블유엘에스(주)를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 BUMP 사업부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 BUMP사업부문의 전문성을 특화하고 경영효율성 및 책임경영 체제의 토대를 확립하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순·물적분할의 방법에 해당합니다.

또한, 반도체 재료부분 하나머티리얼즈(주)의 가스사업부문 매각 결정에 따라 2019년 12월 관련된 자산 및 부채는 매각예정으로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하였으며, 2020년 2월 (주)솔머티리얼즈에게 143억원에 매각을 완료하였습니다.

2) 투자부동산의 공정가치모형의 적용

당사는 제22기 중 투자부동산의 후속측정에 대한 회계정책을 원가모형에서 공정가치모형으로 변경하였습니다.

투자부동산의 공정가치는 해당 자산의 경제적 실질을 반영하므로 이러한 회계정책의변경은 당사의 재무상태, 재무성과 또는 현금흐름에 미치는 영향에 대하여 신뢰성 있고 더 목적적합한 정보를 제공합니다.

투자부동산의 후속측정과 관련하여 투자부동산의 장부금액을 공정가치로 측정하였으며 비교표시된 재무제표 역시 소급하여 재작성하였습니다.

회계정책 변경에 따라 전기 이전의 재무상태표와 포괄손익계산서에 미치는 재무적 영향은 다음과 같습니다.

1) 2021년 12월 31일 현재 재무상태표 조정내역

(단위: 천원)			
구분	소급적용 전	조정	소급적용 후
투자부동산	13,919,053	53,329,380	67,248,433
자산총계	1,030,393,395	20,646,501	1,051,039,896
부채총계	598,562,441	4,065,428	602,627,869
이익잉여금	2,234,540	19,740,459	21,974,999
자본총계	431,830,954	16,581,073	448,412,027

2) 2021년 1월1일에서 2021년 12월 31일까지 포괄손익계산서 조정내역

(단위: 천원)			
구분	소급적용 전	조정	소급적용 후
판매비와관리비	51,597,248	(218,305)	51,378,943
영업이익	104,720,345	218,305	104,938,650
기타영업외수익	18,375,019	4,787,428	23,162,447
기타영업외비용	12,671,849	(153,430)	12,518,419

법인세비용	21,893,159	2,270,292	24,163,451
당기순이익	64,268,957	2,888,871	67,157,828
지배기업소유주에 귀속되는 당기순이익	22,765,703	2,888,871	25,654,574
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	41,503,253	-	41,503,253
기타포괄손익	6,425,171	4,568,595	10,993,766
총포괄손익	70,694,128	7,457,466	78,151,594
기본주당손익	610원	77원	687원
희석주당손익	608원	77원	685원

3) 2021년 1월 1일 현재 재무상태 조정내역

(단위: 천원)			
구분	자산	부채	자본
변경 전	764,827,234	518,088,138	246,739,096
조정사항 :			
투자부동산 공정가치모형	11,573,924	-	11,573,924
조정사항에 따른 법인세 효과	(2,450,317)	-	(2,450,317)
합계	11,573,924	2,450,317	9,123,607
변경 후	776,401,158	520,538,455	255,862,703

회계정책 변경이 현금흐름표에 미치는 영향은 유의적이지 아니합니다. 현금흐름표 상 영업활동으로 인한 현금흐름 내의 당기순이익, 감가상각비 및 투자부동산평가이익 등이 변경되었으며 이를 반영하였습니다.

나. 대손충당금 설정현황(연결기준)

1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률
제24기 1분기	매출채권	145,711,404	8,608,314	5.91%
	계약자산	16,031,848	339	0.00%
	미수금	15,966,942	2,452,194	15.36%
	대여금	749,964	-	0.00%
	미수수익	1,402,448	1,326,289	94.57%
	보증금	765,162	-	0.00%
	장기미수금	5,258,352	5,252,398	99.89%
	장기대여금	6,633,929	5,549,759	83.66%
	보증금	2,342,356	-	0.00%
	합 계	194,862,405	23,189,293	11.90%

제23기	매출채권	88,835,272	8,252,339	9.29%
	계약자산	13,700,853	120	0.00%
	미수금	9,466,476	2,446,673	25.85%
	대여금	724,068	-	0.00%
	미수수익	1,300,473	1,269,763	97.64%
	보증금	803,751	-	0.00%
	장기미수금	5,206,122	5,197,630	99.84%
	장기대여금	5,597,100	5,313,231	94.93%
	보증금	2,305,295	-	0.00%
	합 계	127,939,410	22,479,756	17.57%
제22기	매출채권	73,537,860	8,038,732	10.93%
	계약자산	10,153,722	129	0.00%
	미수금	8,081,572	2,346,076	29.03%
	대여금	225,983	-	0.00%
	미수수익	2,080,940	1,248,000	59.97%
	보증금	323,208	-	0.00%
	장기미수금	4,691,517	-	0.00%
	장기대여금	5,954,997	5,222,163	87.69%
	보증금	2,419,786	-	0.00%
	합 계	107,469,585	16,855,100	15.68%

주 1) 상기 채권금액은 현재가치할인차금 차감전 금액입니다.

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제24기 1분기	제23기	제22기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	22,479,756	16,855,100	15,682,134
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	(858)	5,322,069	653,411
4. 환율변동효과	710,395	302,587	519,555
5. 연결범위변동	-	-	-
6. 기말 대손충당금 잔액합계	23,189,293	22,479,756	16,855,100

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

연결실체는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다.

매출채권 및 기타채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제환경, 보고기간 말 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금 설정률표를 이용하여 산정됩니다.

연결실체는 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하는 등 청산채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있고 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 매출채권 및 기타채권을 제각하고 있습니다.

4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
매출채권	130,538,388	654,611	5,245,160	9,273,245	145,711,404
구성비율	89.59%	0.45%	3.60%	6.36%	100.00%

다. 재고자산 현황 등 (연결기준)

1) 최근 3사업연도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제24기 1분기	제23기	제22기	비고
반도체 제조 및 반도체 재료	원재료	88,769,261	81,913,346	74,279,678	-
	저장품	27,819,311	28,749,324	23,818,130	-
	재공품	25,279,810	20,825,279	21,810,988	-
	제 품	32,147,505	31,909,034	49,197,799	-
	상 품	4,999,755	580,684	5,317,117	-
	미착품	2,786,791	-	441,347	-
	합 계	181,802,433	163,977,667	174,865,059	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		10.1%	9.5%	12.4%	-
재고자산회전율(회수) [매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		5.54회	4.94회	5.26회	-

주1) 재고자산으로 분류된 용지는 제외하고 작성 하였습니다.

2) 재고자산의 실사내역 등

① 재고실사일: 2024년 03월 29일 (금)

② 재고실사자: 당사관계자, 자체조사반

③ 재고실사방법:

- 생산 LINE 재고, 창고 재고, 출하검사실 등의 보관재고자산을 샘플링 재고실사

- ④ 실사결과 : 실사시 파악된 재고자산과 장부가액의 차이는 정상적으로 발생한 경우 매출원가에 가산하고 있으며 그 외의 경우는 기타영업비용으로 분류하고 있습니다.

라. 수주계약 현황

당분기 중 계약과 관련하여 원가 기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식하는 계약 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	기초	신규계약	수익인식	기말
계약잔액	13,700,733	253,414,998	-251,084,221	16,031,510

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분.반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제24기 1분기(당기)	삼일회계법인	예외사항없음	해당사항 없음	-
제23기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	임가공매출의 발생사실 및 정확성 현금창출단위에 대한 손상검사
제22기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	임가공매출의 발생사실 및 정확성 현금창출단위에 대한 손상검사

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제24기 1분기(당기)	삼일회계법인	분·반기재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 감사	590,000	4,900	118,000	680
제23기(전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 감사	565,000	4,710	585,000	4,595
제22기(전전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 감사	530,000	4,420	556,000	5,377

주1) 제24기 감사계약내역의 보수는 연간 총보수 계약액이며, 시간은 계약시점의 총 추정 감사(검토 포함) 시간입니다. 실제수행내역의 보수는 보고서제출일 현재까지 실제 지급된 누적 금액이며, 시간은 당분기 검토까지 소요된 누적 시간입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제24기 1분기(당기)	-	-	-	-	-
제23기(전기)	2023.09.27	법인세 세무조정	2023.07~2024.03	16,000	삼일회계법인
제22기(전전기)	2022.07.26	법인세 세무조정	2022.07~2023.03	16,000	삼일회계법인

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
----	----	-----	----	----------

1	2024.03.19	<ul style="list-style-type: none"> · 회사: 감사, CFO외 2명 · 감사인: 업무수행이사, 담당회계사 등 2명 	서면회의	<ul style="list-style-type: none"> · 감사종결단계의 필수 커뮤니케이션 사항 · 감사진행사항 커뮤니케이션 · 감사인의 독립성 등 감사수행/종결보고
2	2024.04.30	<ul style="list-style-type: none"> · 회사: 감사, CFO외 2명 · 감사인: 업무수행이사, 담당회계사 등 2명 	서면회의	<ul style="list-style-type: none"> · 2024년 연간 감사 및 1분기 검토 수행계획 · 핵심감사사항의 소개 및 논의 · 감사인의 독립성 등

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보

※ 해당사항이 없습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 감사의 내부통제 유효성에 대한 감사결과

당사는 상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.

회사의 감사는 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 "내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계" 및 "내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준"에 의거하여, 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 회사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였으며, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다.

나. 회계감사인의 내부회계관리제도 감사결과

사업연도	감사인	검토의견	지적사항
제24기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-
제23기 (전기)	삼일회계법인	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 「내부회계관리제도 모범규준」의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-
제22기 (전전기)	삼일회계법인	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 「내부회계관리제도 모범규준」의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

3. 회계감사인의 변경

당사는 제22기 회계감사인을 안진회계법인(Deloitte)에서 삼일회계법인(PwC)으로 변경하였습니다. 이는 기존 감사인과 계약 기간 만료 후, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 주기적지정에 의한 것입니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근이사(사외이사)등총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사
				정승부
1	2024.02.14	·제12회 영구전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	찬성
2	2024.02.28	·수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성
3	2024.03.07	·국민은행 여신약정 체결의 건	가결	찬성
4	2024.03.13	·2024년 안전보건 관리 계획 보고의 건	가결	찬성
5	2024.03.13	·제23기 정기주주총회 전자투표 제도 시행의 건	가결	찬성
6	2024.03.13	·제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성
7	2024.03.13	·제23기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 결정	가결	찬성
8	2024.03.13	·제23기 별도 및 연결 결산 재무제표 완료의 건	가결	찬성
9	2024.03.13	·제23기 현금배당 결정의 건	가결	찬성
10	2024.03.13	·내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	찬성
11	2024.03.13	·사내규정 제·개정건의 건	가결	찬성
12	2024.03.14	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 앞 지급보증 제공의 건	가결	찬성
13	2024.03.14	·신한은행 장기운영자금 차입의 건	가결	찬성
14	2024.03.22	·제13회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성
15	2024.03.28	·임원 업무 위촉의 건	가결	찬성

다. 이사회내 위원회

※ 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성

당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부 (횟수)
이동철	이사회	업무 총괄 및 대외 업무수행	전사업무 총괄 (대표이사)	없음	임원	3년	연임(1회)
박상목	이사회	경영관리 업무의 효율적 수행 적임	재무총괄	없음	임원	3년	연임(2회)

김동현	이사회	반도체 사업 효율적 수행 적임	반도체 사업 총괄	없음	특수관계(친인척)	3년	신규
정승부	이사회	반도체 분야의 전문가	사외이사	없음	임원	3년	신규

주1) 2024년 3월28일 개최된 제23기 정기주주총회에서 김동현 사내이사가 신규선임 되었습니다.

마. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않으며 사외이사 선임 시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회가 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.

바. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야의 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.

사. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
4	1	-	-	-

아. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	당사의 사외이사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘자로, 당사 주요 경영사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고 있어 별도의 교육은 실시하지 않았으며, 향후 필요시 2024 회계연도 내에 추가 교육을 실시할 예정입니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부

당사는 공시기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관에 의거 주주총회 결의에 따라 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 독립성

당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	권한
----	----

정관 제50조 (감사의 직무등)	①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③감사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다. ④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다. ⑥감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑦감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑧제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
----------------------	--

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고
안재근	<ul style="list-style-type: none"> · 동국대학교 경영학과(학사) · 삼성전자 반도체 총괄 인사팀장(전무) · 삼성전자 수원지원 센터장(부사장) 	-

라. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사참석
1	2024.02.14	·제12회 영구전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	찬성
2	2024.02.28	·수출성장자금대출 기채에 관한 건	가결	찬성
3	2024.03.07	·국민은행 여신약정 체결의 건	가결	찬성
4	2024.03.13	·2024년 안전보건 관리 계획 보고의 건	가결	찬성
5	2024.03.13	·제23기 정기주주총회 전자투표 제도 시행의 건	가결	찬성
6	2024.03.13	·제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성
7	2024.03.13	·제23기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 결정	가결	찬성
8	2024.03.13	·제23기 별도 및 연결 결산 재무제표 완료의 건	가결	찬성
9	2024.03.13	·제23기 현금배당 결정의 건	가결	찬성
10	2024.03.13	·내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	찬성
11	2024.03.13	·사내규정 제·개정 의 건	가결	찬성
12	2024.03.14	·베트남 현지법인 Hana Micron Vina 앞 지급보증 제공의 건	가결	찬성
13	2024.03.14	·신한은행 장기운영자금 차입의 건	가결	찬성
14	2024.03.22	·제13회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성
15	2024.03.28	·임원 업무 위촉의 건	가결	찬성

마. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
------------	--------------

미 실시	당사의 감사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘자로, 당사 주요 경영사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고 있어 별도의 교육은 실시하지 않았으며, 향후 필요시 2024 회계연도 내에 추가 교육을 실시할 예정입니다.
------	---

바. 감사 지원조직 현황

보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 감사의 직무수행을 보조하는 역할을 하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
경영관리팀	4	전무 외 (12년 2개월)	내부회계관리 및 분기, 반기, 결산감사에 대한 감사업무지원 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사 업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황

보고서 작성기준일 현재 준법지원인과 준법지원인의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 있지 않으나, 전략기획팀 내의 법무파트에서 관련 업무를 수행하는 역할을 하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
전략기획팀(법무)	3	부사장 외 (5년 10개월)	법률 리스크 통합관리 준법경영 및 윤리경영 활동지원

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

당사는 정관상 규정에 따라 집중투표제를 적용하지 않고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제의 시행에 관한 규정을 정관에 별도로 두고 있지 않습니다. 다만, 당사 이사회에서는 주주권 강화와 주주 편의를 제고하기 위해 2018년 3월 제17기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택하여 전자투표제도를 시행해 오고 있습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입
실시여부	미 실시	미 실시	실시

나. 소수주주권

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고
-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

※ 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	52,136,475	-
	-	-	-
의결권없는 주식수(B)	-	-	-
	-	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-
	-	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	4,744,083	상호보유주식
	-	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-
	-	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	47,392,392	-
	-	-	-

주1) 하나머티리얼즈(주)가 보유하고 있는 당사의 주식은 상법 제369조에 의하여 의결권이 제한 됩니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	<p>제10조(신주인수권)</p> <p>① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정 을 받을 권 리를 가진다.</p> <p>②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시 장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식 으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발 행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본채휴를 위하여 그 상대 방에게 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위
---------------	--

	하여 신주를 우선 배정하는 경우 7.주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. ④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.		
결산일	12월 31일	정기주주총회	3월 중
주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지		
주권의 종류	전자증권법에 따른 전자등록		
명의개서대리인	한국예탁결제원		
주주의 특전	해당사항없음	공고방법	회사홈페이지 (매일경제신문)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제23기 정기주주총회 (2024.03.28)	<ul style="list-style-type: none"> • 연결 및 별도 재무제표 승인 • 이사 선임 • 감사 선임 • 이사보수 한도 • 감사보수 한도 	원안대로 승인	-
제22기 정기주주총회 (2023.03.30)	<ul style="list-style-type: none"> • 연결 및 별도 재무제표 승인 • 이사 선임 • 이사보수 한도 • 감사보수 한도 	원안대로 승인	-

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
최창호	본인	보통주	7,945,802	16.56	8,669,972	16.63	-
오문숙	배우자	보통주	465,664	0.97	508,104	0.97	-
이동철	임원	보통주	166,000	0.35	120,000	0.23	-
김길백	임원	보통주	30,396	0.06	30,396	0.06	-
김준식	임원	보통주	29,700	0.06	29,700	0.06	-
주순석	임원	보통주	9,519	0.02	25,519	0.05	-
박상묵	임원	보통주	22,614	0.05	22,614	0.04	-
박진호	임원	보통주	0	0.00	18,000	0.03	-
이유영	임원	보통주	0	0.00	18,000	0.03	-
고용남	임원	보통주	0	0.00	16,000	0.03	-
정원석	임원	보통주	0	0.00	13,000	0.03	-
류기태	임원	보통주	9,018	0.02	9,018	0.02	-
장상규	임원	보통주	0	0.00	4,800	0.01	-
김정제	임원	보통주	10,000	0.02	0	0.00	-
하나머티리얼즈(주)	관계회사	보통주	4,744,083	9.89	4,744,083	9.10	-
계		보통주	13,432,796	27.88	14,229,206	27.29	-
		-	-	-	-	-	-

가. 최대주주의 주요경력

최대주주	약력	최근5년간 주요직무(직위)	겸직현황
최창호	<ul style="list-style-type: none"> · 한국산업기술대 경영학 박사 · 삼성전자 반도체 기획관리본부 장 · 삼성 멕시코 티후아나 복합단지 장 · 하나마이크론 회장 	<ul style="list-style-type: none"> · 하나마이크론(주) 회장 	<ul style="list-style-type: none"> · 하나머티리얼즈(주) 회장 · HANA Micron America Inc 임원

나. 최대주주의 변동내역

※ 해당사항이 없습니다.

2. 주식 소유현황

보고서 작성기준일 현재 『1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황』에 기재한 최대주주 및 그 특수관계인 외에 5% 이상 지분을 소유하고 있는 주주는 없으며, 우리사주조합의 조합원계정 보유주식은 없습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	-	-	-	-
	-	-	-	-
우리사주조합		-	-	-

3. 소액주주 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

(단위 : 주)

구분	주주			소유주식			비고
	소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)	
소액주주	76,549	76,563	99.99	31,075,242	47,979,854	64.78	-

4. 주가 및 주식거래실적

[주식시장: 한국거래소]

(단위 : 원, 주)

종류		10월	11월	12월	1월	2월	3월
보통주	최고	28,100	33,200	29,850	29,900	26,700	28,950
	최저	24,250	25,250	26,750	25,450	24,100	25,500
월간 거래량		47,714,065	79,386,555	27,746,321	27,130,886	21,779,009	63,985,907

주1) 최고가 및 최저가는 해당일의 종가를 기준으로 작성 하였습니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

당사의 임원은 총 19명(감사포함)으로 등기임원 5명, 미등기임원 14명입니다. 임원 및 직원의 현황은 2024년 03월 31일 기준으로 작성되었으며 보다 자세한 내용은 아래를 참조 하시기 바랍니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
이동철	남	1962.05	대표이사 사장	사내이사	상근	대표이사	· 연세대 전자공학과 졸업 · 삼성전자 DS부문 메모리사업부 기술기획팀 · 일본삼성 반도체 사업부장(전무) · 삼성SDI 기획팀장	120,000	-	임원	2019.03 ~ 현재	2025.03.31
김동현	남	1981.05	부사장	사내이사	상근	COO	· Stanford University 전자공학 박사 · 삼성전자 반도체 S-LSI 사업부 · 하나마이크론 부사장	-	-	특수관계 (친인척)	2013.09 ~ 현재	2027.03.28
박상복	남	1973.08	전무	사내이사	상근	경영관리	· 고려대 경영학 석사 · 하나마이크론 경영관리팀장	22,614	-	임원	2001.11 ~ 현재	2027.03.28
정승부	남	1959.06	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	· 성균관대 금속공학과 졸업 · 한국 마이크로 전자 및 패키징학회 회장 · 성균관대학교 신소재공학부 교수	-	-	임원	2023.03 ~ 현재	2026.03.30
안재근	남	1957.06	감사	감사	상근	감사	· 동국대 경영학과 졸업 · 삼성전자 반도체 총괄 인사팀장(전무) · 삼성전자 수원지원 센터장(부사장)	-	-	임원	2018.03 ~ 현재	2027.03.28
김준식	남	1962.02	부사장	미등기	상근	전략기획	· 연세대 법학 석사 · New York Law School · 삼성전자 법무팀 선임변호사 · 법무법인 총정 기업자문팀 파트너변호사	29,700	-	임원	2014.06 ~ 현재	-
이승범	남	1964.07	부사장	미등기	상근	Global Sales	· 동국대 산업공학과 졸업 · 삼성전자 시스템LSI영업마케팅(상무) · 삼성SDI 전자재료 영업마케팅(상무)	-	-	임원	2021.03 ~ 현재	-
김정제	남	1965.05	전무	미등기	상근	경영지원	· 호서대 경영학 박사 · 삼성전자(주) 반도체 인사그룹 · 세메스(주) 경영지원 그룹장	8,000	-	임원	2009.06 ~ 현재	-
고용남	남	1963.03	전무	미등기	상근	연구소	· 경북대 전자공학과 졸업 · 삼성전자 제품개발TF팀장	17,900	-	임원	2021.03 ~ 현재	-

주순석	남	1966.03	전무	미등기	상근	품질	· 삼성전자 반도체 품질관리팀 · 하나마이크론 QRA팀장	25,519	-	임원	2001.12 ~ 현재	-
장진욱	남	1967.12	전무	미등기	상근	연구소	· 서울대 재료공학 박사 · 삼성전자 반도체사업부 Package 기술팀	-	-	임원	2024.02 ~ 현재	-
신태희	남	1965.07	전무	미등기	상근	Fabless Sales	· 한양대 물리학과 졸업 · 삼성전자 반도체사업부	-	-	임원	2024.03 ~ 현재	-
김진석	남	1968.06	상무	미등기	상근	Test	· 울산대 컴퓨터 공학과 졸업 · 스태츠칩팩코리아 Test 기술팀	-	-	임원	2008.09 ~ 현재	-
이병현	남	1966.09	상무	미등기	상근	구매	· 원광대 전자공학과 졸업 · 삼성전자 무선사업부 SCM파트 EOP셀장 · 하나마이크론(주) 구매팀 팀장	-	-	임원	2023.07 ~ 현재	-
박진호	남	1971.03	상무	미등기	상근	기술	· 한양대 재료공학과 졸업 · 현대전자 반도체 공정기술	8,000	-	임원	2006.07 ~ 현재	-
장상규	남	1972.01	상무	미등기	상근	AP LAB	· 인하대 전자공학과 졸업 · 삼성전자 제품개발팀	4,800	-	임원	2021.03 ~ 현재	-
김강표	남	1971.02	상무	미등기	상근	Facility	· 삼성전자 UTILITY 운영그룹 · 하나마이크론(주) Facility그룹장	-	-	임원	2001.12 ~ 현재	-
이웅희	남	1971.07	상무	미등기	상근	IDM Sales	· 시그네틱스 영업팀 · 하나마이크론(주) IDM Sales그룹장	-	-	임원	2007.04 ~ 현재	-
이경동	남	1974.05	상무	미등기	상근	제조	· 하나마이크론(주) 제조팀 팀장	-	-	임원	2002.04 ~ 현재	-

주1) 제23기 정기주주총회(2024년 3월 28일 개최)를 통해 김동현 사내이사 신규선임 및 박상목 사내이사, 안재근 상근감사가 재선임 되었습니다.

주2) 상기 소유주식수는 주주명부 폐쇄일 2023년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로 하여 보고서 제출일 현재 확인가능한(공시된) 소유주식 변동분을 반영하였으며, 등기임원의 임기만료일은 예정일입니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

※ 해당사항이 없습니다.

다. 임원 겸직 현황(등기임원)

구분	성명	겸직 현황
대표이사	이동철	하나더블유엘에스(주) 기타비상무이사
사내이사	박상목	하나더블유엘에스(주) 감사
사내이사	박상목	하나옵트로닉스(주) 감사
사내이사	김동현	하나옵트로닉스(주) 사내이사

라. 직원의 현황

당사는 당분기말 현재 총 810명(가. 임원현황의 등기임원 제외)의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속 연수는 6.4년, 당분기의 1인 평균 급여액은 14백만원 입니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직원 수					평균 근속연수	연간급여 총액	1인평균 급여액	남	여	계	
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합계							
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)								
하나마이크론	남	454	-	-	-	454	7.5	6,745	15				-
하나마이크론	여	356	-	-	-	356	5.3	4,606	12	-	-	-	-
합계		810	-	-	-	810	6.4	11,352	14				-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	14	587	42	-

주1) 당기 중 재임 또는 퇴임한 임원을 포함한 총 인원 및 급여액을 기재하였습니다.

2. 임원의 보수 등

<이사·감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주주총회 승인금액	비고
이사	4	4,000	-
감사	1	500	-

2. 보수지급금액

2-1. 이사·감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
6	377	63	-

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	341	85	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	1	7	7	-
감사위원회 위원	-	-	-	-
감사	1	29	29	-

주1) 인원수는 당기중 재임 또는 퇴임한 등기이사, 사외이사, 감사를 포함한 총 인원 수 입니다.

주2) 보수총액은 당기중 재임 또는 퇴임한 등기이사·사외이사·감사의 소득금액을 합산한 금액입니다.

주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

<보수지급금액 5억원 이상인 이사·감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

※ 당사는 이사 및 감사에게 5억원 이상 지급한 개인별 보수가 없습니다.

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

※ 당사는 공시대상 기간 중 5억원 이상 지급한 개인별 보수가 없습니다.

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

<표1>

(단위 : 백만원)

구 분	부여받은 인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	144	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	-	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-
업무집행지시자 등	-	-	-
계	2	144	-

주1) 주식매수선택권의 공정가치 산출방법은 "Ⅲ. 재무에관한사항 > 5. 재무제표 주석 > 주석20. 주식선택권" 을 참조하시기 바랍니다.

<표2>

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	최초 부여 수량	당기변동수량		총변동수량		기말 미행사수량	행사기간	행사 가격	의무 보유 여부	의무 보유 기간
						행사	취소	행사	취소					
이동철	등기임원	2019.03.27	신주발행 또는 자기 주식 교부	보통주	120,000	-	-	40,000	-	80,000	2021.03.27~ 2026.03.27	3,526	X	-
박상욱	등기임원	2021.03.30	신주발행 또는 자기 주식 교부	보통주	24,000	-	-	-	-	24,000	2023.03.30~ 2028.03.30	9,275	X	-
김정제외 11명	미등기임원	2021.03.30	신주발행 또는 자기 주식 교부	보통주	252,000	94,300	-	112,300	-	139,700	2023.03.30~ 2028.03.30	9,275	X	-
이승범외 2명	미등기임원	2022.03.30	신주발행 또는 자기 주식 교부	보통주	70,000	-	-	-	-	70,000	2024.03.30~ 2029.03.30	18,860	X	-

IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단의 명칭

보고서 작성기준일 현재 계열사는 당사를 포함하여 총15개사이며, 「공정거래법」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수		
	상장	비상장	계
해당사항 없음	2	14	16

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(2) 계열회사간 출자현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

출자회사 피출자회사	하나 마이크론(주)	HANA Micron America Inc.	하나 머티리얼즈(주)	하나에스앤비인베 스트먼트(주)
하나마이크론(주)	-	-	9.10%	-
하나머티리얼즈(주)	32.93%	-	-	-
Hana Micron America, Inc.	100.00%	-	-	-
HT Micron Semicondutores S.A.	100.00%	-	-	-
HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED	50.00%	-	-	-
(주)이노메이트	79.75%	-	-	-
(주)이피웍스	51.19%	-	-	-
HANA Micron Vietnam Co., Ltd	100.00%	-	-	-
Hana Micron Vina Co.,Ltd	100.00%	-	-	-
하나마이크론태양광(주)	100.00%	-	-	-
Hana Latin America, Ltda.	-	99.76%	-	-
AniTrace, Inc.	-	100.00%	-	-
하나더블유엘에스(주)	61.54%	-	-	-
Hana Electronics Industria E Comercio Ltda	100.00%	-	-	-
하나에스앤비인베스트먼트(주)*	-	-	100.00%	-
흥국-하나에스앤비 뉴프라이밍 신기술투자조합	-	-	47.62%	2.38%

나. 계열회사간 임원겸직 현황(등기임원)

동 보고서의 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」의 임원겸직 현황 내용을 참조하시기 바랍니다.

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액			
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
					취득 (처분)	평가 손익	
경영참여	1	11	12	284,840	-	-18,685	266,155
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	-	14	14	15,939	-6,241	-49	9,649
계	1	25	26	300,779	-6,241	-18,734	275,804

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사에 대한 대여금 및 채무보증 내역은 다음과 같습니다.

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	구분	변 동 내 역				미수/ 미지급이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
HANA Micron Vietnam Co, Ltd	계열회사	대여금	9,619	428	-	10,047	253	USD 7,460,000
Hana Micron Vina Co.,Ltd	계열회사	대여금	33,524	1,493	-	35,017	889	USD 26,000,000
HT MICRON SEMICONDUCTORES S.A.	계열회사	대여금	29,011	1,292	-	30,303	913	USD 22,500,000
Hana Electronics Industria E Comercio Ltda	계열회사	대여금	23,209	1,033	-	24,242	1,164	USD 18,000,000

주1) 변동내역의 증감금액에는 외화평가에 의한 증감액이 포함되어 있습니다.

나. 채무보증 내역

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원, US달러, BRL)

구분	성명 (법인명)	관계	거 래 내 역		
			기초	증감	기말
채무보증 제공	HANA Micron America Inc.	계열회사	USD3,000,000	-	USD3,000,000
	HT Micron Semicondutores S.A.	계열회사	USD11,925,000	(USD3,000,000)	USD8,925,000
			BRL 99,000,000	-	BRL 99,000,000
	Hana Micron Vina Co.,Ltd	계열회사	USD 422,000,000	-	USD 422,000,000
Hana Micron Vietnam Co.,Ltd.	계열회사	USD 6,000,000	-	USD 6,000,000	

※ 상기 채무보증의 상세 내용은 아래와 같으며, 동 채무보증의 대가로 계열회사별 채무보증 만기, 일
반적인 신용공여 조건의 이율등을 감안하여 수수료를 수취 또는 지급하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : US달러, BRL)

구분	계열회사	채권자	지급보증액	보증내용
채무보증 제공	HANA Micron America Inc.	하나은행	USD3,000,000	Stand by LC 지급보증

	HT Micron Semicondutores S.A.	CITI BANK	USD 6,000,000	Corporate Guarantee
		CITI BANK	USD 2,925,000	Corporate Guarantee
		BNDES	BRL 99,000,000	Corporate Guarantee
	Hana Micron Vina Co.,Ltd	CITI BANK	USD 12,000,000	Corporate Guarantee
		CITIBANK N.A. 등	USD 200,000,000	Corporate Guarantee
		KDB산업은행 등	USD 210,000,000	Corporate Guarantee
Hana Micron Vietnam Co.,Ltd.	Shinhan Vietnam	USD 6,000,000	Corporate Guarantee	

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 공시대상기간 중 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위한 자산양수도 등의 거래가 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

공시대상기간 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주등과의 영업거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
Hana Micron Vina Co.,Ltd	계열회사	매출,매입 등	2024.01.01 ~2024.03.31	상품,유형자산 등	86,706
HT Micron Semicondutores S.A	계열회사	매출,매입 등	2024.01.01 ~2024.03.31	반도체제품 등	31,851

자세한 내역은 「III. 재무에 관한 사항」 5.재무제표 주석, 24.특수관계자와의 거래」를 참조하시기 바랍니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

공시서류 작성 기준일 현재 당사는 종업원 복리후생 목적의 주택자금, 생활안정자금으로 총 100백만원의 대여금이 있습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 기신고한 공시사항의 진행상황

공시대상 회사	신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항
하나머티리얼즈(주)	2024.02.28	[기재정정]신규 시설투자 등	정정전 - 투자금액 : 1,253억원 - 시작일 : 2022년 06월 29일 - 종료일 : 2023년 12월 31일 정정후 - 투자금액 : 1,253억원 - 시작일 : 2022년 06월 29일 - 종료일 : 2024년 05월 31일	투자 금액 및 기간 변경
하나머티리얼즈(주)	2023.09.18	[연장결정] 자기주식취득 신탁계약 체결 결정	정정전 -신탁계약금액 : 30억원 -신탁계약잔액 : 18억원 -시작일 : 2022년 09월 19일 -종료일 : 2023년 09월 19일 정정후 -신탁계약금액 : 30억원 -신탁계약잔액 : 18억원 -시작일 : 2023년 09월 19일 -종료일 : 2024년 09월 19일	신탁계약 연장
하나마이크론(주) 하나머티리얼즈(주)	2023.06.29	타인에대한채무보증결정	-보증금액 : USD 200,000,000 -시작일 : 2023년 06월 29일 -종료일 : 2029년 11월 28일	계열회사 채무보증
하나머티리얼즈(주)	2023.01.31	최대주주변경을수반하는 주식담보제공계약체결	-담보제공자 : 하나마이크론(주) (최대주주) -담보물건 : 하나머티리얼즈(주) 주식 -기준일 : 2023년 01월 31일 -종료일 : 최대주주의 담보 미제공 주식수량 이2대주주 주식수량을 초과할 경우 종료 예 정	최초공시 이후에 주식담보계약의 연장 및 수량 변동 등에 사유로 계속 정정공시 진행 중
하나머티리얼즈(주)	2022.11.17	타인에대한채무보증결정	-보증금액 : 250억원 -시작일 : 2022년 11월 24일 -종료일 : 2026년 11월 24일	계열회사 채무보증

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건

※ 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황

※ 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황

동보고서의 "X. 대주주 등과의 거래내용" 중 1의 나, 채무보증내역"을 참조하시기 바랍니다.

라. 채무인수약정 현황

동보고서의 "III. 재무에 관한 사항" 중 "연결재무제표 주석. 우발채무와 약정사항"을 참조하시기 바랍니다.

마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

동보고서의 "III. 재무에 관한 사항" 중 "7. 증권 발행을 통한 자금조달에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

바. 담보제공 자산

공시서류 작성 기준일 현재 연결실체는 차입금과 관련하여 KDB산업은행등 금융기관에 보유중인 토지 및 건물등 533,207백만원 및 하나머티리얼즈주식(5,495,614주)를 담보로 제공하고 있습니다.(보다 자세한 사항은 동보고서의 "III. 재무에 관한 사항" "3. 연결재무제표 주석" 중 "15의 (3)차입금 관련 담보제공 및 지급보증 내역"을 참조하시기 바랍니다.)

사. 그 밖의 우발채무 등

1) 장래매출채권 유동화 현황

(단위 : 백만원)

발행회사 (SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액
하나머티리얼즈 제일차(유)	하나머티리얼즈의 장래 매출채권 도쿄일렉트론코리아	ABCP	2018.10.30	20,000	11,000
KDB산업은행	하나마이크론의 장래매출채권 (삼성전자,SK하이닉스)	ABL	2022.06.22	59,500	56,800
하나마이크론제삼차(주)	하나마이크론의 장래매출채권 (삼성전자)	ABCP	2020.01.20	39,500	17,200

장래매출채권 유동화채무 비중

(단위 : 백만원)

	당분기말	전기말	증감

	금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)
유동화채무	85,000	-	88,260	-	(3,260)
총차입금	915,085	9.29%	878,768	10.04%	36,317
매출액	268,961	31.60%	967,971	9.12%	(699,010)
매출채권	145,711	58.33%	88,835	99.35%	56,876

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

※ 해당사항이 없습니다.

나. 단기매매차익 환수현황

※ 해당사항이 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

※ 해당사항이 없습니다.

나. 중소기업기준 검토표

※ 해당사항이 없습니다.

다. 합병등의 사후정보

당사는 2021년 1월 1일 BUMP 사업부문을 분할하여 종속회사 하나더블유엘에스(주)를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 BUMP 사업부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 BUMP사업부문의 전문성을 특화하고 경영효율성 및 책임경영 체제의 토대를 확립하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순·물적분할의 방법에 해당합니다.

- 분할 사업부문

구분	회사명	사업부문
분할되는 회사 (존속회사)	하나마이크론(주)	신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문
분할신설회사	하나더블유엘에스(주)	BUMP 사업부문

- 분할 회사의 개요

분할되는 회사 (존속회사)	상호	하나마이크론 주식회사
	소재지	충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77
	대표이사	이동철

	법인구분	코스닥시장 상장법인
--	------	------------

분할신설회사	상호	하나더블유엘에스 주식회사
	소재지	충청남도 아산시 음봉면 연암울금로 77, 생산4동
	대표이사	신태희
	법인구분	비상장법인

- 분할 주요일정

구 분	일 자
이사회결의일	2020년 11월 11일
주주명부 폐쇄 및 기준일 공고	2020년 11월 11일
분할 주주총회를 위한 주주확정일	2020년 11월 26일
주주총회 소집 통지일	2020년 12월 08일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2020년 12월 23일
분할기일	2021년 01월 01일
분할보고총회일 또는 창립총회일	2021년 01월 04일
분할등기일	2021년 01월 06일

주1) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 같음하였습니다.

- 분할 전 · 후의 재무상태표

(단위:천원)

구 분	분할 전	분할 후	
		분할존속회사	분할신설회사
		하나마이크론(주)	하나더블유엘에스(주)
자산			
Ⅰ.유동자산	137,093,768	134,658,486	2,435,282
(1)현금및현금성자산	7,157,289	6,157,287	1,000,000
(2)단기금융상품	7,486,117	7,486,117	-
(3)매출채권및기타채권	79,438,962	78,339,608	1,099,355
(4)기타유동자산	6,763,666	6,763,666	-
(5)재고자산	28,242,778	27,906,852	335,927
(6)계약원가	3,920,275	3,920,275	-
(7)매각예정자산	4,071,479	4,071,479	-
(8)당기법인세자산	13,202	13,202	-
Ⅱ.비유동자산	359,176,449	361,185,068	26,800,441
(1)당기손익-공정가치측정금융자산	838,736	836,719	2,017
(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	649,827	649,827	-
산			

(3)유형자산	227,154,271	200,843,112	26,311,159
(4)투자부동산	5,606,111	5,606,111	-
(5)무형자산	1,212,454	725,189	487,265
(6)사용권자산	3,362,934	3,362,934	-
(7)종속기업및공동기업 투자주식	56,352,545	85,161,605	-
(8)장기매출채권및기타채권	63,606,013	63,606,013	-
(9)이연법인세자산	393,558	393,558	-
자산총계	496,270,217	495,843,554	29,235,723
부채			
Ⅰ.유동부채	212,549,203	212,303,961	245,241
(1)매입채무및기타채무	56,400,894	56,155,652	245,241
(2)단기차입금	111,000,000	111,000,000	-
(3)유동성장기차입금	31,318,777	31,318,777	-
(4)기타유동부채	5,700,198	5,700,198	-
(5)금융보증부채	180,244	180,244	-
(6)전환사채	3,373,419	3,373,419	-
(7)리스부채	1,990,539	1,990,539	-
(8)당기손익-공정가치측정금융부채	2,585,132	2,585,132	-
Ⅱ.비유동부채	129,341,128	129,159,707	181,422
(1)장기매입채무및기타채무	1,922,744	1,911,473	11,271
(2)장기차입금	120,529,131	120,529,131	-
(3)리스부채	561,212	561,212	-
(4)순확정급여부채	6,328,041	6,157,891	170,151
부채총계	341,890,331	341,463,668	426,663
자본			
Ⅰ.자본금	15,184,756	15,184,756	1,000,000
Ⅱ.기타불입자본	120,014,671	120,014,671	27,809,060
Ⅲ.기타자본구성요소	19,070,021	19,070,021	-
Ⅳ.이익잉여금(결손금)	110,438	110,438	-
자본총계	154,379,886	154,379,886	28,809,060
자본과부채총계	496,270,217	495,843,554	29,235,723

주1) 상기 분할 재무상태표는 2020년 06월 30일 현재 재무상태표를 바탕으로 한 자료이며, 분할기일의 재무제표와는 차이가 있을 수 있습니다.

주2) 합병등 전후의 재무사항 비교표를 위 재무상태표로 같음하며, 그 외 본 분할에 관한 상세한 내용은 2020년 11월 11일 제출한 주요사항보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

라. 외국지주회사의 자회사 현황

※ 해당사항이 없습니다.

마. 녹색경영

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제42조에 따라 2012년 6월 29일 온실가스 목표 관리업체로 지

정되었으며, 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조에 따라 2014년 9월 12일 온실가스배출권 할당대상 업체로 지정되었습니다. 이에 온실가스, 에너지 배출 목표량 및 할당량을 달성하기 위해 추가적인 규제 준수비용 및 온실가스 배출권 구매비용이 수반 될 수 있습니다.

또한, 당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 정부에 보고하고 있으며, 정부에 보고한 명세서에 따른 당사의 온실가스 배출량 및에너지 사용량은 아래와 같습니다.

구분	2023년	2022년	2021년
온실가스(tCO ₂ e)	38,138	39,895	33,355
에너지(TJ)	772	830	693

바. 보호예수 현황

※ 해당사항이 없습니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
하나머티리얼즈(주)*	2007.01.23	충남 천안시 서북구 3공단 3로 42	Silicon Parts 및 Ingot	672,378	실질 지배력 보유 (K-IFRS 1110호)	해당 (직전연도 자산총액 10% 이상)
Hana Micron Vina Co.,Ltd	2019.07.26	CNSG-02-01, Van Trung Industrial Zone, Van Trung Commune, Viet Yen ward, Bac Giang Province, Viet Nam	반도체	588,372	기업의결권의 과반수를 소유 (K-IFRS 1110호)	해당 (직전연도 자산총액 10% 이상)
HT MICRON SEMICONDUCTORES S.A.	2010.03.12	Av. Unisions, 950 Ssa Leopoldo RS 93022-000 Brasil	반도체	92,361	기업의결권의 과반수를 소유 (K-IFRS 1110호)	해당 (직전연도 자산총액 750억원 이상)
HANA Micron Vietnam Co., Ltd	2016.06.28	Yen Phong Industrial Zone, Long Chau, Yen Phong District, Bac Ninh Province, Vietnam	반도체	36,599	기업의결권의 과반수를 소유 (K-IFRS 1110호)	미해당
Hana Electronics Industria E Comercio Ltda	2021.06.08	Rua Rio Ica, nº. 310, Auditorium, Celebration Smart Offices Building, Bairro Nossa Senhor a das Gracas, CEP: 69.053-100, Manaus City, Amazonas State, Brazil.	반도체	34,083	기업의결권의 과반수를 소유 (K-IFRS 1110호)	미해당
하나더블유엘에스(주)*	2021.01.04	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	반도체	21,548	기업의결권의 과반수를 소유 (K-IFRS 1110호)	미해당
HANA Micron America, Inc.	2006.01.26	3108 Patrick Henry Drive, Santa Clara, CA 95054, USA	반도체	7,348	기업의결권의 과반수를 소유 (K-IFRS 1110호)	미해당
HANA LATIN AMERICA, Ltda	2013.01.15	Av. Unisions, 1550 Sao Leopoldo RS 93022-750 Brasil	System Integration	4,124	기업의결권의 과반수를 소유 (간접, 손자회사) (K-IFRS 1110호)	미해당
(주)이피웍스	2006.07.04	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	TSV Interposer 및 개발	666	기업의결권의 과반수를 소유 (K-IFRS 1110호)	미해당
하나마이크론태양광 주식회사	2011.03.02	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77	태양광 발전	284	기업의결권의 과반수를 소유 (K-IFRS 1110호)	미해당
AniTrace Inc	2017.01.31	3108 Patrick Henry Drive, Santa Clara, CA 95054, USA	SI (systemintegration)	37	기업의결권의 과반수를 소유 (K-IFRS 1110호)	미해당

이노메이트	2007.07.25	충북 청주시 청원구 오창읍 후기길 62	반도체용 특수가스 전문제조	11	기업의결권의 과반수를 소유 (K-IFRS 1110호)	미해당
하나에스앤비인베스트먼트(주))*	2023.01.05	서울시 강남구 테헤란로22길 13, 8층	신기술사업금융	-	기업의결권의 과반수를 소유 (K-IFRS 1110호)	미해당

주1) 하나머티리얼즈(주)의 경우 당사가 직접 보유한 지분율은 50% 미만이나, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 감안할 때 실질적으로 지배력을 보유하고 있어 연결대상 종속회사에 포함하였습니다.

주2) 2021년 1월 1일자로 하나마이크론㈜의 BUMP 사업부문을 물적분할하여 하나더블유엘에스㈜를 설립하였습니다.

주3) 전기 중 신기술사업금융업을 영위하기 위한 하나에스앤비인베스트먼트(주)를 설립하여 연결대상에 신규 포함 되었습니다.

☞ 주요 종속회사 여부 판단기준

- 직전연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상인 종속회사
- 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

2. 계열회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	2	하나마이크론(주)	164811-0021208
		하나머티리얼즈(주)	161511-0086227
비상장	14	Hana Micron America, Inc.	해외법인
		HT Micron Semicondutores S.A.	해외법인
		HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED	해외법인
		(주)이노메이트	160111-0228216
		(주)이피웍스	110111-3487570
		HANA Micron Vietnam Co., Ltd	해외법인
		Hana Micron Vina Co.,Ltd	해외법인
		하나마이크론태양광(주)	161511-0126776
		Hana Latin America, Ltda.	해외법인
		AniTrace, Inc.	해외법인
		하나더블유엘에스(주)	164811-0141197
		Hana Electronics Industria E Comercio Ltda	해외법인
하나에스앤비인베스트먼트(주)*	131111-0692606		
흥국-하나에스앤비 뉴프라임 신기술투자조합	283-80-02963		

3. 타법인출자 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증기(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황		
					수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순이익	
								수량	금액							
하나머티리얼즈(주)	상장	2007.01.22	경영참여	9,928	6,428,508	33	93,333	-	-	1,811	6,428,508	33	95,144	672,378	34,194	
HANA Micron America Inc*	비상장	2006.01.26	경영참여	36,114	30,800,000	100	-	-	-	-	30,800,000	100	-	7,348	-698	
(주)덕성레저개발	비상장	2007.12.31	단순투자	250	3,125	1	-	-	-	-	3,125	1	-	-	-	
(주)위즈커뮤니케이션	비상장	2009.10.31	단순투자	1,540	190,000	4	1,012	-	-	-	190,000	4	1,012	27,639	1,473	
HT MICRON SEMICONDUCTORES S.A.	비상장	2010.03.12	경영참여	85,807	328,741,095	100	27,058	-10,000	-	-7,232	328,731,095	100	19,826	92,361	-17,501	
ROYAL TRIDENT	비상장	2010.07.09	단순투자	152	94,445	10	-	-	-	-	94,445	10	-	-	-	
Hana Innosys Latin America	비상장	2010.07.09	경영참여	637	946,572	50	-	-	-	-	946,572	50	-	391	-518	
HANA Micron Vietnam Co. Ltd	비상장	2016.06.28	경영참여	6,554	-	100	202	-	-	-202	-	100	-	36,599	-3,110	
Hana Micron Vina Co.,Ltd	비상장	2019.07.26	경영참여	212,079	-	100	150,462	-	-	-	-	100	139,434	588,372	-9,289	
(주)이노메이트	비상장	2010.07.07	경영참여	4,115	229,000	80	-	-	-	-	229,000	80	-	11	-870	
(주)이피웍스	비상장	2013.12.31	경영참여	6	86,000	51	-	-	-	-	86,000	51	-	666	-5	
하나마이크론태양광(주)	비상장	2016.08.10	경영참여	-	2,000	100	-	-	-	-	2,000	100	-	284	25	
(주)솔머티리얼즈*	비상장	2020.01.31	단순투자	4,290	30,000	19.54	5,677	-30,000	-5,677	-	-	-	-	41,281	167	
하나더블유엘에스(주)	비상장	2021.01.01	경영참여	28,830	2,000,000	62	3,842	-	-	-2,401	2,000,000	62	1,441	21,548	-20,245	
Hana Electronics Industria E Comercio Ltda*	비상장	2021.06.08	경영참여	6,305	-	100	-	-	-	-	-	100	-	34,083	-1,629	
하나에스앤비인베스트먼트(주)	비상장	2023.01.05	경영참여	500	2,100,000	100	9,943	-	-	367	2,100,000	100	10,310	9,973	-413	
오토엘	비상장	2022.08.25	단순투자	300	404	1	300	-	-	-	404	1	300	10,105	1,988	
노바세미(주)	비상장	2023.09.26	단순투자	2,000	5,494	6	2,000	-	-	-	5,494	6	2,000	38,550	437	
이에이트(주)	비상장	2023.08.23	단순투자	700	40,000	0.48	800	-40,000	-800	-	-	-	-	7,119	-6,399	
케이런1호 스타트업 투자조합	비상장	2016.03.24	단순투자	500	-	5	3	257	-	-	-	5	3	257	8,878	591
엘앤에스 글로벌 반도체성장 투자조합	비상장	2018.02.28	단순투자	300	2,264	5.00	3,597	-173	-173	-	2,091	5.00	3,425	51,311	9,582	
이노폴리스 2019 투자조합	비상장	2019.07.24	단순투자	100	1,000	3.91	1,296	-112	-112	-	888	3.91	1,184	22,851	-486	
오를러스제3호 사무투자합자회사	비상장	2023.12.19	단순투자	1,000	1,000,000.00	9.09	1,000	-	-600	-	400,000,000	3.64	400	10,528	-473	
중국-하나에스앤비 뉴프라이밍 신기술 조합*	비상장	2024.01.25	단순투자	1,050	-	-	-	1,050,000.00	1,050	-49	1,050,000.00	50.00	1,001	-	-	
하나에스앤비로보틱스 1호 신기술조합	비상장	2024.03.19	단순투자	70	-	-	-	70,000,000	70	-	70,000,000	6.54	70	-	-	
아이엠비디엑스	비상장	2024.03.28	단순투자	1	-	-	-	110	1	-	110	0	1	9,821	-10,416	
합 계					1,371,699.9	-	300.77	519,919,825	-6,241	-	1,891,619.7	-	275.80	-	-	
					12	9			18,734		37	5				

주1) (주)솔머티리얼즈는 전기말 '매각예정비유동자산'으로 계정과목을 분류하였고 (주)솔머티리얼즈의 주식 30,000주를 2024년 1월 8일 '아스트라-솔론신기술투자조합1호' 에 전량 매각하였습니다.

주2) 중국-하나에스앤비뉴프라이밍 신기술조합* 과 '하나에스앤비로보틱스 1호 신기술조합' 은 2024년도 설립되어 최근사업연도 재무현황을 제외 하였습니다.

4. 지적재산권 보유현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

회사명	출원국	산업재산권의 종류	등록일자	명칭
하나 마이 크론	한국	특허	2004.05.12	유기 전계 발광 디바이스 디스플레이 구동장치 및 방법
	한국	특허	2004.11.01	휴대용 단말기의 대화면 디스플레이 장치
	한국	특허	2004.11.26	듀얼 디스플레이 패널에 의한 하나의 확장된 화면을 갖는 휴대용 단말기와 그 화면표시 제어 방법 및 그 제어 장치
	한국	특허	2006.07.28	유에스비 디바이스에 기록된 오디오/비디오 콘텐츠의 실행 및 데이터관리 가능한 다기능 플레이어 시스템
	한국	특허	2006.12.14	디스플레이 장치의 채널간섭보상방법, 데이터신호 구동제어장치 및 디스플레이장치
	한국	특허	2007.02.26	OLED 디스플레이패널 구동장치의 D/A 컨버터
	한국	특허	2007.05.08	인형타입 휴대형 유에스비 플래쉬 드라이브
	한국	특허	2007.05.08	호스트 애플피쓰리 플레이어 장치
	한국	특허	2007.06.08	시스템인 패키지
	한국	특허	2007.06.14	유에스비와 알에프아이디칩을 이용한 교통카드 및 그 결제방법
	한국	특허	2007.07.03	서브스트레이트리스 플립칩 패키지와 그 제조방법
	한국	특허	2007.08.24	반도체패키지 및 그 제조방법
	한국	특허	2007.10.09	라인플립칩패키지 및 그 제조방법
	한국	특허	2007.10.19	이동형 휴대기기를 이용한 선불카드 충전시스템 및 그 방법
	한국	특허	2008.02.26	암호화된 콘텐츠를 저장하는 저장 장치 및 그 콘텐츠의 제공 방법
	한국	특허	2008.02.26	화자 인증을 이용한 온라인 콘텐츠의 사용자 인증 시스템 및 방법
	한국	특허	2008.03.26	이미지센서패키지 및 이의 제조방법
	한국	특허	2008.05.06	USB 메모리패키지 및 그 제조방법
	한국	특허	2008.08.01	USB 메모리패키지 및 그 제조방법
	한국	특허	2008.12.24	양방향 입출력단자를 갖는 반도체패키지 및 그 제조방법
	한국	특허	2009.02.27	무선헤드셋 및 그 제어방법
	한국	특허	2010.08.25	USB 메모리 패키지
	한국	특허	2010.12.21	USB 메모리 패키지(상,하단에 입,출력 단자(Land)를 가지는 USB 메모리 및 그 제조 방법)
	한국	특허	2011.03.09	BIOS 메모리를 포함하는 데이터 저장 장치
	한국	특허	2011.03.17	USB 메모리 패키지 및 그 제조 방법
	한국	특허	2011.03.17	서포터 칩을 갖는 반도체 패키지 및 그 제조 방법
	한국	특허	2011.03.17	반도체 패키지(히트슬리거를 통한 열방출 및 반도체 다이 보호)
	한국	특허	2011.08.19	반도체 패키지 제조 방법
	한국	특허	2011.09.21	적층형 반도체 패키지 및 그 제조 방법
	한국	특허	2011.10.24	발광 다이오드 패키지의 형광체 코팅방법
	한국	특허	2012.02.06	반도체 패키지 몰드플래쉬 제거방법
	한국	특허	2012.02.06	열방출형 반도체 패키지 제조방법
	한국	특허	2012.02.13	삼차원 반도체 디바이스(3D Package 및 그 제조 방법)
	한국	특허	2012.03.14	열방출형 반도체 패키지
	한국	특허	2012.04.18	LED 패키지 제조방법 및 그에 의한 LED 패키지
	한국	특허	2012.05.03	발광다이오드 패키지 제조 방법
	한국	특허	2012.05.25	LED 패키지 및 그 제조방법
	한국	특허	2012.06.20	반도체 패키지
	한국	특허	2012.07.04	휴대용 유에스비(USB) 저장 장치
	한국	특허	2012.10.08	적층 반도체 패키지 및 그 제조 방법
	한국	특허	2012.10.10	가속 사전 방제용 R F I D 태그 유닛 및 이를 포함하는 가속 사전 방제용 R F I D 시스템
한국	특허	2012.11.20	발광 다이오드 패키지 제조방법	
한국	특허	2012.11.20	반도체 패키지(SEMICONDUCTOR PACKAGE)	

한국	특허	2012.11.20	반도체 패키지의 제조 방법
한국	특허	2012.11.20	반도체 패키지의 제조 방법
한국	특허	2012.12.11	계단식 적층구조를 갖는 반도체 패키지 및 그의 제조방법
한국	특허	2012.12.24	적층형 반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2013.01.21	적층형 반도체 패키지
한국	특허	2013.01.31	반도체 칩의 범프 형성 방법
한국	특허	2013.02.04	반도체 패키지 및 이를 제조하는 방법
한국	특허	2013.02.05	가축 개체 인식용 이어 태그
한국	특허	2013.02.05	가축 개체 인식용 이어 태그의 제조 방법
한국	특허	2013.02.22	반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2013.02.22	적층형 반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2013.02.26	계단식 적층구조를 갖는 반도체 패키지 및 그의 제조방법
한국	특허	2013.04.30	반도체 적층 패키지 및 이를 제조하는 제조 방법
한국	특허	2013.04.30	반도체 패키지 제조 방법
한국	특허	2013.04.30	반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2013.04.30	반도체 장치 및 이의 제조 방법
한국	특허	2013.05.08	반도체 패키지에용 솔더 범프 형성 방법
한국	특허	2013.05.09	반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2013.05.09	반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2013.05.14	큰 기판 대응을 위한 다수의 댄수를 1개의 블록으로 운영하는 방식을 구현한 와이어 본딩장치
한국	특허	2014.01.06	집적회로 소자 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2014.01.09	반도체 패키지 및 그 제조방법
한국	특허	2014.01.21	적층형 반도체 패키지
한국	특허	2014.02.07	반도체 패키지 및 그 제조방법
한국	특허	2014.07.24	유연 집적회로 소자 패키지 제조 장치
한국	특허	2014.10.10	카드 시스템 및 이의 제조 방법
한국	특허	2014.10.10	집적회로 소자 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2014.10.10	메모리 카드 시스템
한국	특허	2014.12.26	반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2015.01.20	유연 집적회로 소자 및 이의 제조 방법
한국	특허	2015.04.21	인터포저를 포함하는 반도체 패키지 및 그 제조방법
한국	특허	2015.06.22	집적회로 소자 패키지의 제조 방법
한국	특허	2015.06.24	전자 부품의 제조 방법
한국	특허	2015.08.04	가축 개체 인식용 이어 태그
한국	특허	2015.08.11	집적회로 소자 패키지의 제조 방법
한국	특허	2015.08.11	집적회로 소자 패키지의 제조 방법
한국	특허	2015.12.16	반도체 패키지 제조 방법
한국	특허	2016.03.02	반도체 패키지 및 그 제조 방법
한국	특허	2016.05.19	안티-스푸핑을 위한 B L E 비콘 디바이스
한국	특허	2016.05.19	안티-스푸핑을 위한 비콘 관리 서버
한국	특허	2016.06.21	집적회로 소자 패키지
한국	특허	2017.05.24	전자파 차폐 수단을 갖는 반도체 패키지 및 그 제조 방법
한국	특허	2017.07.14	가축 개체 인식용 이어 태그
한국	특허	2018.02.13	반도체 패키지 및 이의 제조 방법
한국	특허	2018.02.13	메탈 코어 솔더 볼 인터넥터 팬-아웃 웨이퍼 레벨 패키지의 제조 방법
한국	특허	2018.11.23	RFID READER
한국	특허	2019.02.08	반도체 패키지 및 그 제조방법
한국	특허	2019.06.26	지문 인식을 위하여 센서 PCB를 이용하는 유연 센서 반도체 패키지 및 그 제조 방법
한국	특허	2019.08.02	스마트 기기의 지문 인식용 유연 센서 반도체 패키지 및 그 제조 방법
한국	특허	2020.01.22	지문 센서 패키지 및 이를 포함하는 지문 센서 모듈

	한국	특허	2020.02.24	재배선 구조를 갖는 반도체 소자와 웨이퍼 레벨 패키지 및 그 제조방법
	한국	특허	2020.08.28	가속 개체 인식용 이어태그
	한국	특허	2020.09.02	가스센서 패키지, 가스센서 웨이퍼 레벨 패키지 및 그 제조방법
	한국	특허	2020.09.29	가속 개체 인식용 이어태그
	한국	특허	2020.11.30	가속 개체 인식용 이어 태그용 무선통신 회로
	한국	특허	2021.05.10	이미지 센서 패키지, 모듈, 및 그 제조 방법
	한국	특허	2022.05.20	전자 소자 및 이의 제조 방법
	한국	특허	2022.10.04	정전기 및 충격 보호 구조를 갖는 반도체 패키지
	한국	특허	2023.03.15	전자 소자 및 이의 제조 방법
	한국	특허	2023.11.23	반도체 장치와, 반도체 칩의 그라인딩 및 싱글레이션 방법
	일본	특허	2006.05.02	휴대용 단말기의 듀얼 디스플레이 모듈 구조
	미국	특허	2005.07.05	Organic light emitting diode display device driving apparatus and driving method thereof
	미국	특허	2005.08.09	Flash memory apparatus having single body type rotary cover
	미국	특허	2013.04.02	Three dimensional semiconductor device
	미국	특허	2013.05.20	Stacked Semiconductor Package
	미국	특허	2016.09.06	Electronic components
	미국	특허	2017.01.03	Electronic devices and methods of manufacturing electronic devices
	미국	특허	2017.01.10	Ear tag for recognizing livestock individual
	미국	특허	2017.01.31	Integrated circuit device packages and methods for manufacturing integrated circuit device packages
	미국	특허	2017.02.14	Memory card systems comprising flexible integrated circuit element packages
	미국	특허	2017.07.31	Ear tag for recognizing livestock individual
	미국	특허	2020.06.09	Metal core solder ball interconnector fan - out wafer level package
	한국	실용신안	2002.08.05	일체형 회전 덮개를 갖는 플래시 메모리 장치
	한국	실용신안	2005.06.08	휴대용 단말기의 듀얼 디스플레이 모듈 구조
	한국	디자인	2003.06.02	플래시 메모리 - 휴대 디자인
	한국	디자인	2005.06.27	플래시 메모리 - AXIS Pro
	한국	상표	2015.03.17	HANABEE
	한국	상표	2016.12.31	C2FO
	한국	상표	2016.12.31	HANAFLEX(9)
	한국	상표	2023.07.10	HIC
	중국	상표	2017.08.31	f-COP
하나 머티리얼즈	한국	특허	2007.11.20	플라즈마 장치용 실리콘 소재의 제조 방법
	한국	특허	2008.09.08	실리콘 링의 제조방법
	한국	특허	2008.10.31	플라즈마 처리 장치용 실리콘 소재의 제조방법
	한국	특허	2008.12.16	코어링 휠 및 이를 이용한 잉곳 코어링 장치
	한국	특허	2009.06.15	카세트 및 이를 구비하는 세정장치
	한국	특허	2009.09.11	포장용 부호 부재 및 이를 이용한 포장 방법
	한국	특허	2009.09.11	플라즈마 처리 장치용 실리콘 소재의 제조방법
	한국	특허	2009.10.13	플라즈마 처리 장치용 실리콘 소재의 제조방법
	한국	특허	2009.10.13	플라즈마 처리 장치용 실리콘 소재의 제조방법
	한국	특허	2010.01.04	잉곳 세정 장치 및 잉곳 세정 방법
	한국	특허	2010.04.05	대용량 케미칼 또는 액상가스 공급용 저장탱크를 이용한 공급시스템
	한국	특허	2012.01.02	케미칼 용액 또는 액상가스 공급시스템
	한국	특허	2012.04.09	전극판 체결용 이중 너트
	한국	특허	2012.04.25	이중 너트 체결구조를 포함하는 실리콘 적재 조립체
	한국	특허	2012.11.01	케미칼 용액 또는 액상가스 공급용 저장탱크
	한국	특허	2013.04.18	플라즈마 챔버의 캐소드 체결구
	한국	특허	2014.05.07	상온반응에 의한 일산화질소 생산설비 시스템 및 생산방법
	한국	특허	2014.12.16	캐소드 전극판의 핸들링 지그

한국	특허	2015.01.15	캐소드 전극판의 제작방법
한국	특허	2015.01.15	내구성이 향상된 플라즈마 처리 장비용 단결정 실리콘 부품 및 이의 제조방법
한국	특허	2015.04.08	높은 내구성을 갖는 플라즈마 처리 장치용 단결정 실리콘 부품의 제조 방법
한국	특허	2015.04.16	플라즈마 챔버용 캐소드 전극판
한국	특허	2015.04.16	캐소드 전극판 어셈블리
한국	특허	2015.04.16	캐소드 전극판용 부시 조립체
한국	특허	2015.06.17	플라즈마 챔버용 냉각판
한국	특허	2015.08.19	CNC 실리콘 다축 가공기
한국	특허	2015.08.19	응력 완충층을 포함하는 SiC 코팅 탄소 부재 및 그 제조 방법
한국	특허	2015.08.19	부시 체결 구조체
한국	특허	2016.02.02	원터치 공정 가스 분사체 조립체
한국	특허	2016.02.04	캐소드 전극판용 부시 조립체
한국	특허	2016.02.04	화학기상증착법에 의한 반도체 공정용 다결정 탄화규소 벌크 부재 및 그 제조 방법
한국	특허	2016.02.04	반도체 공정용 플라즈마 처리 장치용 탄화규소 부품의 재생 방법 및 이러한 방법으로 재생된 탄화규소 부품
한국	특허	2016.06.02	화학기상증착 탄화규소의 전기 저항 조절 방법 및 이를 통해 전기 저항이 제어된 탄화규소 부품
한국	특허	2016.06.02	플라즈마 처리 장치용 탄화규소 부품 및 이의 제조방법
한국	특허	2016.12.09	체결 어셈블리 및 이를 가지는 기판 처리 장치
한국	특허	2019.03.08	조립체를 가진 처리 기판을 위한 록킹 어셈블리와 장치
한국	특허	2019.05.24	반도체 공정용 플라즈마 장치의 일체형 상부 전극 및 이의 제조 방법
한국	특허	2020.06.24	포커스 링 및 그를 포함하는 플라즈마 장치
한국	특허	2020.06.24	플라즈마 전극용 부시 조립체 및 이를 포함하는 전극 조립구조
한국	특허	2020.11.02	포커스 링 및 그를 포함하는 플라즈마 장치
한국	특허	2021.06.22	탄화규소분말 및 단결정 탄화규소의 제조방법
한국	특허	2021.06.22	플라즈마 전극판용 부시 조립체 및 이를 포함하는 상부전극 조립구조
한국	특허	2021.10.01	반도체 부품 및 그의 제조 방법
한국	특허	2023.08.08	정전척 보호 플레이트 및 그의 제조 방법
한국	특허	2023.09.26	플라즈마 전극판용 부시, 이를 포함하는 부시 조립체 및 이를 포함하는 상부전극 조립구조
한국	특허	2023.09.26	포커스 링 및 그를 포함하는 플라즈마 장치
한국	특허	2024.02.02	탄화규소 부품 제조 장치, 이의 증착 노즐, 및 이를 이용한 탄화규소 부품의 제조 방법
한국	특허	2024.03.11	실리콘 슬러지로부터 고순도 실리콘 분말 회수 및 정제 방법
한국	특허	2024.03.11	포커스 링 및 그를 포함하는 플라즈마 장치

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

※ 해당사항이 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항이 없습니다.